



股票代號：6488

環球晶圓股份有限公司 GlobalWafers Co., Ltd.

105年度年報

年報查詢網址：

公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

本公司網址 <http://www.sas-globalwafers.com>

環球晶圓股份有限公司 編製

中華民國 106 年 5 月 31 日 刊印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：李崇偉
職稱：企業發展副總經理
電話：(03)577-2255
電子郵件信箱：GWCIR@sas-globalwafers.com
代理發言人姓名：簡明輝
職稱：財務處長
電話：(03)577-2255
電子郵件信箱：GWCIR@sas-globalwafers.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：新竹科學工業園區新竹市工業東二路 8 號
電話：(03) 577-2255

台灣子公司

竹科工廠：新竹科學工業園區新竹市研新一路 2 號
電話：(03) 578-3131

日本子公司

新潟工廠：新潟県北蒲原郡聖籠町東港六丁目 861 番地 5
電話：025-256-3200

德山工廠：山口県周南市江口 2-1-32

電話：(0834)41-3001

関川工廠：新潟県岩船郡関川村大字辰田新 278

電話：(0254)64-0254

小國長晶中心：山形県西置賜郡小国町大字小国町 378

電話：(0238)62-5926

宇都宮工廠：栃木県清原工業団地 11 番 2

電話：(0238)667-6333

韓國子公司

天安工廠：854, Manghyang-Ro, Seonggeo-eup, Sebuk-gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-do,
331-831 Korea

電話：(+82) 41 550 4114

大陸子公司

昆山工廠：江蘇省昆山市城北高科技工業園區漢浦路 303 號

電話：+86-512-5778-1262

馬來西亞子公司

吉隆坡工廠：Jalan SS 8/2, Sungai Way Free Industrial Zone, 47300 Petaling Jaya, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia

電話：(+603) 7877-3277

新加坡子公司

Block D #01-41A, 11 Lorong 3 Toa Payoh, Singapore 319579

電話：+65 6361 9720

美國子公司

德州工廠：200 F.M. 1417 West Sherman, Texas, USA 75092

電話：903.957.1999

密蘇里工廠：501 Pearl Drive, St. Peters, Missouri, USA 63376

電話：636.474.5000

義大利子公司

美拉諾工廠：Via Nazionale, 59, 39012 Merano (Bolzano), Italy

電話：(+39) 0473 333.333

諾瓦拉工廠：SpA Viale Gherzi, 31, 28100 Novara, Italy

電話：(+39) 0321 33.4444

丹麥子公司

哥本哈根工廠：Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund, Copenhagen, Denmark

電話：(+45) 47 36 56 00

波蘭子公司

華沙工廠：133 Wolczynska St., 01-919 Warsaw, Poland

電話：(+48) 22 835 19 39

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市承德路三段210號地下一樓

網址：<http://www.yuanta.com.tw>

電話：(02)2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：曾漢鈺會計師、黃泳華會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段7號68樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02) 8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

盧森堡交易所

<https://www.bourse.lu/security/US37891E1038/250465>

六、公司網址：<http://www.sas-globalwafers.com>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司簡介.....	6
一、設立日期.....	6
二、公司沿革.....	6
參、公司治理報告.....	7
一、組織系統.....	7
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	9
三、公司治理運作情形.....	19
四、會計師公費資訊.....	40
五、更換會計師資訊.....	41
六、公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形.....	41
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	42
八、持股比例佔前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	43
九、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	44
肆、募資情形.....	45
一、資本及股份.....	45
二、公司債辦理情形.....	49
三、特別股辦理情形.....	49
四、海外存託憑證之辦理情形.....	50
五、員工認股權憑證辦理情形.....	51
六、限制員工權利新股辦理情形.....	51
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	51
八、資金運用計畫執行情形.....	51
伍、營運概況.....	52
一、業務內容.....	52
二、市場及產銷概況.....	59
三、從業員工資訊.....	66
四、環保支出資訊.....	66

五、勞資關係.....	67
六、重要契約.....	69
陸、財務概況.....	70
一、最近五年度簡明財務資料.....	70
二、最近五年度財務分析.....	77
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告.....	85
四、最近年度財務報告.....	86
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告.....	86
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響.....	86
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	87
一、財務狀況.....	87
二、財務績效.....	88
三、現金流量.....	89
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	89
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	89
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	91
七、其他重要事項.....	93
捌、特別記載事項.....	94
一、關係企業相關資料.....	94
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	103
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形.....	103
四、其他必要補充說明事項.....	103
五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	103

附件一 105 年度合併財務報告及會計師查核報告

附件二 105 年度個體財務報告

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

感謝大家撥冗參加環球晶圓股份有限公司一〇六年度股東大會，也謝謝大家對本公司的支持與愛護。

一〇五年對於環球晶圓而言是一個極重要的里程碑，我們先後在七月及十二月分別併購了丹麥 Tpsil Semiconductor Materials A/S 公司的半導體事業(以下簡稱 Tpsil)及美國的 SunEdison Semiconductor Ltd 公司(以下簡稱 SEMI)，讓本公司躍昇為全球第三大的半導體晶圓製造商，且擁有傲於同業的完整產品線；如今，環球晶圓已是在全球 10 個國家有 17 個營運據點且員工人數超過 6,500 人的國際性企業。

回顧一〇五年營業狀況，由於功率元件(MOSFET、Schottky)等產品需求強勁，中小尺寸產品全年皆維持近乎滿產能生產，然全球智慧型手機及 PC 銷售動能在上半年並未見明顯成長，因此大尺寸(8" & 12")產品上半年表現持平，惟自第四季起，在 IPHONE 7 等新款手機問世及其他可攜式產品需求回溫的帶動下，LCD Driver、Memory 等需求漸增，加上成功購併 Tpsil 及 SEMI，分別於七月及十二月併入該併購標的營收，因此一〇五年合併營收達 184.27 億元較一〇四年成長 20.4%。獲利方面，因受併入 Tpsil 及 SEMI 的影響，毛利率由一〇四年 26.6%降為 22.41%，另外因購併案的專案費用如財務顧問費用等於第四季認列，加上購併後實施人員精簡等整頓措施，營業費用達 27.52 億元較一〇四年 13.88 億元增加 13.64 億元，營業淨利率滑落至 7.5%，拖累整體獲利表現，總計一〇五年稅後淨利為新台幣 9.39 億元，稅後每股盈餘為新台幣 2.54 元。以下謹就一〇五年度營業成果、一〇六年度營業計畫概要、未來公司發展、受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響等，概要報告如述：

一、一〇五年度營業成果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

年度 項目	105 年度 (IFRSs)	104 年度 (IFRSs)	增減百分比 (%)
營業收入	18,426,950	15,310,462	20.36%
營業成本	14,296,567	11,237,292	27.22%
營業毛利	4,130,383	4,073,170	1.40%
營業費用	2,752,036	1,388,248	98.24%
營業淨利	1,378,347	2,684,922	-48.66%
稅前淨利	1,344,439	2,807,726	-52.12%
本期淨利	939,171	2,044,193	-54.06%

前述營業費用之增加，多屬購併案之一次性費用，預計一〇六年的營業費用率將可逐步降低，加上自一〇五年十二月起，因記憶體等終端產品的需求增溫以及全球特別是大陸地區新建12吋半導體廠陸續完工，帶動12吋晶圓片的需求，然供給端目前並無廠商擴產，供需吃緊，平均銷售單價亦因此而陸續調漲，由於此波產能短缺屬於產業結構性的變化，除非整體經濟環境有明顯的惡化，否則預期短期內尚難扭轉供給短缺的現象；本公司於去年併購SEMI後，順利取得其十二吋產品的產能，預期將可加速發揮合併綜效，除了營收可大幅成長外，亦可藉此景氣循環向上的有利環境，改善原SEMI旗下各事業體的經營體質及獲利狀況。

（二）預算執行情形：本公司一〇五年度無公告財務預測。

（三）獲利能力分析

項 目			105 年度	104 年度
財務 結構	負債佔資產比率（％）		73.88	29.78
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率（％）		114.93	202.25
獲利 能力 分析	資產報酬率（％）		2.39	9.08
	權益報酬率（％）		5.77	13.66
	占實收資本比率（％）	營業利益	37.33	72.71
		稅前純益	36.41	76.04
	純益率（％）		5.10	13.35
	稅後每股盈餘（元）		2.54	5.80

（四）財務收支情形

本公司一〇五年度營業收入新台幣 18,426,950 仟元，營業成本新台幣 14,296,567 仟元，營業費用新台幣 2,752,036 仟元，營業外收支淨額為淨支出新台幣 33,908 仟元，稅前淨利新台幣 1,344,439 仟元，稅後淨利 939,171 仟元，財務收支正常。

（五）研究發展狀況

1. 一〇五年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

項目 / 年度	105 年度	104 年度
研發費用	726,206	550,567
營業收入淨額	18,426,950	15,310,462
研發費用占營收淨額之比例(%)	3.94	3.60

2. 一〇五年度研究發展成果：

技術或產品名稱

- (1) 8" 重摻硼電阻 $<1.0\text{m } \Omega\text{-cm}$ 晶體生長技術
- (2) 矽晶體超微量金屬檢測技術
- (3) Wire saw 高精度(± 0.05 度) 偏角度晶棒切割技術
- (4) 碳化矽晶體生長技術
- (5) 8 吋單晶矽晶棒連續式加料 CZ 晶體生長技術
- (6) 8" 重摻砷電阻 $<2.0\text{m } \Omega\text{-cm}$ 晶體生長技術
- (7) 8" $<100>$ FZ SNTD 晶體生長技術

3. 未來研究發展計劃：

- (1) 8 吋 GaN on Silicon 磊晶技術開發
- (2) 高強度超薄奈米化半導體矽晶圓
- (3) 高解析度光學感測元件用晶圓
- (4) 次世代高功率車用電子元件用碳化矽晶圓開發
- (5) 次世代 RF 元件用 SOI 基板開發
- (6) 7 奈米製程用矽晶圓開發

二、一〇六年度營業計畫概要

（一）經營方針

- (1) 集中資源強化新併事業體之營運績效，以獲利為優先目標，優化全球十個國家十六座生產基地之生產技術、採購、產能、行銷之跨地整合，將成本極小化。

- (2) 運用現有客戶網絡，擴大FZ/SOI產品的客戶基礎，提高產線的產能利用率，提升產品的獲利能力。
- (3) 持續優化各生產據點的生產效率，在現有設備基礎下讓產能極大化，盡可能滿足客戶訂單需求。

(二) 預估銷售數量及其依據：

2016 年全球半導體產業表現平平，根據半導體貿易統計群組織(WSTS)最新公布資料，2016 年全球半導體營收達到 3349.53 億美元，比起 2015 年的 3351.68 億美元，呈現 0.1%的微幅衰退，而在 2017 與 2018 年則預計分別會有 3.3%與 2.3%的成長，累計 2015 年至 2018 年間，全球半導體出貨金額的年平均成長率將達 1.8%。WSTS 指出，2016 年全球 4 大半導體市場中，日本以外之亞太地區將年增 2.5%至 2,060.25 億美元；日本市場則為年增 3.2%至 321.05 億美元，在主要市場中表現最佳；美國市場預計會有趨緩的情形，預估將年減 6.5%至 642.37 億美元；歐洲亦將年減 4.9%至 325.86 億美元。

如果以產品分類來看，2016 年離散元件(discrete)全球出貨額將年增 4.2%至 193.99 億美元；光電元件(Optoelectronics)將年減 3.6%至 320.59 億美元；感測器(Sensor)將大增 22.6%至 108.10 億美元；晶片(IC)出貨額預估將年減 0.7%至 2,726.85 億美元。若就細項來看，Memory 預估將年減 3.8%至 743.01 億美元、Logic 將年減 2.7%至 882.86 億美元、Micro 將年增 2.3%至 627.19 億美元、Analog 將年增 4.8%至 473.79 億美元。

(三) 重要產銷政策：

- (1) 整合十二吋產品，擴大產品市占率及獲利能力。
- (2) 快速整合新併事業體的技術資源，深化跨國技術整合平臺，全面提升品質及客戶滿意度。
- (3) 透過集團資源垂直整合，具產能調度彈性以達到最具規模經濟的競爭力。掌握下游終端客戶市場並加強與客戶研發連結。
- (4) 以核心技術能力開發高效率之利基產品，提升附加價值。
- (5) 尋求技術與銷售之策略聯盟，開發設計公司新產品的研發與材料的需求；快速將產品導入市場，提升市場占有率。

(四) 未來公司發展策略

- (1) 運用集團尖端之領先技術開發符合次世代產品運用之晶片，朝向大尺寸重摺長晶及功率半導體磊晶技術發展，成為全球規模最大且產品完整性最高的矽晶圓供應商。
- (2) 廣泛產官學合作，開始開發大尺寸晶圓長晶核心技術，保持高度的產品創新能力，加速產品及技術開發能力達到國際水準。

- (3) 與下游客戶緊密合作掌握市場需求及發展趨勢。
- (4) 以較大尺寸單晶爐的高效率熱場設計及單晶提拉技術，投入發展八吋半導體重摻晶圓或磊晶晶圓，藉由技術平臺之建立，降低產業競爭及增進業務之推廣，朝向具高附加價值的專業技術發展。
- (5) 以現有穩定之優異經營績效為基礎，透過策略聯盟或購併方式，穩健擴大公司營運規模。

(五) 受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響

- (1) 隨著半導體產業的發展與應用，其相關產品已深入人們的日常生活，舉凡食、衣、住、行、育、樂均可見到半導體產品的運用，因此半導體產業景氣跟總體經濟有相當程度的連結。由於公司的客戶群廣泛，終端產品遍及各產業及應用領域，如車用產品、電源類產品、記憶體等等…，可降低單一產業景氣循環的風險，因此當總體經濟不佳時，公司尚能藉此分散風險，使營運維持穩定
- (2) 半導體產業鏈的整併風潮仍然方興未艾，公司除了持續壯大自身規模與競爭力外，仍然持續以現有產品為合作基礎，並配合客戶需求協同開發新產品，形塑緊密而互惠的夥伴關係以鞏固商機。尤其在併購 SEMI 與 Topsil 之後，公司產品線已臻完善，更能滿足客戶的需求並維繫更緊密的客戶關係。
- (3) 半導體晶圓產業累積數十年的發展，在技術、專利等各方面均建立起相當程度的進入門檻，然不代表不會有新的競爭者加入，特別是中國大陸傾國家之力積極扶植其國內之半導體產業，我們仍不敢掉以輕心，將以既有基礎持續結合本公司全球各地的技術優勢，以核心技術能力開發利基產品，提升產品附加價值，並將成本極小化，以增加獲利空間。

2016 年本公司透過二次的併購，躋身世界前三大半導體晶圓製造商之一，適逢產業景氣循環向上，除了 12 吋產品已經供不應求外，8 吋供需也漸趨吃緊，整體產業情勢有利公司購併後的整併發展，然隨著公司規模快速成長，新併購事業體仍需進行組織及財務結構的整理與調整，因此經營團隊在 2017 年將以調整內部營運體質為主軸，優化各事業體的經營體質及效率，以讓新購的事業體轉虧為盈為首要任務，配合整體景氣翻揚的契機，加速完成整併工作，打造全新優質且具國際競爭力的新環球晶圓。

董 事 長 徐秀蘭



總 經 理 Mark Lynn England



主辦會計 徐秀鈴



貳、公司簡介

一、設立日期：民國 100 年 10 月 18 日

二、公司沿革

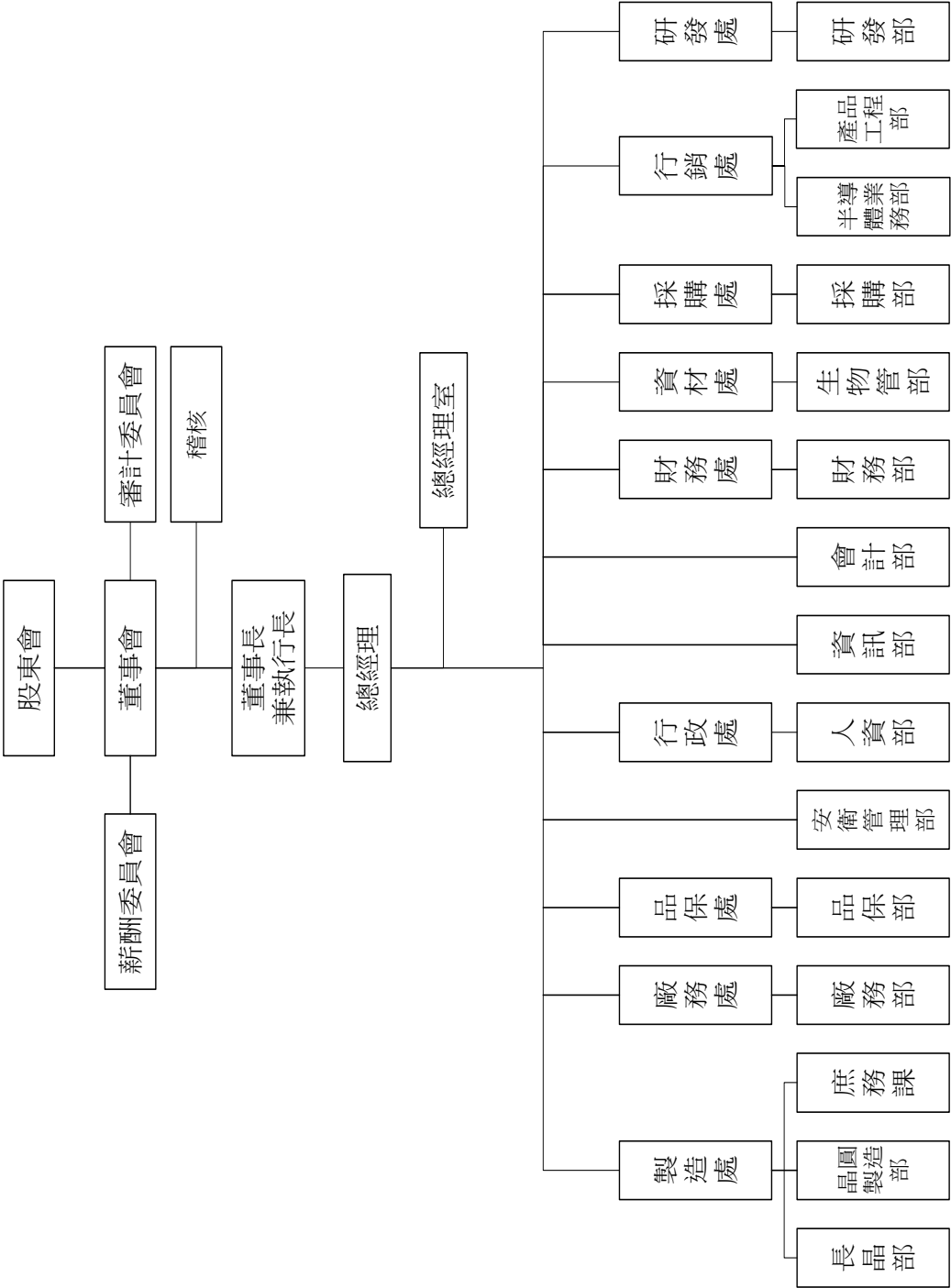
民國 100 年 10 月	環球晶圓正式成立(原中美矽晶半導體事業處分割獨立)，實收資本額 1,800,000 仟元。
民國 101 年 04 月	環球晶圓(股)公司完成收購日商 Covalent Materials Corporation 公司旗下半導體矽晶圓事業部，實收資本額為 3,175,000 仟元。
民國 102 年 08 月	ISO14001 認證通過
民國 102 年 12 月	台灣智慧財產管理制度(TIPS)認證通過
民國 102 年 12 月	環球晶圓獲得國健署 102 年度健康職場啟動標章認證肯定
民國 103 年 07 月	TS16949：2009 認證通過
民國 103 年 09 月	股票公開發行
民國 103 年 10 月	股票登錄興櫃買賣
民國 104 年 01 月	辦理現金增資，實收資本額為 3,492,500 仟元。
民國 104 年 04 月	向財團法人證券櫃檯買賣中心申請上櫃
民國 104 年 09 月	現金增資，實收資本額為 3,692,500 仟元
民國 104 年 09 月	股票掛牌上櫃
民國 105 年 04 月	榮獲美國德州儀器 (TI) 2015 年最佳供應商獎
民國 105 年 07 月	完成收購丹麥 Topsil Semiconductor Materials A/S 半導體事業群
民國 105 年 08 月	職業安全衛生管理系統 OHSAS 18001：2007 認證通過
民國 105 年 08 月	ISO 14001:2015 認證通過
民國 105 年 12 月	順利完成收購 SunEdison Semiconductor
民國 106 年 04 月	榮獲證基會第三屆公司治理評鑑上櫃公司排名前百分之二十
民國 106 年 05 月	辦理現金增資參與發行海外存託憑證，實收資本額為 4,372,500 仟元

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構

環球晶圓股份有限公司組織圖



(二)各主要部門所營業務

部 門	業 務 項 目
董事長	設定公司之預定目標及經營策略，規劃公司之經營方針，執行董事會決議交辦事項，執行股東會決議事項
稽核室	檢查、評估公司內部控制制度之健全性、合理性及有效性，負責內部控制制度之推動、稽核及報告
總經理及總經理室	執行董事會決議交辦事項，管理制度與專案業務之推動，經營計劃之擬定與規劃，並管理督促所屬部門主管達成計劃目標，經營績效之評核及分析
資訊部	1.維護資訊系統相關軟、硬體設備 2.規劃並執行電腦化
品保處	負責產品品質標準及檢驗規範之訂定與管理，進料、儀器治具、製程及成品品質檢驗，推動品質改善活動等
行政處	1.人事規章制度與福利推行事項，各職稱別工作說明書之制訂 2.人力資源之規劃、招募與儲備，年度教育訓練之規劃與執行
財務處	1.公司財務資金統籌調度及金融機構建立良好關係 2.配合專案相關計劃之執行
會計部	1.公司年度經營預算編列之擬定、推動、控制及成果檢討 2.會計制度統籌規劃、制定、執行與修訂 3.財務結構、損益變動、會計報告之編製、分析及解釋事項 4.租稅規劃
安衛管理部	1.釐訂勞工安全衛生管理計畫，並指導有關部門實施 2.規劃、督導各部門辦理勞工安全衛生稽核及管理 3.規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查 4.規劃、實施勞工安全衛生教育訓練 5.督導勞工職業災害之調查處理及統計分析 6.提供有關勞工安全衛生管理資料及建議 7.規劃、督導環保防治計劃之執行
行銷處	1.行銷策略之規劃、銷售市場之拓展、客戶溝通及售後服務 2.負責市場訊息之蒐集、客戶服務及產品應用，協助新產品之研發及推廣
資材處	原物料、協力廠商管理
採購處	採購作業之執行，新廠商之評估，原物料、協力廠商管理
研發處	產品之研製、開發、測試，生產技術、良率、產能之改善，與學術及學術單位合作，研發及改良生產設備
製造處	負責產品生產、良率及異常管理、原物料使用及報廢管理、工作現場維持與工安執行，人力規劃與訓練，產能擴充之規劃與執行 評估並引進新設備儀器，負責生產設備改良及維修保養事宜
廠務處	公司廠房設施興建、維護保養及負責執行環安、衛安及工安等事宜

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

106 年 04 月 21 日 單位：股；%

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有股 份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼 任本公司 及其他公 司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中 華 民 國	徐秀蘭	女	104.01.19	三年	100.10.01	700,000	0.22%	847,879	0.23%	—	—	—	—	伊利諾大學電腦科學 碩士/中美矽晶製品 (股)公司執行副總經 理	註一	研 發 暨 製 造 副 總	徐 文 慶	姐 弟	
董 事	中 華 民 國	中美矽晶製 品(股)公司 代表人： 盧明光	男	104.01.19 104.01.19	三年 三年	100.10.01 100.10.01	301,381,000 450,000	94.92% 0.14%	222,293,000 1,002,560	60.20% 0.27%	— 366,105	— 0.10%	— —	— —	政治大學企研所企業 家進修班結業/敦南科 技(股)公司總經理/旭 興科技(股)公司總經 理/旭麗(股)公司副總 經理	註二	無 無	無 無	無 無	
董 事	中 華 民 國	中美矽晶製 品(股)公司 代表人： 姚宏梁	男	104.01.19 104.01.19	三年 三年	100.10.01 100.10.01	301,381,000 200,000	94.92% 0.06%	222,293,000 200,293	60.20% 0.05%	— 674	— —	— —	— —	淡江大學管研所碩士/ 旭興科技(股)公司製 造處協理/中美矽晶製 品(股)公司總經理	註三	無 無	無 無	無 無	
董 事	中 華 民 國	陳國洲	男	104.01.19	三年	103.05.26	500,000	0.16%	665,773	0.18%	—	—	—	—	南英商工/南海光電 (股)公司董事長/三信 商業銀行董事	註四	無	無	無	
獨立 董 事	中 華 民 國	張俊彥	男	104.01.19	三年	104.01.19	—	—	—	—	—	—	—	—	交通大學電子研究所 博士/交通大學電子資 訊研究中心主任/交通 大學校長/創辦國家毫 米元件實驗室，並擔任 主任/美國 Bell Labs 高 級研究員/德國 Stuttgart U.客座教授	註五	無	無	無	

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別	選(就)/任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係
獨立董事	中華民國	鄭繼雄	男	104.01.19	三年	104.01.19	—	—	5	0.00%	—	—	—	—	文化大學企業管理系/裕隆汽車副課長/裕盛工業稽核主任/裕盛工業成本課課長/裕盛工業管理部經理/合晶科技財務處長	註六	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳明璋	男	104.01.19	三年	104.01.19	—	—	—	—	—	—	—	—	國家商學博士/政治大學企管研究所博士/中興大學企業管理系所長/中國生產力中心總經理/大陸委員會經濟處處長	註七	無	無	無

註一：目前兼任環球晶(股)公司執行長、美國子公司GlobalTech Incorporated 董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司總經理、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事長、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、Topsil Semiconductor Materials A/S 董事長、SunEdison Semiconductor Ltd 董事、中德電子材料股份有限公司董事長、MEMC Korea Company 董事長、MEMC Japan Limited 董事長、SunEdison Semiconductor B.V. 董事、GWafers Inc. 董事、中美材料(股)公司法人董事代表人、兆遠科技(股)公司董事、SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人、SAS Sunrise Pte. Ltd. 法人董事代表人、旭鑫能源(股)公司法人董事代表人、旭忠能源(股)公司法人監察人、GWafers Singapore Pte. Ltd. 法人董事代表人、泰旭能源(股)公司監察人。

註二：目前兼任朋程科技(股)公司董事長及執行長、傳承光電(股)公司董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事、環球晶圓(股)公司法人代表人、昇陽光電科技(股)公司法人代表人、SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人、SAS Sunrise Pte. Ltd. 法人董事代表人、GWafers Singapore Pte. Ltd. 法人董事代表人

註三：目前兼任昆山中辰矽晶有限公司董事長及執行長、中美矽晶製品公司副董事長及副執行長、美國子公司 GloblTech Incorporated 董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd 董事、朋程科技(股)公司法人董事代表人、嵩隆電子(股)公司監察人、昇陽光電科技(股)公司法人董事代表人、中美材料(股)公司監察人、SAS Sunrise Pte. Ltd.法人董事代表人、旭鑫能源(股)公司法人監察人代表人、GWafers Singapore Pte. Ltd.法人董事代表人、台灣苯乙烯工業股份有限公司薪酬委員、元鴻(山東)光電材料有限公司董事、上海召業申凱電子材料有限公司董事。

註四：目前兼任南海光電(股)公司董事長。

註五：目前兼任美國國家工程院院士、交通大學終身講座教授、貿聯控股(BizLink Holding Inc.)獨立董事。

註六：目前兼任金利精密工業股份有限公司薪資報酬委員會委員。

註七：目前兼任台北經濟管理學院院長、海基會顧問、南華大學講座教授、艾美特獨立董事、建大工業(股)薪酬委員會委員。

1.法人股東之主要股東：

法人股東名稱(註)	法人股東之主要股東
中美矽晶製品股份有限公司	昇陽光電科技股份有限公司(3.77%)、新制勞工退休基金(2.66%)、弘望投資股份有限公司(2.39%)、盧明光(2.00%)、張鳳鳴(1.90%)、弘茂投資股份有限公司(1.80%)、匯豐(台灣)商業銀行受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶(1.77%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(1.48%)、匯豐銀行託管瑞銀有限公司－借貸交易平台(1.46%)、匯豐銀行託管貝龐合夥人有限合夥投資專戶(1.42%)

2.法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

法人名稱(註)	法人之主要股東
昇陽光電科技股份有限公司	中美矽晶製品股份有限公司(7.94%)、威連科技股份有限公司(3.86%)、中華開發資本股份有限公司(2.12%)、欣東投資股份有限公司(1.79%)、基勝工業股份有限公司(1.66%)、中華開發創業投資股份有限公司(1.40%)、渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.21%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數(0.88%)、花旗託管挪威中央銀行投資專戶(0.63%)、劉鑫祖(0.60%)
弘望投資股份有限公司	威連科技股份有限公司(39.06%)、朋程科技股份有限公司(36.56%)、環球晶圓股份有限公司(24.38%)
弘茂投資股份有限公司	財團法人基督教中華信望愛基金會(19.90%)、財團法人兩岸和平台灣信望愛文教基金會(19.90%)、公益信託恩典社會福利基金(19.90%)、財團法人威盛信望愛慈善基金會(19.90%)

3.董事及監察人獨立性資料

姓名	條件 (註 1)	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 2)										兼任其 他公開 發行公 司獨立 董事家 數
		商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所須相 關科系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
董 事															
徐秀蘭				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
中美矽晶製 7 品 (股)公司 代表人：盧明光				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	無
中美矽晶製品 (股)公司 代表人：姚宕梁				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	無
陳國洲				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
獨立董事															
張俊彥	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
鄭繼雄				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
陳明璋	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料：

106 年 4 月 21 日 單位：股；％

職 稱 (註 1)	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷 (註 2)	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人		
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係
執行長	中華民國	徐秀蘭	女	100.10.01	847,879	0.23%	—	—	—	—	伊利諾大學電腦科學碩士/中美矽晶製品(股)公司執行副總經理	註一	研發暨製造副總	徐文慶	姐弟
總經理	美國	Mark Lynn England	男	103.10.01	—	—	—	—	—	—	University of Texas, Austin, Texas, BBA, Engineering Management/ GlobalWafers Co.Ltd. V.P., Sales & Marketing / Texas Instruments Manager, Product Engineering	註二	無	無	無
研發副總 製造副總	中華民國	徐文慶	男	103.09.02	21,778	0.01%	—	—	—	—	清華大學奈米工程與微系統研究所博士/工研院化工所研究員/中美矽晶製品(股)公司研發中心副總	無	執行長	徐秀蘭	姐弟
資材副總	中華民國	陳偉文	男	103.09.02	60,700	0.02%	250,000	0.07%	—	—	國立臺灣大學財金碩士、美國紐約康乃爾大學工程碩士/荷蘭商恩智浦半導體公司亞太區供應鏈中心部門資深協理	註三	無	無	無
行銷副總	中華民國	洪聖雄	男	104.03.19	—	—	—	—	—	—	美國波士頓大學製造工程碩士/昆山中辰矽晶有限公司研發副總	註四	無	無	無
採購副總	中華民國	周靜文	女	105.07.01	28,150	0.01%	—	—	—	—	美國 Long Island University 企管碩士/啟基科技採購經理/Symbol Technologies 專案經理	無	無	無	無
企業發展 副總	中華民國	李崇偉	男	106.03.21	—	—	—	—	—	—	日本明治大學經營學士&企管碩士/台灣三井物產協理	註五	無	無	無
財務處長	中華民國	簡明輝	男	103.09.02	37,730	0.01%	—	—	—	—	Taiwan 執行副總兼總經理/台灣三井物產協理	註六	無	無	無
會計經理	中華民國	徐秀鈴	女	103.09.02	31,350	0.01%	—	—	—	—	台北大學企業管理研究所碩士/資誠聯合會計師事務所主任、旭泓全球光電(股)公司會計經理	無	無	無	無

註一：目前兼任環球晶圓(股)公司執行長、美國子公司 GlobiTech Incorporated 董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司總經理、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事長、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、Topsil Semiconductor Materials A/S 董事長、SunEdison Semiconductor Ltd. 董事、中德電子材料股份有限公司董事長、MEMC Korea Company 董事長、MEMC Japan Limited 董事長、SunEdison Semiconductor B.V. 董事、GWafers Inc. 董事、中美材料(股)公司法人董事代表人、兆遠科技(股)公司董事、SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人、SAS Sunrise Pte. Ltd. 法人董事代表人、旭鑫能源(股)公司法人董事代表人、旭忠能源(股)公司法人監察人、GWafers Singapore Pte. Ltd. 法人董事代表人、泰旭能源(股)公司監察人。

註二：目前兼任美國子公司 GlobiTech Incorporated 總經理、美國子公司 SunEdison Semiconductor LLC 董事兼總經理、新加坡子公司 SunEdison Semiconductor Limited 董事、韓國子公司 MEMC Korea Company 董事。

註三：目前兼任昆山中辰矽晶有限公司監察人、上海葛羅禾半導體科技有限公司監察人、Topsil GlobalWafers A/S 董事。

註四：目前兼任昆山中辰矽晶有限公司董事、上海葛羅禾半導體科技有限公司總經理。

註五：目前兼任中美矽晶企業發展副總經理、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 監察人、MEMC Japan Limited 董事。

註六：目前兼任昆山中辰矽晶有限公司董事、MEMC Electronic Materials S.p.A. 董事、MEMC Holding B.V. 董事、中德電子材料股份有限公司監察人。

(三)最近年度(105年)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.董事(含獨立董事)之酬金：

105年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金					A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	
		報酬(A)		退職退休金(B)	董事酬勞(C)	業務執行費用(D)	本公司	財務報告內所有公司	薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司			財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	現金金額		股票金額
董事	徐秀蘭															
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：盧明光															
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宏梁	2,160	2,160	0	0	3,500	275	275	2,837	0	0	4,100	0	4,100	0	
董事	陳國洲															
獨立董事	鄭繼雄															
獨立董事	張俊彥															
獨立董事	陳明璋															

註：105年度員工酬勞金額係估列數，實際分派金額尚未經董事會通過

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
低於 2,000,000 元	中美矽晶製品(股)公司(代表人：盧明光、姚宕梁)、陳國洲、張俊彥、鄭繼雄、陳明璋、徐秀蘭	中美矽晶製品(股)公司(代表人：盧明光、姚宕梁、陳國洲、張俊彥、鄭繼雄、陳明璋、徐秀蘭	中美矽晶製品(股)公司(代表人：盧明光、姚宕梁)、陳國洲、張俊彥、鄭繼雄、陳明璋	中美矽晶製品(股)公司(代表人：盧明光、姚宕梁)、陳國洲、張俊彥、鄭繼雄、陳明璋
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	徐秀蘭	徐秀蘭
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	共 7 人	共 7 人	共 7 人	共 7 人

2.最近年度(105)支付總經理及副總經理之酬金

105 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支 費等等(C)		員工酬勞金額(D)(註2)				A、B、C 及 D 等四項總額占 稅後純益之比 例(%)		有無領取來自子 公司以外轉投資 事業酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	現金 金額	股票 金額	所有公司 現金 金額	股票 金額	本公司	財務報 告內所 有公司	
執行長	徐秀蘭													
總經理	Mark Lynn England													
副總經理	徐文慶	11,659	18,475	378	378	2,269	2,269	6,900	0	6,900	0	2.26%	2.98%	無
副總經理	陳偉文													
副總經理	洪聖雄													
副總經理	周靜文(註1)													

註1：於105年7月就任 註2：105年度員工酬勞金額係估列數，實際分派金額尚未經董事會通過

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元	Mark Lynn England	—
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	徐文慶、陳偉文、洪聖雄、周靜文	徐文慶、陳偉文、洪聖雄、周靜文
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	徐秀蘭	徐秀蘭、Mark Lynn England
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	共 6 人	共 6 人

3.分派員工酬勞之經理人姓名及配發情形：

105 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	徐秀蘭	—	7,800	7,800	0.83%
	總經理	Mark Lynn England				
	副總經理	徐文慶				
	副總經理	陳偉文				
	副總經理	洪聖雄				
	副總經理	周靜文(註 1)				
	財務處長	簡明輝				
	會計經理	徐秀鈴				

註 1：於 105 年 7 月就任

註 2：105 年度員工酬勞金額係估列數，實際分派金額尚未經董事會通過

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元；%

職 稱	105 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)		104 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董 事	0.63%	0.63%	0.36%	0.36%
總經理及副總經理	2.26%	2.98%	1.30%	1.84%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)本公司董事酬勞，係依公司章程規定辦理，並經董事會決議；總經理及副總經理酬金包含薪資、獎金及員工紅利，係依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之；訂定酬金之程序，亦依據公司章程及核決權限訂定之；本公司支付董事、總經理及副總經理酬金，已併同考量公司未來面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營與風險控管之平衡。

(2)訂定酬金之程序

本公司董事酬勞係依據本公司章程規定：「本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。」另，業務執行費用僅發放每次參加董事會之車馬費，總經理及副總經理所領取之酬金部份

係依據每年董事會所通過年度預算之營運績效額度，其發放辦法係依本公司「經理人薪資報酬管理辦法」及「員工酬勞分派辦法」程序辦理之。

本公司於 103 年 9 月 2 日成立薪資報酬委員會，該委員會定期檢討董事、及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並呈送董事會報告。

(3)經營績效及未來風險之關連性

本公司董事及經理人之績效評估和薪資報酬除參考同業通常水準支給外，綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項，與其所負公司經營責任及整體績效呈高度關連性。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

105 年度董事會開會 12 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	徐秀蘭	12	0	100%	第三屆 (104 年 1 月 19 日選任)
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：盧明光	11	1	92%	
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宕梁	12	0	100%	
董事	陳國洲	12	0	100%	
獨立董事	張俊彥	10	2	83%	
獨立董事	鄭繼雄	12	0	100%	
獨立董事	陳明璋	11	1	92%	
其他應記載事項：					
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：					
(一) 證交法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。					
(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。					
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：					
無。					
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：					
1.設置獨立董事及審計委員會，加強專業董事獨立客觀功能，監督董事會運作：本公司於 104 年 1 月 19 日股東臨時會改選董事，並選任三席獨立董事，同時成立審計委員會取代監察人制度。					
2.設立薪酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，並定期檢討董事及經理人等之報酬是否合宜。					
3.持續提昇資訊透明度：本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新等，並設置投資人專區，提供財業務資訊。					

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形資訊

1.審計委員會運作情形：

本公司於104年1月19日設置審計委員會取代監察人制度，105年度審計委員會共召開12次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	張俊彥	10	2	83%	104年1月19日設立審計委員會
獨立董事	鄭繼雄	12	0	100%	
獨立董事	陳明璋	11	1	92%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一)證交法第14條之5所列事項：105年度各議案均經審計委員會全體出席委員同意後，議案內容詳下表。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通

1.本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。

2.本公司簽證會計師每季於審計委員會議中，針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告。

(二)105年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點
105.02.16	內部稽核業務報告
105.03.17	一〇四年度內部控制制度聲明書
105.05.03	內部稽核業務報告
105.08.04	內部稽核業務報告
105.11.03	1. 內部稽核業務報告 2. 一〇六年度內部稽核計劃

(三)105年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點
105.03.17	104年度合併及個體財務報告查核結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通
105.05.03	105年第一季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通
105.08.04	105年第二季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通
105.11.03	105年第三季合併財務報告核閱結果，並針對會計原則適用及新修訂法令之影響進行討論及溝通

105 年度審計委員會議案內容

審計委員會日期	議案內容及後續處理	證交法第 14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
105.02.16	1.內部稽核業務報告案	V	無
	2.擬設立新加坡子公司案	V	無
105.03.17	1.本公司民國一〇四年度決算表冊案	V	無
	2.本公司一〇四年度盈餘分派案	V	無
	3.本公司資本公積發放現金股利案	V	無
	4.訂定本公司「會計師獨立性及績效評估辦法」案	V	無
	5.一〇四年度「內部控制制度聲明書」案	V	無
105.05.03	1.本公司一〇五年第一季合併財務報告案	V	無
	2.內部稽核業務報告案	V	無
	3.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案	V	無
	4.本公司購買海外資產案	V	無
105.05.20	本公司收購 Topsil 半導體業務資產案	V	無
105.06.17	公司購買 Topsil Semiconductor Materials A/S 公司資產案，因情勢變化，擬提高收購價格	V	無
105.07.01	資金貸與子公司 Topsil GlobalWafers A/S 案	V	無
105.08.04	1.本公司一〇五年第二季合併財務報告案	V	無
	2.內部稽核業務報告案	V	無
	3.本公司與法人董事簽訂之合約案	V	無
105.08.18	1.本公司暨新加坡子公司 GWAFERS SINGAPORE PTE LTD 擬購併 SunEdison Semiconductor Limited (以下簡稱 SEMI)公司案	V	無
	2.配合 SEMI 案，擬辦理匯率及利率避險案	V	無
105.10.11	新加坡子公司 GWAFERS SINGAPORE PTE LTD 增資案	V	無
105.11.03	1.本公司一〇五年第三季合併財務報告案	V	無
	2.內部稽核業務報告案	V	無
	3.一〇五年內部稽核計劃案	V	無
	4.衍生性金融商品承作報告案	V	無
	5.資金貸與子公司 Topsil 款項轉列取得投資款案	V	無
	6.子公司資金貸與環球晶圓案	V	無
	7.為子公司 GlobalWafers Japan Co.,Ltd.向銀行申請授信額度，由本公司出具保證函(LOG)案	V	無
	8.為子公司 Globitech Incorporated 向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函(LOS)案	V	無
105.11.24	1.擬修訂本公司背書保證辦法案	V	無
	2.資金貸與子公司 GWAFERS SINGAPORE PTE LTD 案	V	無
	3.資金貸與 SUNEDISON SEMICONDUCTOR B.V.案	V	無
	4.為提昇集團管理綜效及尋找上中下游整合策略投資標的，本公司擬與其他投資人合資成立新公司案	V	無
	5.為聯貸案之需要，擬出具反面承諾書	V	無
	6.向銀行申請授信額度案	V	無
105.12.30	1.衍生性金融商品承作報告案	V	無
	2.本公司辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	V	無
	3.資金貸與子公司 Topsil GlobalWafers A/S 之資金貸與額	V	無

審計委員會日期	議案內容及後續處理	證交法第 14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
	度調整案		
	4. 資金貸與子公司 SUNEDISON SEMICONDUCTOR B.V. 之資金貸與額度調整案	V	無
	5. 取消資金貸與子公司 GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.案	V	無
	6. 本公司擬向孫公司 SunEdison Semiconductor Limited(Singapore)購買專利權及商標權案	V	無
	7. 為子公司 SUNEDISON SEMICONDUCTOR B.V.融資授信擔任保證人案	V	無
	8.為法務工作事務，與中美矽晶簽訂委任契約案	V	無

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已制訂「治理實務守則」，依照公司治理之精神並執行其相關規範。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V		(一)本公司委託元大證券股份有限公司股務代理部處理股東相關問題，並且依規定建立發言人制度處理相關事宜，亦於網站上設置專門頁面，收納各項提問或建議。 (二)本公司掌握實際董事、經理人及持股10%以上之大股東持股情形。本公司均按月申報證期局指定網站公開資訊觀測站。 (三)本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，訂有「環球晶圓對子公司之監理辦法」，落實對子公司風險控制機制；並訂定「投資管理辦法」、「集團企業暨特定公司及關係人交易作業程序」，對關係企業之進銷交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項加以規範。 (四)本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V V		(一)本公司「公司治理實務守則」已有規範董事會整體應具備之能力，本公司董事會成員皆具有專業產學經驗，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。 (二)公司章程載明得於董事會下設置功能性委員會

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V V	會，相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法進行。本公司目前已設置薪資報酬委員會及審計委員會。 (三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行一次董事會績效評估，105年度評估結果已董事陳報106年3月21日董事會，評估項目主要包含對公司營運參與程度、董事利益迴避、董事之進修及出席率等，本公司董事會整體運作情形良好，105年度評估結果已揭露於公司網站。 (四)本公司已訂定「會計師獨立性及績效評估辦法」，本公司每年評估簽證會計師之獨立性、適任性及績效，並將結果提報審計委員會及董事會通過。105年度績效評估經106年3月21日審計委員會及董事會審議通過。 獨立性指標項目包含簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利害關係、簽證會計師與本公司無重大密之商業關係及僱佣關係、簽證會計師無宣傳或中介本公司所發行之股票或其他證券等15項，績效指標項目則包含服務品質、專業程度及時效配合等項目。	
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V	本公司由總經理室負責公司治理相關事務，包括 1. 擬定及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。 2. 董事會會議之規劃及至少於會議7日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後20日內寄發董事會議事錄。 3. 每年依法辦理股東會事前登記，製作開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，並於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有發言人及代理發言人，作為利害關係人溝通管道，並於公司網站設置利害關係人專區，針對各項業務建立對應窗口，並由專人負責回應相關問題。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任元大證券為本公司專業之股務代理機構辦理各項股東會事務。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V V		(一)本公司已架設網站，提供財務業務相關資訊及公司治理資訊。 (二)本公司設有英文網站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。本公司自公開發行以來，依循主管機關及相關法令規定辦理各項資訊之公告及申報；股東均可於公開資訊觀測站或本公司網站查詢及知悉公司各項訊息及重大事項。本公司並確實落實發言人及其代理人制度。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V		(一)員工權益與僱員關懷：本公司一向重視勞資關係，並以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益；並透過各項員工福利制度及良好的教育訓練制度，與員工建立互信互賴之良好關係。 (二)投資者關係：透過公開資訊觀測站及公司網站充份揭露資訊，讓投資人充份瞭解公司營運狀況，並透過股東會及發言人與投資者溝通。 (三)供應商關係：本公司與供應商均保持良好互動的關係，並不定期進行稽核以確保供應商品質。 (四)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 (五)董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			識並依相關法令規範進修證券法規研習等課程，並符合進修時數之規定。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司一向以穩健的原則進行相關之風險管理，訂有相關內部規章及內部控制制度以防範各項風險，並由內部稽核單位定期及不定期的查核內部控制制度的落實程度。 (七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係並秉持客戶至上之政策，以創造公司利潤。 (八)為董事購買責任保險：本公司已為董事購買責任保險，以強化股東權益之保障，並揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 第三屆公司治理評鑑結果，本公司名列上櫃公司排名前20%，已改善及擬改善事項說明如下 (一)已改善事項 1. 於股東會開會前30日前完成上傳議事手冊及會議補充資料及英文版開會通知。 2. 於股東會開會前21日前完成上傳英文版議事手冊及會議補充資料。 3. 董事會定期評估簽證會計師之獨立性，並於年報揭露評估程序。 4. 同步申報英文重大訊息。 (二)擬改善事項，主要為加強公司官網之資訊 1. 將獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通之情形揭露於公司網站。 2. 於公司網站揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形。 3. 於公司網站揭露企業社會責任實施成效。			

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格		符合獨立性情形（註1）								兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 家數	備註 （註2）
		商務、法 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢 察官、律 師、會計 師或與其 他與公司 業務所需 之國家考 試及領有 證書之專 門職業技 術人員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 之工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	張俊彥	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	是
獨立董事	鄭繼雄			V	V	V	V	V	V	V	V	V	1	是
獨立董事	陳明璋	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	1	是

註1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第30條各款情事之一。

註2：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

2.薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：104年1月19日至107年1月18日，105年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人	鄭繼雄	4	0	100%	新任(103.09.02 選任) 連任(104.01.19 選任)
委員	張俊彥	3	1	75%	
委員	陳明璋	4	0	100%	
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

(五)履行社會責任情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、落實公司治理 (一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？ (二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？ (三) 公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？ (四) 公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	V V V V		(一)本公司已訂定「企業社會責任實務守則」，對於企業之社會責任、節能減碳、綠化等環境保護將持續推動。 (二)本公司每年依員工需求安排教育訓練，內容包含法律、管理、溝通協調、職場倫理、勞工安全及環保等課程。 (三)本公司由總經理室負責推動企業責任，各部門負責同仁各司其職，於日常營運活動中注意企業社會責任之履行。 (四)本公司依據勞基法規定並參酌同業薪資水準，訂定合理之薪資報酬政策，並有明確獎勵及懲罰制度。	無重大差異
二、發展永續環境 (一) 公司是否致力於提升各項資源之利用率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (三) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	V V V		(一)本公司致力提升對各項資源利用率，對報廢產品回收處理，以提升各項資源之利用效率。 (二)本公司已取得環境管理系統(ISO 14001:2015)及職業安全衛生管理系統(OHSAS 18001:2007)認證，並透過推廣環保概念、加強教育訓練、內部節能減碳、落實環境管理政策及設置勞工安全衛生管理單位，負責環境管理之環保問題、安全及衛生相關業務之推動與執行。 (三)公司依營運活動之影響，推動各項節能措施，降低公司營運對自然環境之衝擊。除加強製程之節能管控外，積極落實垃圾分類，資源回收工作，並已針對節能減碳及溫室氣體減量管理思維置入營運作業的核心以獲得永續經營策略。105年度實施節能減碳共減少二氧化碳排放32公噸，106年度將導入能源管理系統	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			(ISO50001:2011)、水足跡盤查(ISO14046:2014)、溫室氣體盤查(ISO14064:2006)、清潔生產查證等，另配合工研院執行106年度集團企業成立內部節能服務團(為期三年節能專案)。 本公司溫室氣體之主要排放來源是電力，因此電力使用之減量及能源效率之提升為公司目前首要之務。本公司藉由導入環境管理系統，推動各項節能改善措施，如廠區空調及冷卻水變頻控制、空調系統工程改善、省電照明光源更換等，以達到節能減碳的目標。 節水措施主要透過回收操作，包括拋光片清洗溢流水、LTO清洗溢流水送入軟水桶再製及調整圈邊機軸承冷卻水量等，預估可節省水量548CMD。
三、維護社會公益 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二) 公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？ (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ (四) 公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？ (五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (六) 公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V V V V V V		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(七) 對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	V		景。 (五)本公司提供多元化教育訓練及與職務有關之外派訓練課程，以增加員工專業能力及競爭力。
(八) 公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	V		(六)本公司訂有客訴處理作業程序，與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提供透明且有效之客訴處理程序。
(九) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V		(七)本公司對產品與服務之行銷及標示，已遵循本產業之相關法規及準則。 (八)本公司訂有供應商評鑑管理流程，並定期或不定期對供應商稽核。 (九)本公司針對供應商簽訂誠信經營守則規範，對於涉有違反企業社會責任之供應商，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約。
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	V		本公司架設網站，已指定專人定期揭露環境保護、節能減碳、永續能源等企業社會責任相關資訊。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定企業社會責任實務守則，公司業已致力於企業社會責任之推動，與所訂守則無重大差異。			本公司未來將適時評估於公司網站，揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：			
1.環保方面：推動環保低碳活動人人有責，本公司除加強製程之節能管控外，積極落實垃圾分類，資源回收工作，並推展節能減碳，投入節能減碳設備支出。			
2.105年度參與社會公益活動			
(1)參加園區圓夢計劃，捐贈103,000元之禮物給偏遠學校小學生206人。			
(2)捐贈月餅給弱勢團體共53盒。			
(3)定期舉辦捐血活動，捐血數量30,250cc。			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(4)贊助家扶基金會-扶幼半世紀之園遊會共10,000元。 (5)參與產業人物「送好書到偏鄉」活動，捐贈圖書給偏鄉學校，共50,000元。 3.消費者權益：客戶部份，公司內部訂有「客訴處理作業」，提供客戶訴怨管道，對外部份與客戶皆有簽訂供貨合約，品質合約等，對客戶權益有完善保障。 4.人權方面：本公司非常注重人權，不論其種族、性別、年齡皆享有同等的工作權利，亦提供個人自由表達和發展的機會，以達到尊重個人尊嚴。 5.安全衛生：本公司以零災害為目標，致力於安全衛生政策之推動並持續改善製程及作業環境，經由全體員工的共同努力，不斷提升職業安全衛生績效。 6.員工健康關懷：本公司定期為員工實施健康檢查，讓員工了解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的健康。在工作場所中，為掌握員工工作環境實態並評估危害因子暴露狀況，除了在適當地點設置偵測警報設備外，也定期實施作業環境檢測，以作為職場環境改善的依據。			
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：公司目前尚無編製企業社會責任報告書。			

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目	運作情形 (註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？	V		(一)本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，董事會及管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，公司於內部管理及商業活動中亦確實執行。
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	V		(二)本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為，並不定期向內部全體員工宣導誠信行為之重要性，內部稽核單位在日常查核時，對內部是否發生不誠信行為情事亦會列入查核重點的一部份，當遇員工有發生不誠信行為時，會視發生情節及影響的重大性，予以告誡或依據員工獎懲辦法懲戒。
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	V		(三)本公司已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，提供為公司經營重要事務人員的行為規範，並透過內部稽核單位的查核機制，防範不誠信行為之營業活動，行賄及收賄、提供非法政治獻金等情事發生。
二、落實誠信經營			
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		(一)本公司對往來之客戶及外包商均建立有評核機制，與其訂立合約時，對雙方的權利義務均詳訂其中，並簽立保密條款。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	V		(二)本公司推動企業誠信經營相關宣導及執行由總經理室負責，另稽核人員於日常稽核中執行，若有發現異常事項，可隨時向董事會報告。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)本公司已於工作規則明訂應有關利益迴避之相關獎懲，另董事會議事規範亦明訂董事於各項議案，有利益衝突時，應予迴避不參與討論。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計	V		

評 估 項 目	運 作 情 形 (註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(四)本公司已建有內部控制制度，並落實執行，且由內部稽核人員定期查核制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會；另本公司為確保制度之設計及執行持續有效，每年進行檢視及修訂作業，以建立良好公司治理與風險管控制度，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。 (五)本公司於新進員工教育訓練中向員工宣導誠信經營原則，並每年擬訂教育訓練計劃，課程包括公司治理、誠信經營等相關領域。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V V V		(一)本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，建置員工意見箱及電子郵件，並有專責單位處理相關事務，確有違反誠信經營規定者，將視情節輕重予以懲處。 (二)本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，建置員工意見箱及電子郵件，並有專責單位處理相關事務，對於檢舉人身分及檢舉內容將確實保密。 (三)本公司採專人受理檢舉事項，公司對於檢舉人身份及檢舉內容將確實保密，並積極查證與處理。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「誠信經營守則」，清楚規範公司人員應遵守之事項，另檢舉與懲處亦已明定於各相關辦法中，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。			無重大差異
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 1.本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。 2.本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞			

評 估 項 目	運作情形（註1）		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。			
3.本公司訂有「防範內線交易管理作業」，明訂董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。			

(七)公司如訂有公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂立「公司治理實務守則」，相關規章可於公開資訊觀測站及本公司網站之投資人專區查詢(<http://www.sas-globalwafers.com>)。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1.本公司網站：<http://www.sas-globalwafers.com> 投資人專區

2.董事進修情形

姓名	進修日期	主辦單位	進修課程	進修時數
徐秀蘭	105/05/05	中華公司治理協會	企業社會責任與永續經營	3
	105/11/08	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
	106/05/11	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
盧明光	105/05/05	中華公司治理協會	企業社會責任與永續經營	3
	105/05/06	中華公司治理協會	從上市櫃公司三大實務守則談企業經營	3
	106/05/11	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
姚宕梁	105/05/05	中華公司治理協會	企業社會責任與永續經營	3
	105/11/08	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
	106/05/11	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
陳國洲	105/05/05	中華公司治理協會	企業社會責任與永續經營	3
	105/11/08	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
	106/05/11	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
張俊彥	105/05/05	中華公司治理協會	企業社會責任與永續經營	3
	105/11/08	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
	106/05/11	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
鄭繼雄	105/01/26	財團法人中國民國證券暨期貨市場發展基金會	105 年度公司治理論壇系列－內線交易與企業社會責任	3
	105/05/05	中華公司治理協會	企業社會責任與永續經營	3

	105/11/08	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
	106/05/11	中華公司治理協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
陳明璋	105/04/15	中華公司治理協會	董監事如何閱讀 IFRS 財務報表、最新公司法修正與公司治理暨證券法規	6

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書

公開發行公司內部控制制度聲明書

表示設計及執行均有效

(本聲明書於遵循法令部分採全部法令均聲明時適用)

環球晶圓股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：106年3月21日

本公司民國一〇五年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國105年12月31日^{註2}的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國106年3月21日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

環球晶圓股份有限公司



董事長：徐秀蘭 簽章



總經理：Mark Lynn England 簽章



註1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存有重大缺失，應於內部控制制度聲明書中第四項後增列說明段，列舉並說明自行檢查所發現之重大缺失，以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善情形。

註2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1. 股東會重要決議

(1)105 年股東常會(105.06.22)重要決議及執行情形

重要決議	執行情形
1. 通過修訂本公司「公司章程」案	於 105 年 6 月 30 日經科技部新竹科學園區工業管理局准予登記，並公告於公司網站。
2. 通過本公司資本公積發放現金股利案	盈餘分派及資本公積發放現金股利案，已於 105 年 8 月 5 日完成現金股利發放作業。
3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	經股東會決議後，依新修訂後之相關辦法條文實施。
4. 承認一〇四年度決算表冊案	決議通過。
5. 承認一〇四年度盈餘分派案	盈餘分派及資本公積發放現金股利案，已於 105 年 8 月 5 日完成現金股利發放作業。

(2)106 年第一次股東臨時會(106.02.20)重要決議及執行情形

重要決議	執行情形
1. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案	經股東會決議後，依新修訂後之相關辦法條文實施。
2. 通過修訂本公司「背書保證辦法」案	經股東會決議後，依新修訂後之相關辦法條文實施。
3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	經股東會決議後，依新修訂後之相關辦法條文實施。
4. 通過辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	已依決議辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證，並於 106 年 4 月 26 日募集完成。

2. 董事會重要決議

日期	重要決議
105.02.16	1. 擬設立新加坡子公司案 2. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案
105.03.17	1. 本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 本公司民國一〇四年度決算表冊案 3. 本公司一〇四年度盈餘分派案 4. 本公司資本公積發放現金股利案 5. 擬訂定 105 年股東常會召開議程及相關事宜案 6. 105 年股東常會受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項案 7. 修訂本公司「環球晶圓對子公司之監理辦法」案 8. 訂定本公司「會計師獨立性及績效評估辦法」案 9. 一〇四年度「內部控制制度聲明書」案 10. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案
105.05.03	1. 本公司購買海外資產案

日期	重要決議
	2. 本公司 104 年度經理人員工酬勞分配案 3. 本公司一〇五年度第一季合併財務報告案
105.05.20	1. 本公司收購 Topsil 半導體業務資產案
105.06.17	1. 本公司購買 Topsil Semiconductor Materials A/S 公司資產案，因情勢變化，擬提高收購價格
105.07.01	1. 資金貸與子公司 Topsil GlobalWafers A/S 案
105.08.04	1. 金融機構提供授信額度案 2. 本公司向銀行申請擔保履約保證額度 3. 委任本公司新任經理人暨經理人升等薪酬案 4. 本公司一〇五年度第二季合併財務報告案
105.08.18	1. 本公司暨新加坡子公司 GWAVERS SINGAPORE PTE LTD 擬購併 SunEdison Semiconductor Limited (以下簡稱 SEMI) 公司案 2. 配合 SEMI 公司案，擬辦理匯率及利率避險案
105.10.11	1. 新加坡子公司 GWAVERS SINGAPORE PTE LTD 增資案
105.11.03	1. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 2. 為子公司 GlobalWafers Japan Co., Ltd. 向銀行申請授信額度，由本公司出具保證函(LOG)案 3. 為子公司 Globitech Incorporated 向銀行申請授信額度，由本公司出具支持函(LOS)案 4. 修訂本公司績效管理辦法案 5. 一〇六年度內部稽核計劃案 6. 本公司一〇五年度第三季合併財務報告案
105.11.24	1. 擬修訂本公司背書保證辦法案 2. 資金貸與子公司 GWAVERS SINGAPORE PTE LTD 案 3. 資金貸與 SUNEDISON SEMICONDUCTOR B. V. 案 4. 為提昇集團管理綜效及尋找上中下游整合策略投資標的，本公司擬與其他投資人合資成立新公司案 5. 為聯貸案之需要，擬出具反面承諾書 6. 向銀行申請授信額度案 7. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案
105.12.30	1. 本公司擬於不超過 1.1 億股辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 2. 本公司擬於明(106)年 2 月 20 日召開 106 年第一次股東臨時會案 3. 資金貸與子公司 Topsil GlobalWafers A/S 之資金貸與額度調整案 4. 資金貸與子公司 SUNEDISON SEMICONDUCTOR B. V. 之資金貸與額度調整案 5. 取消資金貸與子公司 GWAVERS SINGAPORE PTE. LTD. 案 6. 本公司擬向孫公司 SunEdison Semiconductor Limited(Singapore) 購買專利權及商標權案 7. 為子公司 SUNEDISON SEMICONDUCTOR B. V. 融資授信擔任保證人案
106.01.17	1. 擬訂本公司 106 年度營運計劃案 2. 本公司 105 年度會計師簽證公費案 3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

日期	重要決議
	5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 6. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案
106.02.24	1. 新加坡子公司 GWAFERS SINGAPORE PTE LTD 增資 3.5 億美元案
106.03.21	1. 本公司一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 本公司民國一〇五年度決算表冊案 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4. 擬訂定 106 年股東常會召開議程及相關事宜案 5. 106 年股東常會受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項案 6. 擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 7. 本公司擬參與基金投資案 8. 一〇五年度「內部控制制度聲明書」案 9. 為子公司 SunEdison Semiconductor, LLC 向銀行申請授信額度 10. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 11. 子公司董監事及總經理派任案 12. 配合會計師事務所業務調整，變更本公司簽證會計師案 13. 變更本公司發言人案 14. 本公司新任經理人薪資暨經理人薪資調整案
106.05.09	1. 本公司一〇五年度盈餘分派案 2. 本公司資本公積發放現金股利案 3. 擬訂定 106 年股東常會召開議程及相關事宜案
106.05.11	1. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 2. 本公司一〇六年度第一季合併財務報告案

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

四、會計師公費資訊：公司有下列情事之一者，應揭露會計師公費

(一)會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺	黃泳華	105.01.01~105.12.31	

金額級距 \ 公費項目		審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元		√	
2	2,000 千元（含）~4,000 千元			
3	4,000 千元（含）~6,000 千元			
4	6,000 千元（含）~8,000 千元			
5	8,000 千元（含）~10,000 千元			
6	10,000 千元（含）以上	√		√

(二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費 (註 1)	非審計公費					會計師查核期間	備 註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他 (註 2)	小 計		
安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺	12,060	0	0	0	630	630	105.01.01 至 105.12.31	其他係移轉定價簽證費
	黃泳華								

註 1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

註 2：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25%者，應於備註欄列示其服務內容。

(三)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

(四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊

本公司最近二年度更換簽證會計師係安侯建業聯合會計師事務所內部組織調整及業務調度，並無更換簽證會計師事務所。

六、公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓 名	105 年度		106 年度截至 4 月 21 日止		備註
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	
董事長	徐秀蘭	—	—	—	—	
董事	中美矽晶製品 (股)公司	(24,000,000)	—	—	—	
	代表人：盧明光	—	—	—	—	
	代表人：姚宕梁	(90,000)	—	(9,000)	—	
董事	陳國洲	—	—	—	—	104.1.19 就任
獨立董事	鄭繼雄	—	—	—	—	104.1.19 就任
獨立董事	張俊彥	—	—	—	—	104.1.19 就任
獨立董事	陳明璋	—	—	—	—	104.1.19 就任
總經理	Mark Lynn England	—	—	—	—	103.10.1 就任 總經理
經理人	徐文慶	(8,000)	—	(12,000)	—	103.9.2 就任
經理人	陳偉文	(250,000)	—	—	—	103.9.2 就任
經理人	洪聖雄	—	—	—	—	103.9.2 就任
經理人	周靜文	—	—	—	—	105.7.1 就任
經理人	李崇偉	—	—	—	—	106.3.21 就任
財務處長	簡明輝	—	—	—	—	103.9.2 就任
會計經理	徐秀鈴	—	—	—	—	103.9.2 就任

註：係揭露在任時持股變動情形。

(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：

單位：股

姓 名	股權移轉 原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董 事、監察人及持股比例 超過百分之十股東之關 係	股 數	交 易 價 格
陳偉文	贈與	105.12.27	徐貞華	無	250,000	-

(三)股權質押相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

單位：股；%；106 年 4 月 21 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
中美矽晶製品股份有限公司	222,293,000	60.20%	—	—	—	—	中華開發資本股份有限公司	其轉投資公司新能光電科技(股)之法人董事	
花旗託管新加坡政府投資專戶	13,375,380	3.62%	—	—	—	—	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達	8,236,000	2.23%	—	—	—	—	無	無	
新制勞工退休基金	7,222,500	1.96%	—	—	—	—	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管富達核心投資組合有限公司：	7,110,000	1.93%	—	—	—	—	無	無	
臺銀保管富達投資信託富達系列新興市場戶	7,066,000	1.91%	—	—	—	—	無	無	
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶	6,632,004	1.80%	—	—	—	—	無	無	
花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡金融管理局——委託經理人新加坡政府投資有限公司操作投資專戶投資專戶	4,539,334	1.23%	—	—	—	—	無	無	
舊制勞工退休基金	3,144,500	0.85%	—	—	—	—	無	無	
中華開發資本股份有限公司	2,918,072	0.79%	—	—	—	—	中美矽晶製品(股)有限公司	中美矽晶轉投資公司新能光電科技(股)之法人董事	

九、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資之持股數，
並合併計算綜合持股比例：

105 年 12 月 31 日

單位：仟股；%

轉投資事業(註 1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
GlobalWafers Inc.	90,000	100.00%	-	-	90,000	100.00%
GlobalSemiconductor Inc.	25,000	100.00%	-	-	25,000	100.00%
GWafers Inc.	(註 2)	100.00%	-	-	(註 2)	100.00%
GWafers Singapore Pte. Ltd.	550,000	100.00%	-	-	550,000	100.00%
Topsil GlobalWafers A/S	1,000	100.00%	-	-	1,000	100.00%
GlobiTech Incorporated.	1	100.00%	-	-	1	100.00%
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	128	100.00%	-	-	128	100.00%
昆山中辰矽晶有限公司	(註 2)	100.00%	-	-	(註 2)	100.00%
上海葛羅禾半導體科技有限公司	-	-	(註 2)	60.00%	(註 2)	60.00%
Topsil Semiconductor sp z o.o.	-	-	1	100.00%	1	100.00%
SunEdison Semiconductor Limited	-	-	42,392	100.00%	42,392	100.00%
SunEdison Semiconductor B.V.	-	-	0.1	100.00%	0.1	100.00%
SunEdison Semiconductor Technology Pte Ltd.	-	-	0.001	100.00%	0.001	100.00%
MEMC Japan Ltd.	-	-	-	100.00%	-	100.00%
MEMC Electronic Materials, SpA	-	-	65,000	100.00%	65,000	100.00%
MEMC Electronic Materials France SarL	-	-	0.5	100.00%	0.5	100.00%
MEMC Electronic Materials GmbH	-	-	0.002	100.00%	0.002	100.00%
MEMC Holding B.V.	-	-	0.2	100.00%	0.2	100.00%
MEMC Korea Company	-	-	17,200	100.00%	17,200	100.00%
SunEdison Semiconductor LLC	-	-	1	100.00%	1	100.00%
MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd	-	-	1,036	100.00%	1,036	100.00%
SunEdison Semiconductor Technology (Shanghai) Ltd	-	-	(註 2)	100.00%	(註 2)	100.00%
SunEdison Semiconductor Holdings B.V.	-	-	0.1	100.00%	0.1	100.00%
Taisil Electronic Materials Corp.	-	-	459,816	99.96%	459,816	99.96%
MEMC Ipoh Sdn Bhd	-	-	699,374	100.00%	699,374	100.00%

註 1：係公司採用權益法之投資。

註 2：為有限公司，故無股數。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.已發行股份種類

106年5月31日；單位：股

股 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名普通股	437,250,000	162,750,000	600,000,000	該股票係屬上櫃股票

2.股本形成經過

106年5月31日；單位：新台幣元；股

年 月	發行 價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以 外之財產 抵充股款 者	其 他
100/10	10	300,000,000	3,000,000,000	180,000,000	1,800,000,000	設立資本 1,800,000 仟元	無	註 1
101/05	10	400,000,000	4,000,000,000	317,500,000	3,175,000,000	現金增資 1,375,000,000	無	註 2
104/01	10	400,000,000	4,000,000,000	349,250,000	3,492,500,000	現金增資 317,500,000	無	註 3
104/09	10	400,000,000	4,000,000,000	369,250,000	3,692,500,000	現金增資 200,000,000	無	註 4
106/05	10	600,000,000	6,000,000,000	437,250,000	4,732,500,000	現金增資 680,000,000	無	註 5

註 1：科學工業園區管理局 100 年 10 月 18 日園商字第 1000030345 號核准函。

註 2：科學工業園區管理局 101 年 05 月 16 日園商字第 1010014266 號核准函。

註 3：科學工業園區管理局 104 年 02 月 25 日竹商字第 1040005439 號核准函。

註 4：科學工業園區管理局 104 年 10 月 15 日竹商字第 1040029649 號核准函。

註 5：科學工業園區管理局 106 年 05 月 17 日竹商字第 1060012613 號核准函。

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構

1.股東結構表

106年4月21日；單位：人；股；%

股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及 外國人	合計
人數	5	108	71	9,837	152	10,173
持有股數	12,093,000	19,642,556	231,089,083	28,123,246	78,302,115	369,250,000
持有比率	3.28%	5.32%	62.58%	7.62%	21.20%	100%

(三)股權分散情形

106年4月21日；單位：人；股；%

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999	4,737	720,534	0.20%
1,000 至 5,000	4,484	7,421,023	2.01%
5,001 至 10,000	335	2,682,507	0.73%
10,001 至 15,000	123	1,577,549	0.43%
15,001 至 20,000	85	1,537,493	0.42%
20,001 至 30,000	82	2,103,349	0.57%
30,001 至 50,000	78	3,134,952	0.85%
50,001 至 100,000	92	6,784,304	1.84%
100,001 至 200,000	61	8,790,815	2.38%
200,001 至 400,000	43	11,682,827	3.16%
400,001 至 600,000	18	9,395,544	2.54%
600,001 至 800,000	7	5,064,423	1.37%
800,001 至 1,000,000	7	6,221,774	1.68%
1,000,001 股以上	21	302,132,906	81.82%
合 計	10,173	369,250,000	100%

(四)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

106 年 4 月 21 日；單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
中美矽晶製品股份有限公司		222,293,000	60.20%
花旗託管新加坡政府投資專戶		13,375,380	3.62%
渣打國際商業銀行營業部受託保管富達精選投資組合－科技投資組合投資專戶		8,236,000	2.23%
新制勞工退休基金		7,222,500	1.96%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管富達核心投資組合有限公司：富達資訊科技核心基金投資專戶		7,111,000	1.93%
臺銀保管富達投資信託富達系列新興市場戶		7,066,000	1.91%
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶		6,632,004	1.80%
花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡金融管理局－委託經理人新加坡政府投資有限公司操作投資專戶投資專戶		4,539,334	1.23%
舊制勞工退休基金		3,144,500	0.85%
中華開發資本股份有限公司		2,918,072	0.79%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位：新台幣元；仟股

項	年		104 年度	105 年度	106 年截至 3 月 31 日
	目	度			
每股市價	最	高	84.4	122.5	240.5
	最	低	64.8	63.2	108.0
	平	均	74.64	90.79	177.72
每股淨值	分	配	前	45.29	42.84
	分	配	後	40.29	註 1
每股盈餘	加 權 平 均 股 數		352,239	369,250	369,250
	每股	追溯調整前	5.80	2.54	0.95
	盈餘	追溯調整後	5.80	2.54	0.95
每股股利	現金股利		5.0	註 1	—
	無償 配股	盈餘配股	—	—	—
		資本公積配股	—	—	—
	累積未付股利		—	—	—
投資報酬 分析	本益比		12.87	35.74	—
	本利比		14.93	註 1	—
	現金股利殖利率		6.70%	註 1	—

註 1：截至刊印日止，105 年盈餘分派案尚未經股東會決議通過。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

依據本公司之章程規定，本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配之：

- (1)彌補虧損。
- (2)提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- (3)依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- (4)當年度盈餘扣除上列一至三項後，如尚有盈餘併同以前年度未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，提請股東常會決議分派之。

本公司為維持公司永續經營發展及每股盈餘之穩定成長，股東股利以當年度稅後盈餘扣除當年度依法應提列特別盈餘公積後之百分之五十以上為原則，分配比率為現金股利不低於百分之五十。

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。董事酬勞以現金方式分派，員工酬勞以股票或現金方式分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2.本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 105 年度盈餘分配案，業經 106 年 5 月 9 日董事會決議，尚待 106 年股東常會決議通過，擬議配發現金股利每股新台幣 1.7587 元，並另以資本公積配發現金股利，擬配發現金股利每股新台幣 0.7413 元，總計配發每股新台幣 2.5 元，共計新台幣 1,093,125,000 元。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(八)員工酬勞及董事酬勞：

1.公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

請詳上述(六)1.股利政策之說明。

2.本期估列員工酬及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

- (1)本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：依公司章程規定估列。
- (2)本期以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：員工酬勞若以股票分派之股數計算基礎係依據最近一期會計師查核之財務報告淨值為計算基礎，本期並無以股票分派員工酬勞情形。

(3)本期實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：股東會決議與估列數如有差異，視為估計變動，列為當期損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於106年3月21日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞如下：

員工酬勞：新台幣41,400仟元，全數以現金發放。

董事酬勞：新台幣3,500仟元，全數以現金發放。

員工酬勞及董事酬勞實際配發情形與105年度財務報表認列數並無差異。

(2)擬議以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情形。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司104年度盈餘分配經105年3月17日董事會擬議及105年6月22日股東會決議配發如下

單位：元

項目	股東會決議配發	董事會擬議配發	差異數	差異說明
員工現金紅利	73,870,000	73,870,000	無	不適用
董監酬勞	5,000,000	5,000,000	無	不適用

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：

106 年 5 月 31 日

項 目 \ 發行日期	106 年 4 月 26 日
發 行 日 期	106 年 4 月 26 日
發 行 及 交 易 地 點	盧森堡證券交易所
發 行 總 金 額	USD 469,200,000 元
單 位 發 行 價 格	每單位海外存託憑證交易價格為 6.9 美元
發 行 單 位 總 數	68,000,000 單位
表 彰 有 價 證 券 之 來 源	環球晶圓股份有限公司普通股
表 彰 有 價 證 券 之 數 額	68,000,000 股
存 託 憑 證 持 有 人 之 權 利 與 義 務	海外存託憑證持有人之權利義務，應依中華民國相關法令及存託契約有關規定辦理。存託契約主要約定事項如下： (一)表決權之行使 除法令另有規定外，海外存託憑證持有人得依存託契約及中華民國法令規定，行使其海外存託憑證所表彰之環球晶圓普通股之表決權。 (二)股利分配、新股優先認購權及其他權益 除存託契約另有規定外，海外存託憑證持有人原則上享有與環球晶圓普通股股東同等之股利分派及其他配股權利。如環球晶圓未來發放股票股利事宜時，存託機構將依存託契約及相關法律之規定，按海外存託憑證持有人原持有單位數比例增發海外存託憑證予海外存託憑證持有人，或提高每單位海外存託憑證所表彰之環球晶圓普通股，或代海外存託憑證持有人出售該股票股利，並將出售所得之金額(扣除稅賦及相關費用後)按比例分配予海外存託憑證持有人。 環球晶圓辦理現金增資或其他認股權時，海外存託憑證持有人在符合中華民國及其他相關法令之情形下原則上享有與環球晶圓普通股股東同等之新股優先認股權利，存託機構應於存託契約及相關法律許可之範圍內，按存託契約之規定，提供海外存託憑證持有人該等權利，或代海外存託憑證持有人出售此權利，並將出售所得之價金(扣除稅賦及相關費用後)按比例分配予海外存託憑證持有人。
受 託 人	不適用
存 託 機 構	CitiBank, N.A.
保 管 機 構	第一商業銀行
未 兌 回 餘 額	7,043,456 單位
發 行 及 存 續 期 間 相 關 費 用 之 分 攤 方 式	(一)海外存託憑證發行相關費用 除法令另有規定或發行公司與國外主辦承銷商及存託機構另有約定外，所有海外存託憑證之發行成本及費用，包括法律費用、上市掛牌費用、財務顧問費用及其他相關費用及支出，均由發行公司負擔。 (二)海外存託憑證存續期間之費用 海外存託憑證存續期間之各年度上市費用、資訊揭露及其他相關費用，除法令另有規定外或發行公司與國外主辦承銷商及存託機構另有約定外，皆由發行公司負擔。
存 託 契 約 及 保 管 契 約 之 重 要 約 定 事 項	-

每單位市價	105 年	最 高	NA
		最 低	NA
		平 均	NA
	當 年 度 截 至 106 年 5 月 31 日	最 高	USD 8.081
		最 低	USD 6.900
		平 均	USD 7.588

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)106 年度現金增資參與發行海外存託憑證

1.計畫內容

(1)主管機關核准日期及文號：106 年 4 月 17 日金管證發字第 1060010513 號。

(2)本次計畫所需資金總額：新台幣 13,860,000 仟元。

(3)資金來源：現金增資發行新股參與海外存託憑證 68,000 仟股，實際每股發行價格美金 6.9 元(約折合新台幣 210 元)，實際總金額為美金 469,200 仟元(約折合新台幣 14,277,756 仟元)。惟若募集資金增加時，則將持續用於償還銀行借款。

(4)計畫項目及資金運用進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成 日 期	所需資金總額		預定資金運用進度
				106 年度第二季
償還銀行借款	106 年度 第二季	美元	237,000	237,000
		折約新台幣	7,350,000	7,350,000
轉投資海外子公司	106 年度 第二季	美元	210,000	210,000
		折約新台幣	6,510,000	6,510,000
合 計		美元	447,000	447,000
		新台幣	13,860,000	13,860,000

(5)變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入證期局指定資訊申報網站之日期：不適用。

2.執行情形

本公司於 106 年現金增資參與發行海外存託憑證已於 106 年 4 月 26 日募集完成，總募集資金為美金 469,200 仟元，其執行情形及預計相關效益將於 106 年第二季才會顯現。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1.所營業務之主要內容

CC01080 電子零組件製造業

F401010 國際貿易業

一、研發、設計、製造及銷售半導體矽晶材料及其元件。

二、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

年度 產品項目	104 年度		105 年度	
	營業收入淨額	比重(%)	營業收入淨額	比重(%)
半導體晶錠產品	1,177,490	7.69%	167,912	0.91%
半導體晶片產品	13,614,573	88.92%	17,850,126	96.87%
其他	518,399	3.39%	408,912	2.22%
合計	15,310,462	100.00%	18,426,950	100.00%

3.目前之商品項目

- A、超低電阻重摻紅磷晶棒
- B、超低電阻重摻砷晶棒
- C、超低電阻重摻硼晶棒
- D、超低含氧量 MCZ 晶棒
- E、拋光晶圓及磊晶晶圓
- F、退火晶圓
- G、非拋光晶圓及超薄晶圓
- H、MEMS 用超平坦晶圓
- I、高亮度浸蝕晶圓
- J、SOI 晶圓及高功率電力電子接合晶圓
- K、擴散晶圓及深擴散拋光晶圓
- L、GaN_HEMT 磊晶用高強度矽基板
- M、超重摻硼電阻 $<1.0\text{m}\Omega\text{-cm}$ 晶圓
- N、FZ 矽晶圓
- O、中子照射超純矽晶圓
- P、Perfect Silicon

4.計畫開發之新商品

- A、超重摻紅磷電阻 $<0.9\text{m}\Omega\text{-cm}$ 晶圓
- B、超重摻砷電阻 $<1.8\text{ m}\Omega\text{-cm}$ 晶圓
- C、次世代高功率車用電子元件用碳化矽晶圓

- D、GaN_HENT 用磊晶晶圓
- E、高強度超薄奈米化半導體矽晶圓
- F、超高解析度光學感測元件用晶圓
- G、次世代 RF 元件用 SOI 晶圓
- H、7 奈米製程用矽晶圓

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

根據 TSIA 於今年 Q1 出據之報告指出，國際半導體產業協會(SEMI)公布發佈最新「全球晶圓廠預測報告」(World Fab Forecast)，指出 2017 年晶圓廠設備支出將超過 460 億美元，創下歷年新高，並預計 2018 年支出金額將達 500 億美元，突破 2017 年新高點。晶圓廠設備支出金額不僅持續創新紀錄，也可望連從 2016 年至 2018 年呈現連續三年的成長趨勢，且為 1990 年代中期以來首見。

SEMI「全球晶圓廠預測」報告於 2017 年 2 月底的更新資料指出，2017 年有 282 座晶圓廠及生產線進行設備投資，其中有 11 座支出金額都超過 10 億美元。同時 2018 年預計有 270 座廠房有相關設備投資，其中 12 座支出超過 10 億美元。該項支出主要集中於 3D NAND、DRAM、晶圓代工及微處理器 (MPU)。其他支出較多的產品分布涵蓋 LED 與功率分離式元件、邏輯、MEMS (MEMS/RF) 與類比／混合訊號。

SEMI 預估，雖中國許多新晶圓廠計畫仍處於興建階段，2017 年大陸設備支出大致持平，成長約 1%，並為全球支出金額排名第三的地區。2017 年中國總計有 14 座晶圓廠正在興建，並將於 2018 年開始裝機。2018 年中國晶圓設備支出總金額將逾 100 億美元，成長超過 55%，全年支出金額位居全球第二。總計 2017 年中國將有 48 座晶圓廠有設備投資，支出金額達 67 億美元。展望 2018 年，SEMI 預估中國將有 49 座晶圓廠有設備投資，支出金額約 100 億美元。

其他地區亦正向成長，SEMI「全球晶圓廠預測」報告指出，歐洲／中東與韓國將成為今年成長最快的地區，預估年成長率分別為 47%與 45%。日本支出金額將增加 28%，其次為年增 21%的美洲地區。

SEMI 公布最新 Billing Report (出貨報告)，2017 年 3 月北美半導體設備製造商出貨金額為 20.3 億美元。與上個月 19.7 億美元相比，成長 2.6%，同時相較於去年同期 12 億美元，成長 69.2%。SEMI 表示，上個月出貨量是自 2001 年 3 月以來首次出現的強勁水準，顯示半導體設備出貨正受益於近期製造商的投資循環。

2. 全球半導體市場需求

A.1 根據 WSTS 統計，17Q1 全球半導體市場銷售值達 926 億美元，較上季(16Q4)衰退 0.4%，較去年同期(16Q1)成長 18.1%；銷售量達 2,208 億顆，較上季(16Q4) 成長 1.4%，較去年同期(16Q1)成長 15.7%；ASP 為 0.419 美元，較上

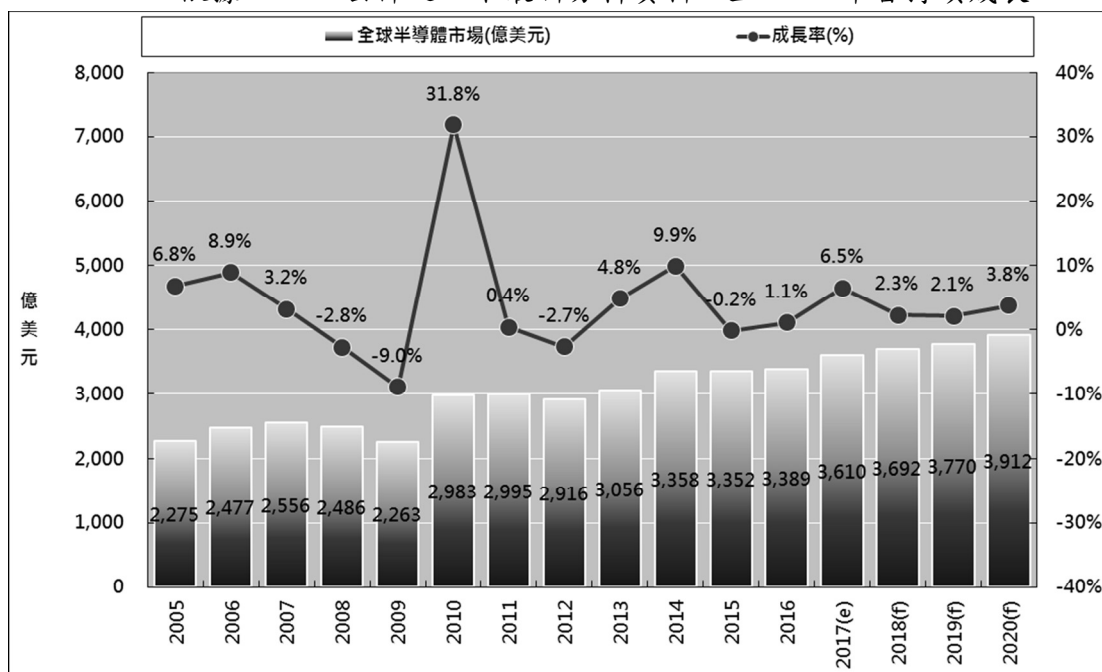
季(16Q4)衰退 1.8%，較去年同期(16Q1) 成長 2.0%。

A.2 2016 年全球半導體市場全年總銷售值達 3,389 億美元，較 2015 年成長 1.1%；2016 年總銷售量達 8,241 億顆，較 2015 年成長 4.7%；2016 年 ASP 為 0.411 美元，較 2015 年衰退 3.4%。

A.3 17Q1 美國半導體市場銷售值達 179 億美元，較上季(16Q4) 成長 11.3%，較去年同期(16Q1) 成長 10.1%；日本半導體市場銷售值達 86 億美元，較上季(16Q4) 成長 1.2%，較去年同期(16Q1) 成長 10.5%；歐洲半導體市場銷售值達 89 億美元，較上季(16Q4) 成長 1.7%，較去年同期(16Q1) 成長 1.3%；亞洲區半導體市場銷售值達 573 億美元，較上季(16Q4) 成長 0.3%，較去年同期(16Q1) 成長 19.3%。其中，中國大陸市場 302 億美元，較上季(16Q4)衰退 0.9%，較去年同期(16Q1)成長 26.7%。

A.4 2016 年美國半導體市場總銷售值達 655 億美元，較 2015 年衰退 4.7%；日本半導體市場銷售值達 323 億美元，較 2015 年成長 3.8%；歐洲半導體市場銷售值達 327 億美元，較 2015 年衰退 4.5%；亞洲區半導體市場銷售值達 2,084 億美元，較 2015 年成長 3.6%。2016 年全球半導體市場全年總銷售值達 3,389 億美元，較 2015 年成長 1.1%。

依據 WSTS 公佈之以下最新分析資料，至 2020 年皆持續成長。



資料來源：WSTS；工研院 IEK(2017/05)

B. 矽晶圓產業概況

半導體製造流程係包括 IC 設計、IC 晶圓製造、IC 封裝、IC 測試等階段，依上、中、下游來劃分半導體產業整體結構，IC 設計應屬半導體上游產業、

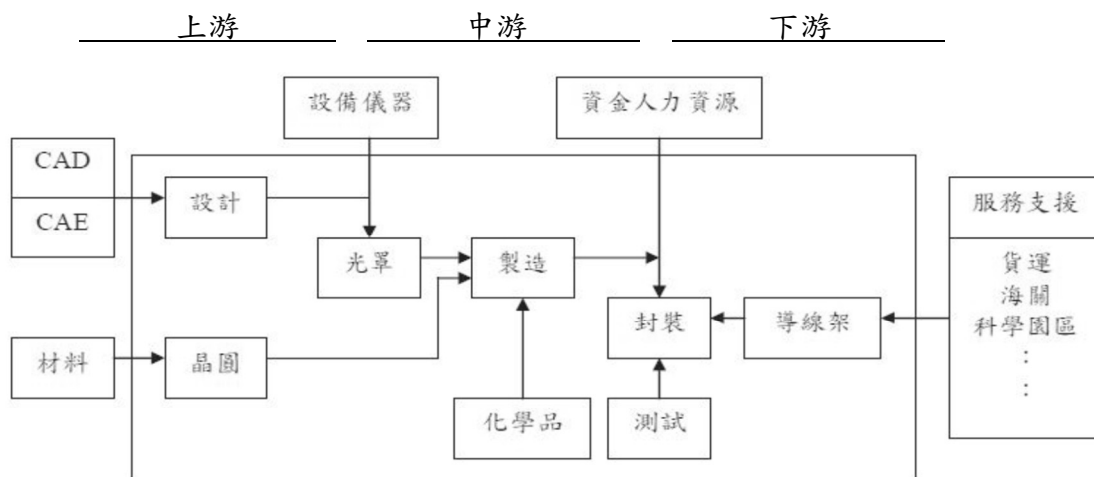
IC晶圓製造則屬中游產業；IC封裝、IC測試則屬下游產業。矽晶圓製造業於整個半導體產業架構中係擔任晶圓材料供應者角色，隨著半導體產業的蓬勃發展，對矽晶圓材料之需求亦急速增加。

矽晶圓為目前製作積體電路之基底材料，其原始材料「矽」，是地殼表面取之不盡、用之不竭的二氧化矽礦石，經由電弧爐提煉、鹽酸氯化及蒸餾處理後，製成高純度的多晶矽，其純度要求達99.999999999%。矽晶圓製造廠將此多晶矽加熱融解，並於熔融液摻入一小粒的矽晶體晶種，將其緩慢地拉出成形，讓多晶矽被拉成不同直徑大小的單晶矽晶棒，因矽晶棒是由一顆小晶粒在熔融態的矽原料中逐漸生成，此過程稱為「長晶」。矽晶棒再經過切割、研磨、拋光、切片等加工製程，即可成為積體電路產業之重要原料—「矽晶圓」。每塊數英吋直徑大小的空白矽晶圓，經過複雜的化學和電子製程後，可佈設多層精細的電子電路，而依面積大小有3吋、4吋、5吋、6吋、8吋及12吋(直徑)等規格之分，這些矽晶圓經送至晶圓廠內製造晶片電路後，再經切割、測試、封裝等程序，即成為市面上一顆顆的IC。

目前半導體產業所使用之矽晶圓材料，依其製程設計和產品差異主要分為拋光晶圓(polished wafer)及磊晶晶圓(epitaxial wafer)兩種，其均由高純度電子級多晶矽經由長晶(crystal pulling)、切片(slicing)、磨邊(beveling)、磨面(lapping)、蝕刻(etching)、拋光(polishing)、清洗(cleaning)等步驟，而生成一符合電性、表面物性、雜質標準等規格的拋光晶圓，拋光晶圓如果再經由化學氣相沉積反應，成長一層不同電阻率的單晶薄膜，就成為磊晶晶圓，由於磊晶晶圓擁有更佳的表面特性，被廣泛應用在各種分離式元件及高性能積體電路。

3. 產業上、中、下游之關聯性

台灣半導體產業隨著整體半導體的垂直分工整合的趨勢演進，依製造流程可區分為上游之IC設計公司(IC Design)與矽晶圓製造公司，由IC設計公司依客戶的需求設計出電路圖，矽晶圓製造公司則以多晶矽為原料製造出矽晶圓；中游之IC晶圓製造廠(IC Manufacturing and Foundry)則依IC設計公司設計好之電路圖在矽晶圓製造公司製造好的晶圓上，以光罩印上電路基本圖樣，再以氧化、擴散、CVD、蝕刻、離子植入等方法，將電路及電路上的元件，在晶圓上製作出來；而完成後之晶圓再送往下游之IC封裝、測試廠(IC Assembly and Testing)，將加工完成的晶圓，經切割過後的晶粒，以塑膠、陶瓷或金屬包覆，保護晶粒以免受汙染且易於裝配，並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果，最後進行IC功能、電性與散熱等測試。近年來由於台灣IC產業蓬勃發展及分工體系走向專業化，每一個生產環節皆有許多個別廠商投入，垂直分工明確且各有專精，使台灣IC產業之上、中、下游結構更加完整。茲將本公司所屬產業之上、中、下游之關聯性圖示如下：



資料來源：工研院電子所 ITIS 計畫

4. 產業發展趨勢

TSIA 之最新報告涵蓋以下發展狀況：

- A. 國際貨幣基金組織(IMF)公佈了 2017 年世界經濟展望(World Economic Outlook)，將 2017 年全球經濟成長預期從 3.4%上調至 3.5%，預測 2018 年全球經濟成長率為 3.6%。IMF 認為，儘管全球經濟成長趨勢正在加強，但戰後全球經濟體系仍面臨嚴重壓力。
- B. 歐洲央行 (ECB) 27 日決議維持現行政策不變，但總裁德拉基改變對經濟風險的評論，他說明成長展望雖面臨下行風險，還多了一句「朝向較平衡的格局移動」。德拉基說，數據顯示歐元區趨向循環復甦，「歐元區成長的風險仍傾向於下降，但正朝較平衡的格局移動。經濟擴張將持續堅穩且更加廣泛，國外需求也將持續增加，使歐元區經濟擴張更具韌性」。
- C. 高盛在最新的報告中表示，當前的美國經濟復甦已持續 95 個月，為 1854 年來 33 次美國景氣循環史上第三長。隨著美國已達充分就業和經濟成長高於平均水平，中期衰退的風險正在攀升。估計，美國經濟未來幾季步入衰退的機率已增加至 31%，但這可能需要美聯儲進行比目前市場預期更緊縮的貨幣政策，從而導致產出和就業市場的緩增。美國首季 GDP 僅成長 0.7%，但部分經濟學家已預期第二季可能成長 3%，市場對美國經濟的看法仍然樂觀。
- D. 日本最新經濟報告顯示，受惠高企業獲利與公共支出成長，日本經濟出現戰後以來第三長時間的復甦，但由於一般民眾的薪資成長很緩慢，導致一般人很難察覺景氣在好轉當中。但經濟學家認為日本未來的潛在經濟成長率可能仍會下滑，反應日本中期經濟改善能力不足，日本內閣估計 2016 年經濟成長率為 0.8%。未來人口萎縮將限縮勞動力規模，讓日本企業不願意在國內投資，被認為是日本走向強勁復甦的最大阻礙。
- E. 最近在國際市場復甦的同時，中國經濟卻表現不佳，股市連續下跌、製造業和進出口數據均低於預期。國際分析人士認為，目前全球經濟仍然面臨風險，

其中中國經濟的風險位列榜首。中國製造業採購經理人指數(PMI)降至 50.3，逼近 50 枯榮線，創 7 個月新低，相比 3 月份下降了 0.9，其中的產出和新訂單指數都出現明顯下滑。富國銀行投資機構首席國際投資策略師 Paul Christopher 分析，中共一向以穩定為主，很可能以經濟增速放緩來維持穩定。

- F. 韓國第 1 季度國民生產總值(GNP)月增率 0.9%，創下近年最新紀錄，優於市場預期，預計全年成長率有望超過 2.6%。雖然韓圓今年升值近 6%，但在進出口數據方面，也雙雙表現亮眼。4 月份的對外出口年增率成長 24.2%，創下 2014 年 10 月份以來第二高之紀錄，進口年增率成長 16.6%，貿易收支實現 133 億美元順差，連續 63 個月保持順差。另外，韓國各經濟預測機構也紛紛上調經濟成長率預期，其中韓國金融研究院公布最新報告，將今年經濟成長率由原本 2.5%調升至 2.8%。
- G. 博鰲亞洲論壇發佈《新興經濟體發展 2017 年度報告》，預計今(2017)年新興經濟體的經濟成長可望加速；整體而言，預計今年 E11(新興 11 國，E11 是指二十國集團(G20)中的 11 個新興經濟體，即阿根廷、巴西、中國、印度、印尼、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非和土耳其。)的 GDP 成長率將保持在 4.5%左右。今年 E11 經濟成長可望加速，但仍將面臨各種風險和挑戰，例如勞動生產率增速趨緩、收入分配差距擴大引發社會不穩定、債務水準攀升、外匯市場波動、保護主義不斷升級、主要先進經濟體經濟政策的不確定性及各種地緣政治風險等；整體而言，預計今年 E11 的 GDP 成長率將保持在 4.5%左右，中國大陸的 GDP 成長率將處於 6.5%至 6.7%之間。
- H. 由於全球經濟穩步復甦，帶動全球商品貿易成長，臺灣商品出口及工業生產水漲船高、持續擴張，預估第 1 季經濟成長將延續 2016 年下半年以來之穩健成長走勢，成長率約 2.76%。惟因比較基期因素影響，2017 年後續各季經濟成長走勢將逐季下降，分別為 2.17%、1.83%、1.75%；併計 2017 年全年經濟成長率 2.11%。成長模式呈現內外皆溫合的趨勢，國內需求貢獻 1.57 個百分點，淨輸出終結過去兩年之負貢獻轉為正向挹注 0.53 個百分點；2018 年經濟成長率則可望續往上升，成長率預估約為 2.15%。

5. 產業競爭情形

本集團於 2016 年成功購併 Topsil 及 SunEdison 成為全球第三大晶圓供應商，且 2016 年 Q4 起產業需求增強，至今仍供不應求。半導體產業之擴產皆需耗費至少兩年以上，故所有客戶為求能有穩定貨源皆陸續提出簽訂長期合約之要求，在此情況下較無競爭之壓力。

(三)技術及研發概況

本公司成立以來致力於矽晶圓材料長晶及精密加工製程之改善，亦透過與學術及研究機構之交流與合作，快速提升新技術與新產品之開發能量。歷經多年投入「單晶矽晶體成長技術及晶圓精密加工技術」與「矽磊晶沈積技術及 SOI 晶圓接合技術」

之開發，不管在單晶生產力的提高、晶體阻值的降低、晶體缺陷密度的控制、晶體品質的提高、氫氣用量的減少、晶圓平坦度提升、原子級拋光晶圓表面處理技術、同質/異質磊晶技術、同質/異質晶圓接合技術、晶圓強度提升厚度下降、電用量之減少、耗水量降低、物料用量的降低、廢棄物排放減量…等皆已達到或超越國際指標，多項技術指標成為國際上的標竿。而在矽基材料外，目前也針對寬能隙晶圓材料開發投入研究，以在矽晶圓的技術基礎上建構寬能隙材料的技術能力，成為全方位的晶圓材料供應商。除此之外這幾年也積極進行專利佈局以保護公司的智慧財產權，目前已取得專利證書超過 1200 件，研發成果亮麗並獲得國際客戶的肯定。

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目/年度	104 度	105 年度	106 年 3 月 31 日
研發費用	550,567	726,206	321,442
營業收入淨額	15,310,462	18,426,950	10,581,360
研發費用占營收淨額之比例(%)	3.60	3.94	3.04

2.最近年度開發成功之技術或產品

年度	技術或產品名稱
105	1. 8" 重摻硼<1.0m Ω-cm 晶體生長技術 2. 18" 低能耗節能熱場量產導入 3. CZ 電阻>2000 Ω-cm 無摻雜晶體生長技術 4. 矽晶體微量金屬檢測技術 5. Wire saw 高精度(±0.05 度) 偏角度晶棒切割技術 6. 碳化矽晶體生長技術-4" N-type SiC 晶圓 7. 8 吋單晶矽晶棒連續式加料 CZ 晶體生長技術 8. 8" <100> FZ SNTD 晶體生長技術 9. 先進積體電路元件用矽晶圓雙面拋光技術 10. 原子級晶圓表面拋光技術 for 7 奈米製程

(四)長、短期業務發展計畫

1.長期計畫

- A.朝向大尺寸重摻長晶及功率半導體磊晶技術發展，成為全球規模最大且產品完整性最高的矽晶圓供應商。
- B.朝向高效率長晶技術發展，成為全球品質最好、效率最高及產品種類最完整的矽晶圓供應商。
- C.整合日本廠、臺灣、中國及美國工廠產能及技術的平臺，積極不斷消除產能瓶頸擴大產能以充份有效利用各廠內的資源。

- D.整合日本廠與臺灣，中國及美國工廠的銷售為單一決策體，以充份利用分析各區域訊息資源，作最有效的銷售策略統合運作。
- E.由於分離式器件也將由較小尺寸(75mm, 100mm, 125mm)轉型至較大的尺寸(150mm, 200mm)，公司必需規劃比客戶早一代的產品，以延伸半導體客戶產品需求的轉變並提供客戶更好的產品選擇。參考日本廠較大尺寸的單晶爐的高效率熱場設計及單晶提拉技術，投入發展八吋半導體重摻晶圓或磊晶晶圓，藉由技術平臺之建立，降低產業競爭及增進業務之推廣，朝向具高附加價值的專業技術角色前進。業務方面，八吋晶圓的市場開發及產品認證陸續增加中，藉以打入更多八吋晶圓的市場，並與客戶建立長期技術合作的關係。
- F.充份整合日本廠八吋及十二吋的產能及產品技術，以進入更多一線 IC 大廠的市場。
- G.運用日本尖端之技術領先開發符合次世代產品運用之晶片,佔得市場不可取代強有力之位置。

2.短期計畫

- A.開發高品質重摻長晶技術及晶圓加工技術，以符合需求日益增多之功率半導體磊晶的需求。
- B.積極開展汽車用電子元件及智慧型手機(Smart phone)使用元件的市場與訂單；並擴大產能以吸引更多四吋至六吋晶圓訂單；尋求技術與銷售之策略聯盟，開發設計公司新產品的研發與材料的需求；快速將產品導入市場，提升市場占有率；開始開發大尺寸晶圓長晶核心技術，並擴大與學術及研究機構之交流，加速產品及技術開發能力達到國際水準。
- C.加速擴充六吋與八吋產能，並提昇十二吋生產效能，提高八吋及十二吋晶圓全球市佔率。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

地區別		104 年度		105 年度	
		銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內 銷		3,562,834	23.27%	4,233,637	22.98%
外 銷	亞洲	7,109,771	46.44%	8,256,356	44.81%
	美洲	2,044,748	13.36%	2,474,094	13.43%
	其他	2,593,109	16.93%	3,462,863	18.78%
合 計		15,310,462	100.00%	18,426,950	100.00%

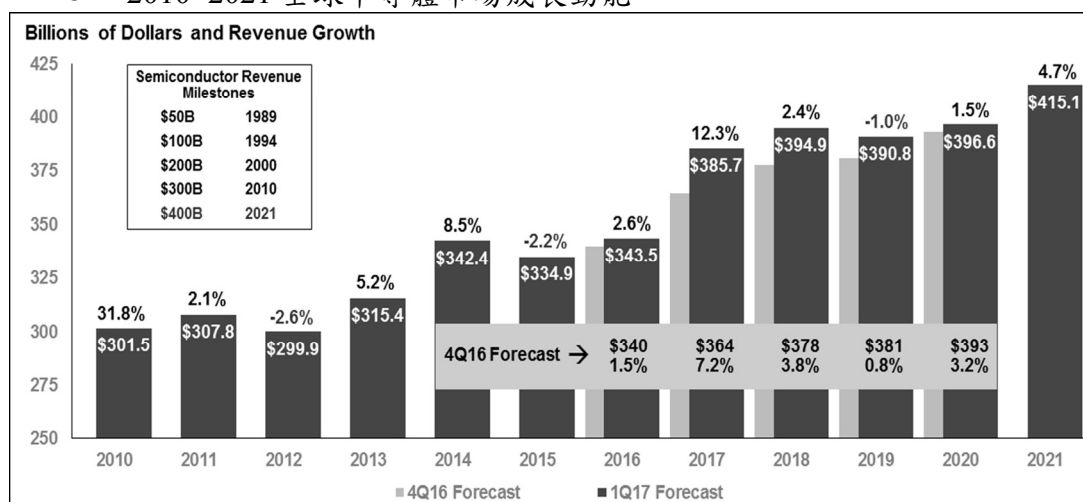
2. 市場佔有率

依據 SEMI 組織於 2017 年 Q1 之統計資料統計, 我公司之出貨佔有率佔世界矽晶圓製造商之 17.4% 排名第三大; 矽晶圓產業有集中化及整合之趨勢, 前五大廠商合計市佔率約 95%, 而前五大排名分別為日本信越(Shin-Etsu)、日本 Sumco、環球 GWC、德國 Siltronic AG、及韓國 LG Siltron, 本公司於世界排名第三, 市占率約為 17.4%, 營運係呈現穩定成長趨勢, 期能在有最廣領域產品之利基狀況下作持續市場之開拓, 能夠逐步提升其市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長

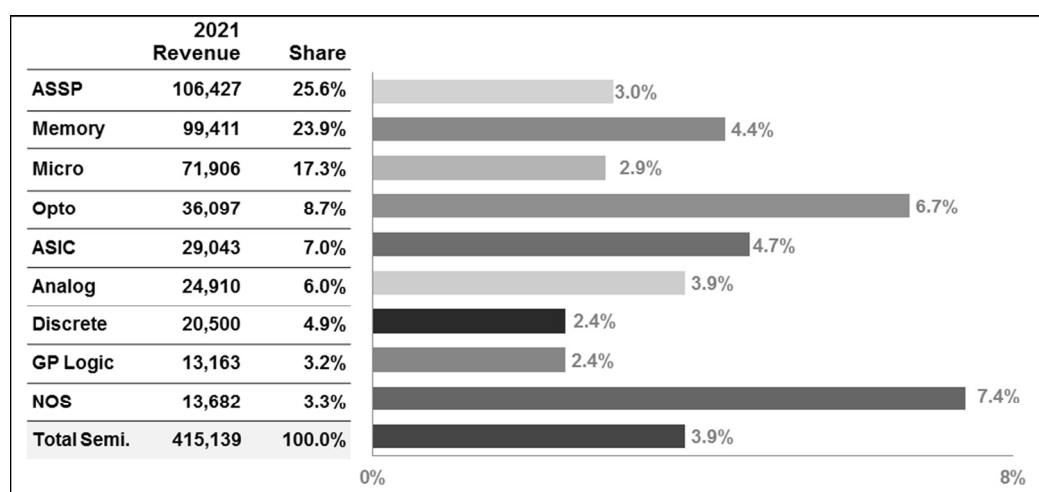
資料顯示未來終端市場之需求將持續成長, 但因位處我方上游端之晶片供應於 2017 年前都處在供過於求獲利不佳之狀況, 導致各廠皆無擴廠之計畫。且一般新擴廠房與產能從建廠至量產並通過客戶認證能大量出貨需時至少三年, 故晶片供應商都還採取觀望態度, 故值此 2017 年需求爆發且還有十餘座新晶片廠將陸續建成、投產需求更多之狀況下, 客戶對於晶片需求都確定將會成長, 維持對我方有利之狀況。

● 2010~2021 全球半導體市場成長動能



資料來源：Gartner (2017/05)

● 2015~2021 年全球 IC 產品年複合成長率



資料來源：Gartner (2017/05)

4.競爭利基

A.產業經驗豐富之經營及技術研發團隊

本公司自成立以來，持續投入先進矽晶圓領域相關之技術開發與研究，主要研發人員及經營階層於半導體產業皆有多年以上之工作經驗，累積相關豐富之經驗，洞悉半導體產業趨勢，並對市場需求充分掌握，使得本公司能夠配合客戶需求適時開發關鍵技術，有助於客戶訂單之爭取。

B.擁有先進製程技術

本公司致力於矽晶圓材料長晶及精密加工製程之改善，亦透過與學術及研究機構之交流與合作，快速提升新技術與新產品之開發能量。歷經多年投入「單晶矽晶體成長技術及晶圓精密加工技術」之開發，不管在單晶生產力的提高、晶體阻值的降低、晶體缺陷密度的控制、晶體品質的提高、氫氣用量的減少、晶圓平坦度提升、晶圓強度提升厚度下降、電用量之減少、物料用量的降低、廢棄物排放減量...等皆已達到或超越國際指標，多項技術指標成為國際上的標竿。除此之外這幾年也積極進行專利佈局以保護公司的智慧財產權，目前已取得專利證書超過 1200 件，研發成果亮麗並獲得國際客戶的肯定。

C.具規模產能、產能調度彈性及規模經濟競爭能力

本公司自成立以來，專注於半導體級矽產品領域相關之技術與生產研發，生產基地橫跨美洲、歐洲及亞洲，總計擁有 16 座工廠坐落於全球 10 個國家，其產能已達經濟規模，而工程師與生產線人員在製程與操作技術成熟，加上本公司有效管理製程且分散式之多樣化經營策略，使得生產效率大幅提升，單位成本亦相對降低。

D.與客戶建立長期緊密夥伴關係

本公司提供核心技術產品全程製造之完整服務予客戶，在精密加工技術、產品品質及交期服務均能滿足客戶的需求，故本公司目前已獲得多家國內外半導體大廠之認證肯定，而半導體大廠基於技術保密、品質及長期合作默契考量，除非產品出現重大缺失，並不會輕易更換供應商，顯示本公司與客戶已建立長期緊密夥伴關係。此外，本公司除繼續與現有客戶維持良好關係，未來將利用先進製程技術之基礎，致力於開發新客戶，有助於本公司未來的營運發展。

E.產品多元化

本公司為專業之半導體級矽晶圓製造商，具拉晶、切片、研磨、拋光、清洗與磊晶全製程之 3 吋~12 吋矽晶圓產品線，目前產品包括超低電阻重摻紅磷晶棒、超低電阻重摻砷晶棒、超低電阻重摻硼晶棒、超低含氧量 MCZ 晶棒、拋光晶圓、磊晶晶圓、退火晶圓、非拋光晶圓及超薄晶圓、MEMS 用超平坦晶圓、高亮度浸蝕晶圓、SOI 晶圓及高功率電力電子接合晶圓、擴散晶圓、深擴散拋光晶圓及 GaN_HEMT 磊晶用高強度矽基板等，且本公司依不同的客戶

需求，提供客戶一套完整的解決方案與客製化的服務，由於產品品質穩定、效能佳、產品線完整及快速的研發設計彈性，使本公司在市場上持續保有領先競爭優勢。

F.穩健之財務結構

大者恆大為半導體業未來發展趨勢之一，本公司擁有充足之現金流及健全資產負債結構，能夠確保本公司持續穩健投資及發展，亦為半導體產業不景氣時，維持營運穩定度之關鍵，因此穩健財務結構為本公司與客戶長期合作與共同成長之重要基礎，亦為本公司競爭利基之一。

5.發展遠景之有利與不利因素

A.有利因素

(a)資本及技術密集高，進入門檻較高

半導體產業是資本與技術密集的工業，由於半導體產業所需之生產機台昂貴、IDM 委外代工訂單趨增及產品技術變化快速，需要投入之資本支出越發龐大。另半導體之技術密集度高，其製程技術與產品產出良率決定生產成本高低，而研發人才與製程技術具有密切關係，但研發專業人才培養及延攬不易，加上產品需經過客戶認證後方能取得訂單，造成新競爭者有較高之進入門檻。本公司擁有優秀技術研發團隊，在產業深耕多年，實務經驗豐富，充份掌握矽晶圓趨勢與需求，且本集團已達經濟規模，產品製程技術亦取得國際大廠之信賴及品質認證，顯示本集團具有市場競爭力。

(b)半導體市場需求量持續成長，帶動矽晶圓出貨量

全球半導體市場之需求量持續成長，將刺激矽晶圓材料市場成長，由於受惠於終端智慧型手機與平板電腦等手持裝置需求影響，相關記憶體、處理器及通訊晶片等IC零組件持續供不應求，讓各半導體廠的產能利用率居高不下，也間接使得半導體材料持續成長，尤其以8吋及12吋矽晶圓需求更為顯著，加上6吋以下矽晶圓也因車用及民生用需求增加，因此全球矽晶圓材料之需求將隨半導體需求上升而成長。

(c)產品發展符合市場需求

由於目前前五大矽晶圓製造商以記憶體等標準應用為主，競爭激烈且擠壓獲利空間，而本集團不僅可提供客戶 3~12 吋全系列矽晶圓產品及全製程(拉晶、切片、研磨、拋光、清洗、退火、磊晶等)之服務，並聚焦於車用及電源設備應用等利基型市場，近兩年毛利率落在 22%~27%，獲利結構穩健，且本集團積極佈局利基型應用先進製程，產品線完整，故本集團未來仍具有成長空間。

B.不利因素及因應措施

(a)半導體產業之景氣波動

本公司為半導體晶圓之專業生產廠商，屬半導體產業鏈之上游，主要客戶除半導體製造廠、晶圓代工廠外，亦包含整合元件製造商及車用電子廠商等，由於矽晶圓係製造半導體元件不可或缺的關鍵基礎材料，因此公司營運狀況與半導體產業景氣息息相關。

因應對策：

本公司為全球第三大半導體晶圓廠，產品線涵蓋3吋至12吋，具有相當的經濟規模與市場地位，且終端產品應用領域廣泛，特別是在車用及電源裝置等利基型市場表現突出，且本公司及子公司技術人才均已在半導體產業浸淫多年，技術實力堅強，可藉由核心技術的運用，搭配本身技術整合及開發能力，提供完整且符合市場與客戶需求之多元化產品，並與現有客戶建立長期穩定之夥伴關係，使產能獲得充分而穩定之利用，降低景氣循環的風險。再者，本公司生產基地涵蓋台灣、中國大陸、日本與美國等地，除可藉由採購、銷售集中化，降低營運成本外，並可充分利用各生產基地的優勢，靈活調度生產排程，因應來自市場波動的不利因素。

(b)關鍵原料短缺風險

隨著半導體產業蓬勃發展，對矽晶圓的需求急速增加，製造矽晶圓的半導體級多結晶矽原料之需求亦跟著水漲船高，上游原料供應商若無法適時配合，將造成原料短缺導致無法生產之情形。

因應對策：

本公司之主要原料-多結晶矽，係向世界知名大廠採購，並且簽訂長期供貨合約，以確保供料品質穩定及供應量充足。

(c)匯率風險

本公司目前在歐洲、美洲及亞洲均有生產據點，人工、水電等製造費用均係以當地幣別支付，而在銷售端則除了部份日本當地客戶係以日幣計價外，其餘客戶多為美金計價，因此美金對上述貨幣匯率大幅波動時，亦將影響本公司營運成本。

因應對策：

由於外部經濟及匯率變化情勢複雜，本公司以採負債及資產部位互抵之自然避險為原則，盡量降低曝露於匯率波動風險下之淨部位，並由財務單位密切觀察匯率之走勢，必要時搭配以避險為目的之遠期外匯操作，降低匯率波動對營運成本之影響。

(d)小尺寸競爭者加入

近年陸續有小尺寸矽晶圓廠加入競爭，加上中國大陸積極扶植其國內半導體產業，小尺寸矽晶圓市場競爭越形激烈。

因應對策：

半導體產業是資本與技術高度密集的工業，由於所需之生產機台昂貴且產品技術變化快速，資本支出越發龐大，研發專業人才培養及延攬更是不易，加以產品需經過客戶認證後方能取得訂單，故進入門檻極高。本公司擁有優秀技術研發團隊，在產業深耕多年，充份掌握矽晶圓趨勢與需求，尤其中小尺寸產能已在全球供應商中名列前茅，產品製程技術亦取得國際大廠之信賴及品質認證，相較新加入之競爭者具有相當的競爭優勢，本公司將持續強化其競爭利基，以保持領先地位。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品重要用途

產品名稱	重要用途說明
半導體矽晶圓	為半導體元件之最主要材料，經過不同製程如拋光、擴散、曝光、蝕刻等，以及後段如：組裝、測試等方式成為分離式元件、積體電路及光電元件所需之材料。運用於二極體、整流器、電晶體、TVS、開流體、MOSFET 等半導體分離式元件、MEMS、Power Device (功率半導體)及消費性 IC、LOGIC IC 等積體電路及光電元件。

2.產製過程：

晶圓製程

矽原料→長晶→切斷→圓磨→切片→粗晶片清洗→熱處理→圓邊→研磨→平晶片清洗→檢驗→成品包裝

晶粒製程

原料晶片→擴散→噴砂→清洗→鍍鎳→燒結→鍍鎳→鍍金→切割→包裝出貨

拋光製程

晶片研磨→浸蝕→拋光前檢驗→晶片拋光→預清洗→檢驗→最終清洗→晶片表面掃描→檢驗→晶片包裝

(三)主要原料之供應狀況

產品項目	主要原料	主要供應商	供應狀況
矽晶圓	矽原料	a 公司、c 公司、d 公司	良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例

- 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	104 年度				105 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	c 公司	1,233,770	19.05%	無	c 公司	1,398,202	18%	無
2	a 公司	629,454	9.72%	無	a 公司	853,017	11%	無
3	b 公司	369,843	5.71%	無	d 公司	411,573	5%	無
	其他	4,242,020	65.52%		其他	5,172,008	66%	
	進貨淨額	6,475,087	100.00%		進貨淨額	7,834,002	100.00%	

增減變動說明：

本公司及子公司主要從事矽晶材料之製造及銷售等業務，其主要原料為矽，供應商排名變化情形主係依合約進貨之時間而有變動。

- 2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	104 年度				105 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	2,771,154	18.10%	無	A 公司	1,962,297	10.65%	無
2	B 公司	1,257,679	8.21%	無	B 公司	1,316,327	7.14%	無
	其他	11,281,629	73.69%		其他	15,148,326	82.21%	無
	銷貨淨額	15,310,462	100.00%		銷貨淨額	18,426,950	100.00%	

增減變動說明：

本公司及子公司主要從事矽晶材料之製造及銷售等業務，其產品主要為矽晶棒及客製化之矽晶圓，其主要客戶多為半導體元件大廠，最近兩年度之主要銷售客戶排名變化情形並無重大的差別。

- (五)最近二年度生產量值表：

單位：新台幣千元/千片

生產 量值 主要商品(或部門別)	104 年度			105 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
半導體晶錠產品	261	217	805,292	261	27.83	576,825
半導體晶片產品	30,270	24,908	14,789,972	30,270	21,942	17,850,125
合 計	-	-	15,595,164	-	-	18,426,950

(六)最近二年度銷售量值表：

單位：新台幣千元/千片

銷售 量值 主要商品 (或部門別)	年 度	104 年度				105 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
半導體晶錠產品		0	0	479	1,177,490	0	0	28	167,912
半導體晶片產品		7,470	2,481,654	16,486	11,132,919	7,362	3,712,464	14,581	14,137,662
其他		0	454,183	0	64,216	0	2,746	0	406,166
合 計			2,935,837		12,374,625		3,715,210		14,711,740

註：其他項目主要為晶棒及原物料出售等，因品項繁雜且價格差異甚大，故不擬計算其銷量。

產銷量值變動情形之分析及說明：

產品主要包括矽晶棒及客製化之矽晶圓，其主要客戶多為半導體元件大廠，最近兩年度之產品組成比重主要係受到產品需求結構改變，變化情形尚屬合理。

三、從業員工資訊

年度		104 年度	105 年度	106 年 3 月 31 日
員工人數	直接	291	288	308
	間接	185	203	207
	合計	476	491	515
平均年歲		36.2	37.57	37.58
平均服務年資(年)		7.00	8.13	7.95
學歷分布比率 (%)	博士	1.89	1.63	1.55
	碩士	10.08	12.83	12.43
	大專	47.69	48.88	51.07
	高中(含以下)	40.34	36.66	34.95

註：不含子公司

四、環保支出資訊

- 1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：已依規定申領污染設施設置許可證並設置環保專責單位人員。
- 2.防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

105 年 12 月 31 日

設備名稱	數量	取得日期	投資成本	未折減餘額	用途及預計可能產生效益
洗滌塔	8	2003/5	12,848 千元	393 千元	處理廠內製程所產生之廢氣，以符合環保法令空氣污染排放標準

設備名稱	數量	取得日期	投資成本	未折減餘額	用途及預計可能產生效益
洗滌塔	10	2015/3	14,943 千元	13,756 千元	處理廠內製程所產生之廢氣，以符合環保法令空氣污染排放標準
廢水處理設備	1	1991/8	8,396 千元	-	處理廠內製程所排放之廢水，以符合環保法令廢水污染排放標準
廢水處理設備	4	2015/1	7,040 千元	6,695 千元	處理廠內製程所排放之廢水，以符合環保法令廢水污染排放標準
廢水廠污水排放函管增建案	1	2016/8	840 千元	723 千元	處理廠內製程所排放之廢水，以符合環保法令廢水污染排放標準
廢氣處理設備電腦監控二次配工程	1	2016/12	215 千元	209 千元	處理廠內製程所排放之廢水，以符合環保法令廢水污染排放標準

- 3.最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- 4.最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。
- 5.目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。
- 6.本公司應歐盟環保指令(RoHS)相關資訊：配合業務需求，進行晶片 RoHS 禁用限用物質之送樣檢測。

五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施：

(1)提供優質的薪資待遇及公平公正的獎勵辦法、晉升辦法以肯定所有同仁對公司的貢獻與付出。本公司員工除享有勞保、健保、團保、退休金給付等一般福利外，由公司提供之福利包括發給年節獎金、生日及節慶禮金、舉辦年終晚會、婚喪喜慶、國內外旅遊、急難救助、獎學金補助、提供交通車、午餐及宿舍、實施員工入股、提供完整之教育訓練講習等。

(2)以每月營業額 0.1%及出售下腳收入 40%提撥至職工福利委員會，職工福利委員會由委員依相關法規運作。

2.員工進修及訓練

本公司提供多元化訓練課程、各項專業在職教育訓練及自我成長課程，其中包括新進人員訓練、在職訓練課程、勞工安全衛生教育訓練、專業課程以及各種與職務有關之外派訓練課程，以培養富有專業能力並兼具挑戰性之人才。

3.退休制度與實施狀況

(1)同仁退休分為：自願退休及強制退休兩種。

自願退休：工作 15 年以上年滿 55 歲者、工作 25 年以上者或工作 10 年以上年滿 60 歲者。

強制退休：民國 97 年 5 月 14 日起年滿 65 歲者或心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者，公司得強制其退休。

(2)年資計算：自到職日起算：除服役外，留職停薪期間之年資應予扣除。

(3)退休金給付標準：

舊制：按服務年資每滿一年給與兩個基數。超過 15 年之服務年資，每滿一年給與一個基數，但最高以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。凡強制退休之勞工，如其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，則其退休金基數依前款規定加給百分之二十。

新制：民國九十四年七月以後選擇新制者，民國九十四年七月以前年資以舊制計算，民國九十四年七月後年資以新制計算。

(4)民國九十四年七月以後到職者依新制計算(雇主每月提撥薪資 6%存至勞保局之個人戶頭)。

4.勞資協調之情形

本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，並依勞資會議實施辦法，定期舉辦勞資會議。勞資關係一向相當和諧，溝通管道暢通，同時透過勞資會議及職工福利委員會共同討論，協商勞資雙方互利互惠等事宜，除了進一步了解彼此的需求與期待外，本公司所有同仁更本著共存共榮之經營理念，共同努力創造公司未來。

5.各項員工權益維護措施

本公司訂有完善的管理制度，載明各項管理辦法，內容明訂同仁權利義務及福利項目，並不定期檢討修訂福利內容，以維護所有同仁權益。所以本公司勞資關係和諧，未曾因勞資糾紛遭受任何損失，預計未來亦無此類事件。

(二)最近年度及截至年報列印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：本公司勞資關係和諧，未曾因勞資糾紛遭受任何損失，預計未來亦無此類事件。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖期 日	主要內容	限制條款
土地租賃契約	科學工業園區 管理局	100.10.01～ 109.12.31	面積 4638 平方公尺 每月租金 228,885 元	限目的事業 用途使用
供應商合約	供應商 c	99～108	矽原料合約	無
供應商合約	供應商 d	99～107	矽原料合約	無
供應商合約	供應商 a	100～116	矽原料合約	無
銀行聯貸合約	兆豐、台銀、華 南、台北富邦及台 新銀行	105～110	美金 3.5 億元聯合授 信	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)簡明資產負債表及綜合損益表

1.簡明資產負債表

(1)國際財務報導準則(合併)

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料					當年度截至 106年3月31 日財務資料
		101年	102年	103年	104年	105年	
流動資產		不適用	8,592,626	10,083,409	12,004,772	22,212,281	20,412,028
不動產、廠房及設備			9,796,025	8,972,049	9,360,910	31,035,540	29,549,671
無形資產			637,019	676,453	701,566	4,436,073	4,188,144
其他資產			2,048,371	1,652,852	1,748,512	2,876,343	3,002,052
資產總額			21,074,041	21,384,763	23,815,760	60,560,237	57,151,895
流動負債	分配前		4,976,288	5,785,495	4,883,614	24,890,930	28,342,194
	分配後		6,722,538	7,776,220	6,729,864	註3	註3
非流動負債			2,963,009	2,398,454	2,207,549	19,850,805	13,146,671
負債總額	分配前		7,939,297	8,183,949	7,091,163	44,741,735	41,488,865
	分配後		9,685,547	10,174,674	8,937,413	註3	註3
歸屬於母公司業主之權益			-	-	-	-	-
股本			3,175,000	3,175,000	3,692,500	3,692,500	3,692,500
資本公積			9,305,111	9,311,229	11,767,321	11,741,399	11,741,399
保留盈餘	分配前		2,126,718	2,424,398	2,780,724	1,933,282	2,282,239
	分配後		380,468	757,148	961,577	註3	註3
其他權益			(1,472,085)	(1,711,887)	(1,515,948)	(1,592,477)	(2,063,529)
庫藏股票			-	-	-	-	-
非控制權益			-	-	-	43,798	10,421
權益總額	分配前		13,134,744	13,200,814	16,724,597	15,818,502	15,663,030
	分配後		11,388,494	11,210,089	14,878,347	註3	註3

註：1.本公司及子公司自103年起採用金管會認可之國際財務報導準則，101~102年度採用我國財務會計準則之財務資料請詳下列(2)之說明。

2.103~105年之財務資料業經會計師查核簽證，106年第一季財務資料係經會計師核閱。

3.105年之盈餘分配尚未經股東常會通過。

(2)我國財務會計準則(合併)

單位：新台幣仟元

項目		最近五年度財務資料				
		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年
流動資產		8,846,455	8,613,671	不適用		
基金及投資		500,769	184,009			
固定資產		12,184,144	9,895,127			
無形資產		631,754	646,513			
其他資產		1,371,323	1,321,051			
資產總額		23,534,445	20,660,371			
流動負債	分配前	6,880,312	4,732,249			
	分配後	7,769,312	6,478,499			
長期負債		-	-			
其他負債		3,476,054	2,506,275			
負債總額	分配前	10,356,366	7,238,524			
	分配後	11,245,366	8,984,774			
股本		3,175,000	3,175,000			
資本公積		9,255,000	9,305,111			
保留盈餘	分配前	1,101,954	2,188,881			
	分配後	212,954	442,631			
金融商品未實現損益		-	-			
累積換算調整數		(353,749)	(1,247,145)			
未認列為退休金成本之淨損失		(126)	-			
股東權益總額	分配前	13,178,079	13,421,847			
	分配後	12,289,079	11,675,597			

註：本公司業於100年10月設立，101~102年度財務資料業經會計師查核簽證。

(3)國際財務報導準則(個體)

單位：新台幣仟元

項目		年度	最近五年度財務資料				
			101 年	102 年	103 年	104 年	105 年
流動資產				4,314,790	4,398,280	5,429,789	6,810,506
不動產、廠房及設備				284,611	254,006	300,965	334,997
無形資產				-	-	-	1,631,850
其他資產				10,355,052	11,864,430	13,408,001	33,070,416
資產總額				14,954,453	16,516,716	19,138,755	41,847,769
流動負債	分配前			1,550,568	2,900,164	1,898,253	17,317,308
	分配後			3,296,818	4,890,889	3,744,503	註 3
非流動負債				269,141	415,738	515,905	8,755,757
負債總額	分配前			1,819,709	3,315,902	2,414,158	26,073,065
	分配後			3,565,959	5,306,627	4,260,408	註 3
歸屬於母公司業主之權益		不適用		-	-	-	-
股本				3,175,000	3,175,000	3,692,500	3,692,500
資本公積				9,305,111	9,311,229	11,767,321	11,741,399
保留盈餘	分配前			2,126,718	2,424,398	2,780,724	1,933,282
	分配後			380,468	757,148	961,577	註 3
其他權益				(1,472,085)	(1,711,887)	(1,515,948)	(1,592,477)
庫藏股票				-	-	-	-
非控制權益				-	-	-	-
權益總額	分配前			13,134,744	13,200,814	16,724,597	15,774,704
	分配後			11,388,494	11,210,089	14,878,347	註 3

註：1.本公司及子公司自103年起採用金管會認可之國際財務報導準則，101~102年度採用我國財務會計準則之財務資料請詳下列(4)之說明。

2.103~105年之財務資料業經會計師查核簽證。

3.105年之盈餘分配尚未經股東常會通過。

(4)我國財務會計準則(個體)

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度		最近五年度財務資料				
		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年
流動資產		2,807,615	4,325,274	不適用		
基金及投資		11,431,595	9,738,734			
固定資產		369,530	284,611			
無形資產		-	-			
其他資產		597,654	649,493			
資產總額		15,206,394	14,998,112			
流動負債	分配前	1,993,856	1,541,012			
	分配後	2,882,856	3,287,262			
長期負債		-	-			
其他負債		34,459	35,253			
負債總額	分配前	2,028,315	1,576,265			
	分配後	2,917,315	3,322,515			
股本		3,175,000	3,175,000			
資本公積		9,255,000	9,305,111			
保留盈餘	分配前	1,101,954	2,188,881			
	分配後	212,954	442,631			
金融商品未實現損益		-	-			
累積換算調整數		(353,749)	(1,247,145)			
未認列為退休金成本之淨損失		(126)	-			
股東權益總額	分配前	13,178,079	13,421,847			
	分配後	12,289,079	11,675,597			

註：本公司業於 100 年 10 月設立，101~102 年度財務資料業經會計師查核簽證。

2.簡明綜合損益表

(1)國際財務報導準則(合併)

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料					當年度截至 106年3月31 日財務資料
		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	
營業收入	不適用		15,569,575	15,921,691	15,310,462	18,426,950	10,581,360
營業毛利			3,663,126	3,728,021	4,073,170	4,130,383	2,120,820
營業損益			2,193,703	2,336,191	2,684,922	1,378,347	1,070,034
營業外收入及支出			10,379	343,171	122,804	(33,908)	(445,180)
稅前淨利(損)			2,204,082	2,679,362	2,807,726	1,344,439	624,854
繼續營業單位本期淨利			1,948,435	2,095,432	2,044,193	939,171	348,917
停業單位損失			-	-	-	-	-
本期淨利(損)			1,948,435	2,095,432	2,044,193	939,171	348,917
本期其他綜合損益 (稅後淨額)			(899,620)	(291,304)	175,322	(44,044)	(504,389)
本期綜合損益總額			1,048,815	1,804,128	2,219,515	895,127	(155,472)
淨利歸屬於母公司業主			1,948,435	2,095,432	2,044,193	939,485	348,957
淨利歸屬於非控制權益			-	-	-	(314)	(40)
綜合損益總額歸屬於母 公司業主			1,048,815	1,804,128	2,219,515	895,176	(122,095)
綜合損益總額歸屬於非 控制權益			-	-	-	(49)	(33,377)
每股盈餘			6.14	6.6	5.8	2.54	0.95

註：1. 本公司及子公司自103年起採用金管會認可之國際財務報導準則，101~102年度採用我國財務會計準則之財務資料請詳下列(2)之說明。

2. 103~105年度財務資料業經會計師查核簽證，106年第一季財務資料係經會計師核閱。

(2)我國財務會計準則(合併)

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料				
		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年
營業收入		14,040,094	15,569,575	不適用		
營業毛利		2,524,862	3,669,189			
營業損益		1,033,709	2,221,195			
營業外收入及利益		41,584	115,383			
營業外費用及損失		275,678	105,004			
繼續營業部門稅前損益		799,615	2,231,574			
繼續營業部門損益		980,346	1,975,927			
停業部門損益		-	-			
非常損益		-	-			
會計原則變動之累積影 響數		-	-			
本期損益		980,346	1,975,927			
每股盈餘		3.44	6.22			

註：本公司業於100年10月設立，101~102年度財務資料業經會計師查核簽證。

(3)國際財務報導準則(個體):

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料				
		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年
營業收入	不適用		6,866,066	6,831,717	6,898,559	6,749,320
營業毛利			910,544	731,558	954,035	1,360,109
營業損益			479,435	350,073	599,972	667,833
營業外收入及支出			1,629,935	2,049,559	1,655,616	333,297
稅前淨利(損)			2,109,370	2,399,632	2,255,588	1,001,130
繼續營業單位本期淨利			1,948,435	2,095,432	2,044,193	939,485
停業單位損失			-	-	-	-
本期淨利(損)			1,948,435	2,095,432	2,044,193	939,485
本期其他綜合損益(稅後淨額)			(899,620)	(291,304)	175,322	(44,309)
本期綜合損益總額			1,048,815	1,804,128	2,219,515	895,176
淨利歸屬於母公司業主			1,948,435	2,095,432	2,044,193	939,485
淨利歸屬於非控制權益			-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主			1,048,815	1,804,128	2,219,515	895,173
綜合損益總額歸屬於非控制權益			-	-	-	-
每股盈餘			6.14	6.6	5.8	2.54

註：1. 本公司及子公司自103年起採用金管會認可之國際財務報導準則，101~102年度採用我國財務會計準則之財務資料請詳下列(4)之說明。

2. 103~105年度財務資料業經會計師查核簽證。

(4)我國財務會計準則(個體)

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料				
		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年
營業收入		5,141,973	6,866,066	不適用		
營業毛利		1,058,889	910,544			
營業損益		812,769	500,864			
營業外收入及利益		358,236	1,753,940			
營業外費用及損失		96,668	117,942			
繼續營業部門稅前損益		1,074,337	2,136,862			
繼續營業部門損益		980,346	1,975,927			
停業部門損益		-	-			
非常損益		-	-			
會計原則變動之累積影響數		-	-			
本期損益		980,346	1,975,927			
每股盈餘(元)		3.44	6.22			

註：本公司業於100年10月設立，101~102年度財務資料業經會計師查核簽證。

(二)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1.最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

(1)最近五年度合併財務報告簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	意見
101年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺、陳振乾	標準式無保留意見
102年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺、陳振乾	標準式無保留意見
103年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺、黃泳華	標準式無保留意見
104年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺、黃泳華	標準式無保留意見
105年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺、黃泳華	標準式無保留意見

(2)最近五年度個體財務報告簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所名稱	簽證會計師姓名	意見
101年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺	修正式無保留意見
102年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺、陳振乾	標準式無保留意見
103年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺、黃泳華	標準式無保留意見
104年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺、黃泳華	標準式無保留意見
105年	安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺、黃泳華	標準式無保留意見

- 2.最近五年度更換會計師原因說明：本公司最近五年度更換簽證會計師係安侯建業聯合會計師事務所內部組織調整及業務調度，並無更換簽證會計師事務所。

二、最近五年度財務分析

(一)財務分析－國際財務會計報導準則(合併)

年 度 分析項目 (註 2)		最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)					當年度截至 106年3月31 日止財務資 料(註 1)
		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年	
財務結構 (%)	負債占資產比率	不適用		38.27	29.78	73.88	72.59
	長期資金占不動產、廠房及設備比率			173.87	202.25	114.93	97.50
償債能力	流動比率(%)			174.29	245.82	89.24	72.02
	速動比率(%)			119.09	172.15	58.30	46.02
	利息保障倍數			95.51	251.04	14.33	5.76
經營能力	應收款項週轉率(次)			4.7	3.7	3.02	5.43
	平均收現日數			78	98	121	67
	存貨週轉率(次)			3.75	3.5	2.54	4.45
	應付款項週轉率(次)			7.67	7.34	4.39	7.34
	平均銷貨日數			97	104	144	82
	不動產、廠房及設備週轉率(次)			1.70	1.67	0.91	1.40
	總資產週轉率(次)			0.75	0.68	0.44	0.72
獲利能力	資產報酬率(%)			9.97	9.08	2.39	2.87
	權益報酬率(%)			15.91	13.66	5.77	8.87
	稅前純益占實收資本比率(%)			84.39	76.04	36.41	67.69
	純益率(%)			13.16	13.35	5.10	3.30
	每股盈餘(元)			6.6	5.8	2.54	0.94
現金流量	現金流量比率(%)			57.76	48.32	10.76	-
	現金流量允當比率(%)			152.65	116.8	106.26	99.59
	現金再投資比率(%)			3.25	0.69	1.22	-
槓桿度	營運槓桿度			1.6	1.47	2.16	2.28
	財務槓桿度			1.01	1	1.08	1.14

請說明最近二年度各項財務比率變動原因：

1. 負債占資產比率：主係借款增加所致。
2. 長期資金占不動產、廠房及設備比率：主係獲利減少及負債增加所致。
3. 流動比率及速動比率：主係借款增加所致。
4. 利息保障倍數：主係借款，利息費用增加所致。
5. 經營能力：主係 105 年 7 及 12 月併購海外子公司，其營業收入/銷貨成本非全年度。
6. 獲利能力：主係 105 年 7 月及 12 月併購海外子公司，其獲利能力仍為虧損狀態。
7. 現金流量比率：主係主係 105 年 7 月及 12 月併購海外子公司，其獲利能力仍為虧損故營業活動為現金流出。
8. 現金再投資比率：主係 105 年 7 及 12 月併購海外子公司，其獲利能力仍為虧損故營業活動為現金流出。
9. 營運槓桿度：主係主係 105 年 7 月及 12 月併購海外子公司，其營業利益為虧損所致。

註1：本公司及子公司自103年起採用金管會認可之國際財務報導準則，103~105年財務資料業經會計師查核簽證，106年第一季財務資料係經會計師核閱。

註2：本表財務分析公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

(二)財務分析－我國財務會計準則(合併)

分析項目（註 2）			年度	最近五年度財務資料(註 1)					
			101 年	102 年	103 年	104 年	105 年		
財務結構 （%）	負債占資產比率		44.01	35.04	不適用				
	長期資金占固定資產比率		136.69	160.97					
償債能力	流動比率(%)		128.58	182.02					
	速動比率(%)		78.39	104.65					
	利息保障倍數		9.73	60.35					
經營能力	應收款項週轉率(次)		5.81	4.68					
	平均收現日數		62.85	77.99					
	存貨週轉率(次)		5.99	3.54					
	應付款項周轉率(次)		7.05	6.42					
	平均銷貨日數		61	103					
	固定資產週轉率(次)		1.69	1.41					
	總資產週轉率(次)		0.84	0.70					
獲利能力	資產報酬率(%)		6.55	9.09					
	股東權益報酬率(%)		9.59	14.86					
	占實收資本 比率(%)	營業利益	32.56	69.96					
		稅前純益	25.18	70.29					
	純益率(%)		6.98	12.69					
	每股盈餘(元)		3.44	6.22					
現金流量	現金流量比率(%)		21.11	63.03					
	現金流量允當比率(%)		2,097.90	183.19					
	現金再投資比率(%)		2.64	4.14					
槓桿度	營運槓桿度		2.86	1.82					
	財務槓桿度		1.10	1.02					
請說明最近二年度各項財務比率變動原因：因 103 年度已採用國際財務報導準則，故不適用。									

註1：本公司業於100年10月設立，101~102年度合併財務資料業經會計師查核簽證。

註2：本表財務分析公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋非流動負債）／ 固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／平均固定資產淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（固定資產毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金）。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）。

(三)財務分析－國際財務會計報導準則(個體)

年 度 分析項目 (註 2)		最 近 五 年 度 財 務 分 析(註 1)				
		101 年	102 年	103 年	104 年	105 年
財務結構(%)	負債占資產比率	不適用		20.08	12.61	62.30
	長期資金占不動產、廠房及設備比率			5360.72	5728.61	7322.59
償債能力	流動比率(%)			151.66	286.04	39.33
	速動比率(%)			124.32	233.93	30.49
	利息保障倍數			372.06	2316.8	27.17
經營能力	應收款項週轉率(次)			6.25	6.17	2.69
	平均收現日數			58	59	136
	存貨週轉率(次)			9.13	7.59	4.54
	應付款項週轉率(次)			4.26	3.82	1.65
	平均銷貨日數			40	48	80
	不動產、廠房及設備週轉率(次)			25.37	24.86	21.23
	總資產週轉率(次)			0.43	0.39	0.22
獲利能力	資產報酬率(%)			13.35	11.47	3.20
	權益報酬率(%)			15.91	13.66	5.78
	稅前純益占實收資本比率(%)			75.58	61.09	27.11
	純益率(%)			30.67	29.63	13.92
	每股盈餘(元)			6.6	5.8	2.54
現金流量	現金流量比率(%)			17.42	18.49	5.47
	現金流量允當比率(%)			127.79	45.457	90.97
	現金再投資比率(%)			-8.63	-7.60	-3.80
槓桿度	營運槓桿度			1.3	2	1.15
	財務槓桿度			1.02	1.00	1.06

請說明最近二年度各項財務比率變動原因：

- 1.負債占資產比率：主係併購案借款增加。
- 2.長期資金占不動產、廠房及設備比率：主係併購海外子公司仍為虧損故股東權益減少。
- 3.償債能力：主係併購案借款增加。
- 4.獲利能力：主係併購海外子公司仍為虧損故獲利能力減少。
- 5.現金流量比率：主係併購案借款增加。
- 6.現金再投資比率：主係長期投資及營運資金增加。
- 7.營運槓桿度：主係營業利益增加。

註1：本公司自103年起採用金管會認可之國際財務報導準則，103~105年財務資料業經會計師查核簽證。

註2：本表財務分析公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（股東權益淨額＋非流動負債）／固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數=365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率=銷貨淨額／平均固定資產淨額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕／平均資產總額。

(2)股東權益報酬率=稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率=稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)／(固定資產毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度=營業利益／(營業利益-利息費用)。

(四)財務分析－我國財務會計準則(個體)

分析項目（註 2）			最 近 五 年 度 財 務 分 析（註 1）				
			101 年	102 年	103 年	104 年	105 年
財務結構 （%）	負債占資產比率		13.34	10.51	不適用		
	長期資金占固定資產比率		3,575.50	4,728.24			
償債能力	流動比率（%）		140.81	280.68			
	速動比率（%）		106.26	231.80			
	利息保障倍數		97.94	145.96			
經營能力	應收款項週轉率（次）		5.07	5.09			
	平均收現日數		72.06	71.71			
	存貨週轉率（次）		10.20	10.71			
	應付款項週轉率（次）		9.86	6.37			
	平均銷貨日數		35.78	34.08			
	固定資產週轉率（次）		12.50	20.99			
	總資產週轉率（次）		0.45	0.45			
獲利能力	資產報酬率（%）		8.59	13.17			
	股東權益報酬率（%）		9.59	14.86			
	占實收資本 比率（%）	營業利益	25.60	15.78			
		稅前純益	33.84	67.30			
	純益率（%）		19.07	28.78			
	每股盈餘（元）		3.44	6.22			
現金流量	現金流量比率（%）		34.62	60.17			
	現金流量允當比率（%）		265.39	121.48			
	現金再投資比率（%）		25.11	0.80			
槓桿度	營運槓桿度		1.14	1.21			
	財務槓桿度		1.01	1.03			
請說明最近二年度各項財務比率變動原因：因 103 年度已採用國際財務報導準則，故不適用。							

註1：本公司業於100年10月設立，101~102年度合併財務資料業經會計師查核簽證。

註2：財務分析公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+非流動負債)/固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

- (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
(6)固定資產週轉率=銷貨淨額/平均固定資產淨額。
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

4.獲利能力

- (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 x(1-稅率)〕/平均資產總額。
(2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5.現金流量

- (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
(2)現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

6.槓桿度

- (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。
(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告：

環球晶圓股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇五年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分配議案等，其中合併財務報表及個體財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及黃泳華會計師查核完竣並出具查核報告書。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，謹請鑒察。

此 敬

環球晶圓股份有限公司一〇六年股東常會

環球晶圓股份有限公司

審計委員會召集人：鄭繼雄



中 華 民 國 一 〇 六 年 五 月 九 日

四、最近年度財務報告：請參閱本年報附件一。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：請參閱本年報附件二。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	105 年度	104 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	22,212,281	12,004,772	10,207,509	85.03%
不動產、廠房及設備	31,035,540	9,360,910	21,674,630	231.54%
無形資產	4,436,073	701,566	3,734,507	532.31%
其他資產	2,876,343	1,748,512	1,127,831	64.50%
資產總額	60,560,237	23,815,760	36,744,477	154.29%
流動負債	24,890,930	4,883,614	20,007,316	409.68%
非流動負債	19,850,805	2,207,549	17,643,256	799.22%
負債總額	44,741,735	7,091,163	37,650,572	530.95%
股本	3,692,500	3,692,500	0	0.00%
資本公積	11,741,399	11,767,321	(25,922)	(0.22%)
保留盈餘	1,933,282	2,780,724	(847,442)	(30.48%)
股東權益總額	15,818,502	16,724,597	(906,095)	(5.42%)
1. 最近二年度增減比例達 20%者分析說明：主係 105 年 7 月及 12 月併購海外子公司故對科目金額增加，其相關財務比率亦增加。				
2. 影響重大者之未來因應計劃：無。				

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	105 年度	104 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	18,426,950	15,310,462	3,116,488	20.36%
營業毛利	4,130,383	4,073,170	57,213	1.40%
營業損益	1,378,347	2,684,922	(1,306,575)	(48.66%)
營業外收入及支出	(33,908)	122,804	(156,712)	(127.61%)
稅前淨利	1,344,439	2,807,726	(1,463,287)	(52.12%)
所得稅費用	405,268	763,533	(358,265)	(46.92%)
本期淨利	939,171	2,044,193	(1,105,022)	(54.06%)
其他綜合損益(稅後淨額)	(44,044)	175,322	(219,366)	(125.12%)
本期綜合損益總額	895,127	2,219,515	(1,324,388)	(59.67%)

1. 最近二年度增減比例達 20%者分析說明：

- (1)營業收入/成本：主係 105 年 7 月及 12 月併購海外子公司其相對營業收入增加，另其生產成本尚未發生效益，故其毛利下滑。
- (2)營業利益：主係 105 年 7 月及 12 月併購海外子公司其相對營業費用尚未發生效益，致整體營業利益減少。
- (3)營業外收入及支出：主係併購海外子公司償還借款之違約金。
- (4)所得稅費用：主係獲利減少故相對所得稅減少。
- (5)其他綜合損益：主係本期日圓升值，其產生國外營運機構財務報表之兌換差額之變動所致。
- (6)本期綜合損益：主係本期日圓升值，其產生國外營運機構財務報表之兌換差額之變動所致。

2. 預期銷售數量及其依據暨對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

因應全球半導體市場活絡，將持續擴充產能以因應市場需求，故對本公司未來財務業務之可能影響應屬正面。

三、現金流量：

(一)最近年度(105 年度)現金流量變動之分析說明

(1)財務分析

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額 (1)	全年來自營業 活 動 淨現金流量(2)	全 年 現金流出(入)量 (3)	現金剩餘(不 足) 數 額 (1)+(2)-(3)	現 金 不 足 額 之 補 救 措 施	
				投資計劃	理財計劃
1,966,051	2,677,763	(984,165)	5,627,979	NA	NA
本年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：因 105 年度持續獲利，故營業活動淨現金流入。					
(2)投資活動：因 105 年度購置固定資產等，使投資活動呈淨現金流出。					
(3)融資活動：因發放現金股利及新增借款等，使融資活動淨現金流入。					

(二)流動性不足之改善計畫：本公司無現金不足額之情形，尚無流動性不足之虞。

(三)未來一年度(106 年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額 (1)	預計全年來自 營 業 活 動 淨現金流量(2)	預 計 全 年 現金流出(入)量 (3)	預計現金剩 餘(不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額 之 補 救 措 施	
				投資計劃	理財計劃
5,627,979	5,485,996	4,322,191	1,163,805	NA	NA
1.未來一年度現金流動性分析：					
(1)營業活動：本公司預期營收在 106 年成長，獲利維持相對穩定，營業活動產生淨現金流入。					
(2)投資活動：因應營運成長所需購置研發/生產等設備，使投資活動產生淨現金流出。					
(3)融資活動：因發放現金股利及償還借款等，使融資活動淨現金流出。					
2.預計現金不足額之補救措施：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策：

本公司依循主管機關訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂有「取得或處分資產處理程序」作為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關之業務與財務狀況；另本公司為提升對轉投資公司之監督管理，於內部控制制度中訂定對子公司監控管理辦法，針對其資訊揭露、財務、業務、存貨及財務之管理制定相關規範，使本公司之轉投資事業得以發揮最大效用。

(二)最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣仟元

轉投資事業名稱	105 年度認列之投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
GlobalSemiconductor Inc.	67,882	營業狀況正常	無
GlobalWafers Inc.	57,788	營業狀況正常	無
GWafers Inc.	918,344	營業狀況正常	無
昆山中辰矽晶有限公司	58,924	營業狀況正常	無
GlobiTech Incorporated	57,788	營業及獲利狀況穩定	無
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	918,779	營業及獲利狀況穩定	無
Topsil GlobalWafers A/S	(144,673)	營業狀況正常	無
GWafers Singapore Pte. Ltd.	(744,986)	營業狀況正常	無
Topsil Semiconductor sp z o.o.	(56,594)	營業狀況正常	無
SunEdison Semiconductor Limited	(744,832)	營業狀況正常	無
SunEdison Semiconductor BV	(217,823)	營業狀況正常	無
SunEdison Semiconductor Technology Pte Ltd.	0	營業狀況正常	無
MEMC Japan Ltd.	649	營業狀況正常	無
MEMC Electronic Materials, SpA	(176,688)	營業狀況正常	無
MEMC Electronic Materials France SarL	(2,497)	營業狀況正常	無
MEMC Electronic Materials GmbH	(73)	營業狀況正常	無
MEMC Holding B.V.	(90,269)	營業狀況正常	無
MEMC Korea Company	(215,265)	營業狀況正常	無
SunEdison Semiconductor, LLC	(785,309)	營業狀況正常	無
MEMC Electronic Materials SDN BHD	(23,868)	營業狀況正常	無
SunEdison Semiconductor Holding BV	0	營業狀況正常	無
Taisil Electronic Materials Corp.	38,005	營業狀況正常	無
MEMC Ipoh Sdn Bhd	8,750	營業狀況正常	無
SunEdison Semiconductor Technology (Shanghai) Ltd	220	營業狀況正常	無
上海葛羅禾半導體科技有限公司	(492)	營業狀況正常	無

(三)未來一年投資計畫： 無。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司及子公司累積財務體質健全，信用記錄良好，金融機構授信條件較為優惠，因此公司在借款成本上能享有較佳之條件，借款內容依實質資金需求區分為短期借款及中長期借款，公司借款項目評估基準以取得資金之成本以及還款條件為主要考量，又部分週轉之短期信用借款屬於外幣幣別，動用時皆會考量匯率狀況作為工具選擇判斷。
- 2.匯率：本公司及子公司進銷貨交易外幣部位採自然避險為原則，降低曝露於匯率波動風險之淨部位，並由財務單位密切觀察匯率之走勢，並就外匯差額部位進行現匯部位之操作管理為主，不致對營運產生明顯風險。
- 3.通貨膨脹：最近年度通貨膨脹對公司損益面之影響尚不明顯，本公司及子公司亦隨時注意物價波動情形，必要時採取對應措施。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司及子公司並無從事高風險、高槓桿之投資。
- 2.本公司及子公司從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，係依本公司資金貸與他人作業程序、背書保證作業辦法、從事衍生性商品交易處理程序及主管機關相關規定辦理，並依規定期稽核及公告，執行單位亦會依循相關管理辦法進行內部審核及監控，不致對營運造成風險。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

半導體晶圓為半導體元件之基本，隨著半導體產品應用領域越趨廣泛且品質規格要求與日俱進，本公司持續觀察市場脈動及技術發展方向，配合客戶現在及潛在需求，積極投入新技術、新產品之開發，未來主要開發項目如下：

A、12 吋奈米製程矽基板技術開發

B、電動車高電壓特種基板技術開發

C、新世代感測元件與通訊元件基板技術開發

在研發費用方面，主要是依據新產品及新技術之開發時程逐步配合編列，本公司 104 年及 105 年研發費用佔營業收入總額之比重分別達 3.60%及 3.94%，未來將視營運狀況及市場情勢變化適時調整增加，以保持本公司在產業市場之競爭優勢。

類別	預計投入之研發費用 (新台幣仟元)	預計研究開發案說明
製程改善研究開發	200,000	1. 低能耗長晶熱場設計開發 2. 低污染線切割製程開發 3. 先進長晶/晶圓製程良率提升
品質改善研究開發	250,000	1. 晶體缺陷控制與量測技術開發 2. 超平坦矽晶圓加工技術開發

類別	預計投入之研發費用 (新台幣仟元)	預計研究開發案說明
		3. 原子級晶圓表面拋光技術開發 4. SOI 製程良率技術開發
設備改善研究開發	200,000	1. 自動化與數位化製造系統開發 2. 高生產力、高晶體品質、長晶爐設計開發 3. 低能耗製程設備設計開發
新產品開發	280,000	1. 半絕緣與較大尺寸碳化矽晶圓開發 2. 次世代 RF 元件用 SOI 基板開發 3. 異質磊晶技術開發

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司及子公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並適時主動提出因應措施，截至年報刊印日止，本公司及子公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，掌握市場趨勢，並評估其對本集團營運所帶來之影響。惟近年尚無重大科技改變或產業變化而對本公司及其子公司財務業務有重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司自設立以來專注於本業經營，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，以持續維持優良企業形象，增加客戶對公司之信任，本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，尚未有因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。惟企業危機之發生可能對企業產生相當大之損害，故本公司及子公司將持續落實各項公司治理要求，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司 105 年度分別於 7 月及 12 月併購了丹麥 Topsil Semiconductor Materials A/S 公司的半導體事業及美國的 SunEdison Semiconductor Ltd 公司，讓本公司躍升為全球第三大的半導體晶圓製造商。隨著公司規模快速成長，新併購事業體仍需進行組織及財務結構的整理與調整，因此經營團隊在 2017 年將以調整內部營運體質為主軸，優化各事業體的經營體質及效率，以讓新購的事業體轉虧為盈為首要任務，配合整體景氣翻揚的契機，加速完成整併工作，打造全新優質且具國際競

爭力的新環球晶圓本。本公司依「取得或處分資產作業程序」之規範辦理併購事宜，並秉持審慎評估之態度，以確實保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

105 年 10 月本公司之董事暨持股超過百分之十之大股東中美矽晶製品（股）公司，因資金運用，申報轉讓 24,000 仟股，該股權移轉對本公司尚無重大不利影響及風險。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件

1.截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

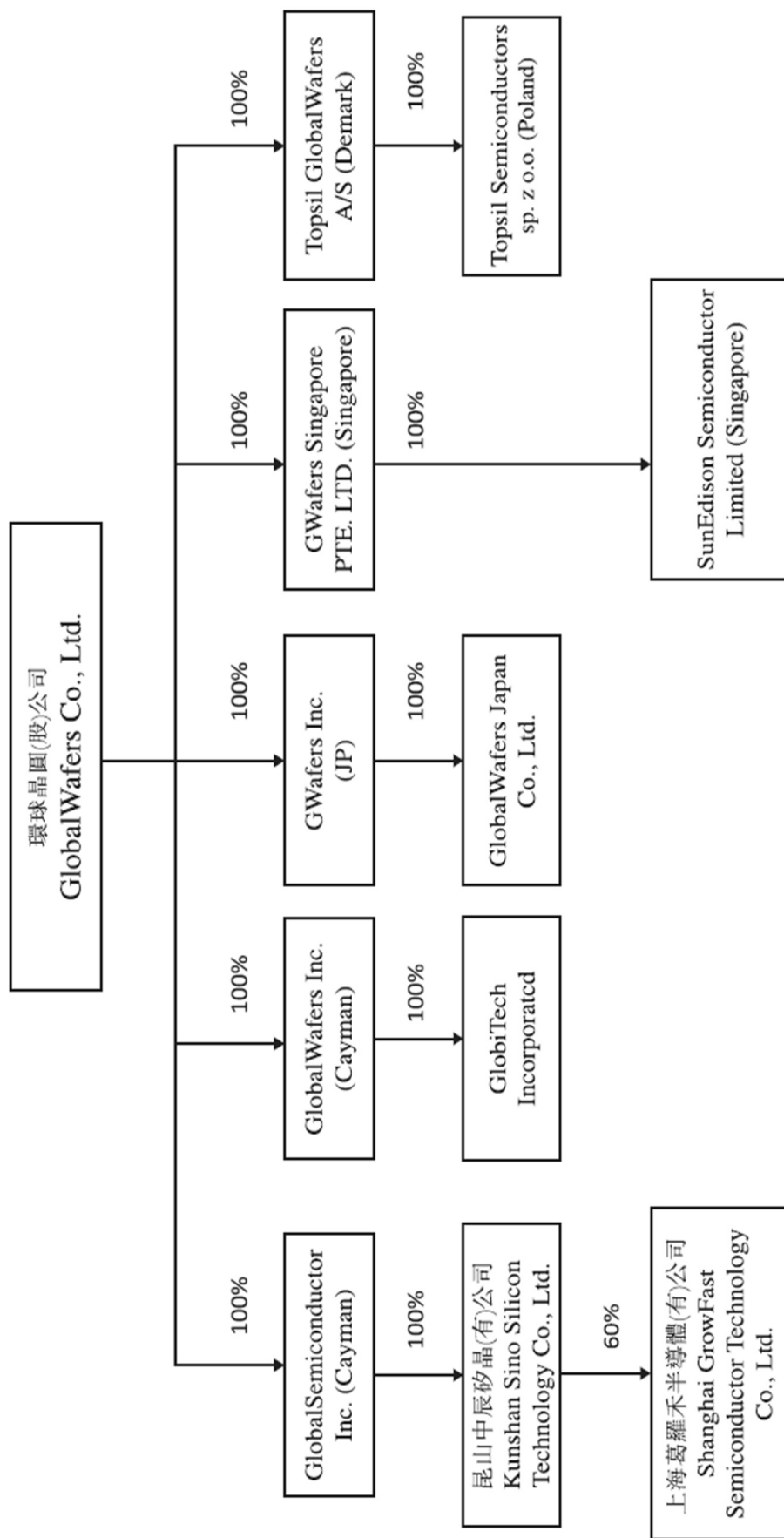
七、其他重要事項：無。

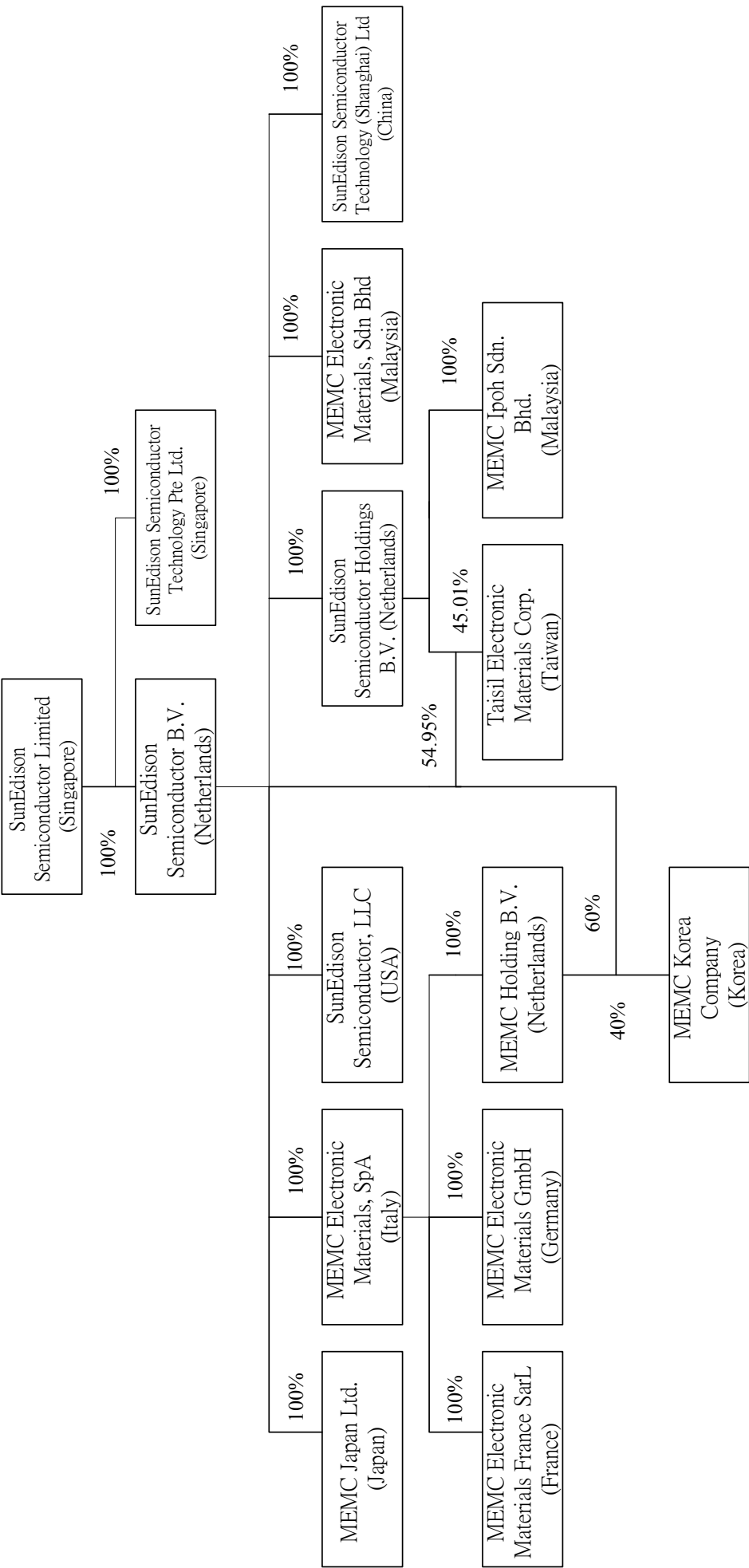
捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業之組織圖





2.各關係企業基本資料

105 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
GlobalWafers Inc.	2011/05/11	1st Floor, Windward 1, Regatta Office Park, P.O. Box 10338, Grand Cayman KY 1-1003	USD 1	投資各項事業及與大陸子公司之三角貿易中心
GlobalSemiconductor Inc.	2011/05/11	1st Floor, Windward 1, Regatta Office Park, P.O. Box 10338, Grand Cayman KY 1-1003	USD 26,555,000	投資各項事業
GWafers Inc.	2011/10/25	5-10-6, Nishiogikita, Suginami-ku, Tokyo, Japan	JPY 8,000,000	投資各項事業
昆山中辰矽晶有限公司	1999/08/11	大陸江蘇省昆山市崑山高科技工業園區	USD 26,555,000	矽晶棒矽晶圓等加工貿易
上海葛羅禾半導體科技有限公司	2016/05/20	上海市宝山市城市工业园区山連路 181 号(200444)	RMB 2,000,000	銷售及行銷業務
GlobiTech Incorporated	1998/12/15	200 FM 1417 West/Sherman, TX 75092, U S A	USD 1	磊晶矽晶圓生產及磊晶代工等貿易
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	2011/04/01	新潟縣北蒲原郡聖籍町東港大丁目 861 番地 5	JPY 6,967,000,000	半導體矽晶圓製造及貿易
GWafers Singapore Pte. Ltd.	2016/02/02	8 Wilkie Road, #03-01 Wilkie Edge, Singapore	USD 550,000,000	投資各項事業
Topsil GlobalWafers A/S	2016/07/01	Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund, Copenhagen, Denmark	DKK 1,000,000	半導體矽晶圓製造及貿易
Topsil Semiconductor sp z o.o.	2016/07/01	133 Wolczynska St., 01-919 Warsaw, Poland	PL 5,000	半導體矽晶圓製造及貿易
SunEdison Semiconductor Limited	2013/12/20	Block D #01-41A, 11 Lorong 3 Toa Payoh, Singapore 319579	-	投資、行銷及貿易業務
SunEdison Semiconductor B.V.	2013/11/26	Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, the Netherlands	USD 100	投資各項事業
SunEdison Semiconductor Technology Pte Ltd.	2014/05/15	9 Battery Road, #15-01 Straits Trading Building, Singapore, 049910	SGD 1	投資各項事業
MEMC Japan Ltd.	1979/12/11	Utsunomiya Plant 11-2 Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya City, Tochigi 3213296 Japan	JPY 100,000,000	半導體矽晶圓製造及銷售
MEMC Electronic Materials, SpA	1990/08/01	Viale Gherzi, 31 28100 Novara, Italy	EUR 31,200,000	半導體矽晶圓製造及銷售
SunEdison Semiconductor, LLC	2013/08/28	501 Pearl Drive St. Peters, MO 63376, USA	USD 10	半導體矽晶圓研發、製造及銷售

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或 生產項目
SunEdison Semiconductor Holdings B.V.	2013/11/26	Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, the Netherlands	USD 100	投資各項事業
MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd	1972/06/15	Sungai Way Free Industrial Zone, 47300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	MYR 1,036,203	半導體矽晶圓研發、製造及銷售
SunEdison Semiconductor Technology (Shanghai) Ltd	2015/04/21	Room 03B, Floor 16, Jiaqi Building, 666 Gubei Road, Changning District, Shanghai, China	RMB 1,500,000	貿易業務
MEMC Electronic Materials France SarL	1998/08/24	5-7 BLD EDGAR QUINET 92700 COLOMBES, France	EUR 16,000	貿易業務
MEMC Electronic Materials GmbH	1998/03/06	c/o Rene Schaeffler-Steinsdorfstr, 13, D-80538 Muenchen, Germany	EUR 200	貿易業務
MEMC Holding B.V.	2000/04/20	Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, the Netherlands	EUR 20,000	投資各項事業
Taisil Electronic Materials Corp.	1994/09/26	No. 2, Creation Road 1, HsinChu Science Park, Hsin chu, Taiwan	NTD 4,600,000	半導體矽晶圓製造及銷售
MEMC Ipoh Sdn. Bhd.	2007/10/10	No 5 Jalan Klebang 1 5 Kinta Free Trade Zone Chemor Ipoh Perak, 31200 Malaysia	MYR699,374,130	半導體矽晶圓研發、製造及銷售
MEMC Korea Company	1990/12/18	854, Manghyang-ro, Sunggeo-eup, Cheonan-si, Chungchongnam-do, Korea	KRW 86,000,000	半導體矽晶圓製造及銷售

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營所涵蓋之行業：詳各關係企業基本資料。

5.各關係企業董事、監察人及經理人資料

105 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	比例
GlobalWafers Inc.	董事	徐秀蘭	90,000,000 股	100%
GlobalSemiconductor Inc.	董事	徐秀蘭	25,000,000 股	100%
GWafers Inc.	董事	徐秀蘭	0 股	100%
	董事	Einoshin Endo		
昆山中辰矽晶有限公司	董事長	環球晶圓(股)公司 代表人：姚宕梁	0 股	100%
	副董事長	環球晶圓(股)公司 代表人：徐秀蘭		
	董事兼總經理	環球晶圓(股)公司 代表人：金敬長		
	董 事	環球晶圓(股)公司 代表人：洪聖雄		
	董 事	環球晶圓(股)公司 代表人：簡明輝		
	監 事	環球晶圓(股)公司 代表人：陳偉文		
上海葛羅禾半導體科技有 限公司	董事長	金敬長	0 股	100%
	董 事	徐秀蘭		
	董 事	賀賢漢		
	總經理	洪聖雄		
	監 事	陳偉文		
	監 事	TAKANORI SUZUKI		
GlobiTech Incorporated	董事長兼執行 長	環球晶圓(股)公司 代表人：徐秀蘭	1 股	100%
	董 事	環球晶圓(股)公司 代表人：盧明光		
	董 事	環球晶圓(股)公司 代表人：姚宕梁		
	董事兼總經理 總經理	環球晶圓(股)公司 代表人：Mark Lynn England		
	董 事	環球晶圓(股)公司 代表人：Curtis Hall		
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	董事長	環球晶圓(股)公司 代表人：徐秀蘭	128,002 股	100%
	董 事	環球晶圓(股)公司 代表人：盧明光		
	董 事	環球晶圓(股)公司 代表人：姚宕梁		
	董事兼社長	環球晶圓(股)公司 代表人：荒木隆		
	董 事	環球晶圓(股)公司 代表人：政岡徹		
	監察人	環球晶圓(股)公司 代表人：李崇偉		
GWafers Singapore Pte. Ltd.	董事長	徐秀蘭	550,000,028	100%
	董 事	姚宕梁		
	董 事	盧明光		
	董 事	胡慶堂		
Topsil GlobalWafers A/S	董 事	徐秀蘭	1,000,000 股	100%
	董 事	陳偉文		
	董 事	Hans Peder Mikkelsen		
	董 事	Sune Bro Duun		
	董 事	Jesper Leed Thomsen		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	比例
Topsil Semiconductor sp z o.o.	無董事會		100 股	100%
SunEdison Semiconductor Limited	董事	徐秀蘭	42,391,750	100%
	董事	Mark Lynn England		
	董事	Heng Thong Woo		
SunEdison Semiconductor B.V.	董事	徐秀蘭	100 股	100%
	董事	Johannes Petrus Vincentius Gerardus Visser		
SunEdison Semiconductor Technology Pte Ltd.	董事	Noor Hasna D/O Jani	1 股	100%
MEMC Japan Ltd.	董事兼會長	徐秀蘭	0 股	100%
	董事兼社長	荒木 隆		
	董事	李崇偉		
	監察人	菅原昌		
MEMC Electronic Materials, SpA	董事長	Mauro Pedrotti	65,000,000 股	100%
	董事	簡明輝		
	董事	盧致行		
	董事	Prof. Gianluigi Tosato		
	監察人	Richard Murphy		
	監察人	PierMario Barzaghi		
	監察人	Eleonora Guerriero		
SunEdison Semiconductor, LLC	總經理	Mark England	1,000 股	100%
	副總經理	Rick Boston		
SunEdison Semiconductor Holdings B.V.	董事	盧致行	100 股	100%
	董事	Johannes Petrus Vincentius Gerardus Visser		
MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd	董事	金敬長	1,036,203 股	100%
	董事	Tony Wang		
	董事	Joanne Leung		
SunEdison Semiconductor Technology (Shanghai) Ltd	無董事會		0 股	100%
MEMC Electronic Materials France SarL	無董事會		500 股	100%
MEMC Electronic Materials GmbH	無董事會		2 股	100%
MEMC Holding B.V.	董事	簡明輝	200 股	100%
	董事	Johannes Petrus Vincentius Gerardus Visser		
Taisil Electronic Materials Corp.	董事長	徐秀蘭	459,816,000 股	99.96%
	董事	薛銀陞		
	監察人	簡明輝		
MEMC Ipoh Sdn. Bhd.	董事	金敬長	699,374,130 股	100%
	董事	Tony Wang		
	董事	Joanne Leung		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	比例
MEMC Korea Company	董事長	徐秀蘭	17,200,000 股	100%
	董事	Charlie Cho		
	監察人	盧致行		

6.關係企業營運概況

各關係企業之財務狀況及經營結果

105 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期稅後損益	每股盈餘(稅後)
GlobalWafers Inc.	1	3,539,870	0	3,539,870	0	0	57,788	0
GlobalSemiconductor Inc.	756,809	950,332	9,053	941,279	46,964	6,902	67,882	0
Gwafers Inc.	2,713	9,460,624	333	9,460,291	0	(101)	918,344	0
昆山中辰矽晶有限公司	769,177	1,232,373	325,376	906,997	1,926,071	67,536	58,924	0
上海葛羅禾半導體科技有限公司	9,756	5,144	72	5,072	0	(823)	(821)	0
GlobiTech Incorporated	1	4,613,782	1,073,912	3,539,870	4,250,350	111,058	73,937	0
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	2,750,510	13,690,837	4,238,539	9,452,298	10,215,355	699,856	475,716	0
GWafers Singapore Pte. Ltd.	17,504,000	16,779,476	134	16,779,342	0	(154)	(744,986)	0
Topsil GlobalWafers A/S	4,832	1,970,893	235,701	1,735,192	377,246	(25,231)	(146,057)	0
Topsil Semiconductor sp z o.o.	41	299,162	345,550	(46,388)	1,231,789	(63,120)	(56,594)	0
SunEdison Semiconductor Limited	0	40,426,711	23,744,755	16,681,956	21,093,619	(923,045)	(739,168)	0
SunEdison Semiconductor B. V.	3	37,327,323	7,039,201	30,288,122	0	(7,922)	(217,823)	0
SunEdison Semiconductor Technology Pte Ltd.	0	0	0	0	0	0	0	0
MEMC Japan Ltd.	28,020	2,129,278	1,908,289	220,989	5,487,435	434,232	649	0
MEMC Electronic Materials, SpA	1,061,244	9,634,566	2,327,460	7,307,106	7,625,012	(222,457)	(176,688)	0
SunEdison Semiconductor, LLC	0	8,764,712	5,393,474	3,371,238	2,745,935	(3,049,276)	(785,309)	0
SunEdison Semiconductor Holdings B. V.	3	8,081,774	0	8,081,774	0	0	0	0
MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd	7,452	1,435,475	303,595	1,131,880	1,907,690	90,842	(23,868)	0

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期稅後損益	每股盈餘(稅後)
SunEdison Semiconductor Technology (Shanghai) Ltd	7,527	16,834	3,635	13,199	0	0	220	0
MEMC Electronic Materials France SarL	544	1,691	0	1,691	0	0	(2,497)	0
MEMC Electronic Materials GmbH	7	8,803	4,293	4,510	0	965	(73)	0
MEMC Holding B.V.	680	1,291,856	3,350	1,288,506	0	376	(90,269)	0
Taisil Electronic Materials Corp.	4,600,000	23,456,736	3,198,387	20,258,349	8,822,784	1,010,857	38,019	0
MEMC Ipoh Sdn Bhd	5,029,535	0	1,034,480	(1,034,480)	1,564,749	131,552	8,750	0
MEMC Korea Company	2,343	6,078,418	2,711,158	3,367,260	4,807,981	229,569	(215,265)	0

(二)關係企業合併財務報表：請參閱本年報附件一。

(三)關係企業報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：

本公司於上櫃掛牌後，應續行之承諾事項辦理情形

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂「公司不得放棄對 Global Semiconductor Inc.(以下簡稱 GSI)、Global Wafers Inc.(以下簡稱 GWI)及 GWafers Inc.(以下簡稱 GWafers)未來各年度之增資;GSI 不得放棄對昆山中辰矽晶有限公司未來各年度之增資;GWI 不得放棄 GlobiTech Incorporated 未來各年度之增資;GWafers 不得放棄對 Global Wafers Japan Co., Ltd.未來各年度之增資。未來若各該公司因策略聯盟考量或其他因素，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須先經櫃買中心同意，復提經公司董事會特別決議通過。」且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報本中心備查。	本公司已於 104 年 11 月 9 日董事會通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並於 105 年 6 月 22 日股東會通過。

五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

聲 明 書

本公司民國一〇五年度(自民國一〇五年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：環球晶圓股份有限公司

董 事 長：徐秀蘭



日 期：民國一〇六年三月二十一日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

環球晶圓股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

環球晶圓股份有限公司及其子公司(合併公司)民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一〇五年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列。相關之說明，請詳合併財務報告附註六(二十)收入。

關鍵查核事項之說明：

合併公司之營業收入來源為半導體矽晶材料及其元件之銷售，營業收入之認列時點係依與客戶約定的交易條件決定，考量營業收入的交易量大，且來自全球化之營運據點，因此，本會計師將收入認列列為執行合併公司合併財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解合併公司所採用的收入認列會計政策，並與銷售條款及收入認列條件比較以評估所採用政策的適當性；瞭解銷貨收入之內部控制制度設計，並抽樣測試其執行的有效性；抽樣測試個別收入交易，核對至客戶訂單、出貨證明及收款文件；抽樣選取年度結束日前後期間銷售交易作為樣本，檢視該等銷貨交易的銷售條件、出貨文件及客戶確認文件等，評估年末銷貨交易是否認列於適當的期間。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之假設及估計不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)。相關之說明，請詳合併財務報告附註六(四)存貨。

關鍵查核事項之說明：

合併公司主要係從事半導體矽晶材料之製造及銷售業務，相關產品應用面雖廣，然仍存在技術改變、庫存過時或呆滯的風險，考量存貨為合併公司的重要資產而需持續關注，因此，本會計師將存貨評價列為執行合併公司合併財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解合併公司存貨評價的提列政策，並評估其存貨評價是否已按既訂之會計政策執行；執行抽樣程序測試存貨庫齡報表的正確性，並分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣選取個別存貨項目為樣本，檢視各該存貨項目評價時所採用淨變現價值之來源及其合理性。

三、企業合併

有關企業合併之會計政策請詳合併財務報告附註四(十八)企業合併；企業合併之假設及估計不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)。相關之說明，請詳合併財務報告附註六(五)企業合併。

關鍵查核事項之說明：

合併公司為擴大全球銷售網絡及提昇產品研發能力，於民國一〇五年度收購Topsil Semiconductor Materials A/S旗下之半導體事業群及SunEdison Semiconductor Limited全數股權，取得對該等公司之控制力；上述收購的交易價格係為購買該等營運個體之營業資產、技術及商譽等項目，考量收購交易所涉及的會計處理係屬複雜，因此，本會計師將其列為合併公司合併財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：檢視股權收購合約，了解其交易對象、價款及相關約定，以辨認是否有影響此項交易之會計處理的特殊條款或應於合併財務報告額外揭露的事項；檢視合併公司將收購價格分攤於所取得之可辨認資產與負債的計算，並瞭解其所採用之公允價值的來源及合理性；檢視期後重大交易事項，辨認報導日後是否存有重大調整收購價格的情形；評估上述收購交易於合併財務報告之揭露是否適當。

其他事項

環球晶圓股份有限公司已編製民國一〇五年度及一〇四年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。

五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於合併公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國一〇五年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

曾漢鈺

曾漢鈺



會計師：

黃泳華

黃泳華



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一〇六年三月二十一日



環球晶圓股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇五年一月三十一日

單位：新台幣千元

	105.12.31	104.12.31	105.12.31	104.12.31
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 5,627,979	9	3,661,928	15
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	2,442	-	-	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及八)	7,565,402	13	4,458,730	19
1180 應收關係人款項(附註七)	76,835	-	78,969	-
130X 存貨(附註六(四))	7,306,767	12	3,261,656	14
1421 預付材料款	393,709	1	336,107	1
1470 其他流動資產(附註六(九))	711,970	1	161,968	1
1476 其他金融資產－流動(附註八)	527,177	1	45,414	-
	<u>22,212,281</u>	<u>37</u>	<u>12,004,772</u>	<u>50</u>
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產－非流動(附註六(六))	-	-	533,741	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	31,035,540	51	9,360,910	39
1805 無形資產(附註六(五)及八)	4,436,073	7	701,566	3
1900 其他非流動資產(附註六(九)、(十四)及(十六))	2,219,701	4	460,077	2
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	389,407	1	176,145	1
1995 長期預付材料款	267,235	-	578,549	3
	<u>38,347,956</u>	<u>63</u>	<u>11,810,988</u>	<u>50</u>
負債及權益：				
流動負債：				
短期借款(附註六(十))	2100 14,366,833	24	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	2120 209,208	-	317,819	1
應付票據及帳款	2170 1,783,894	3	795,715	3
應付關係人款項(附註七)	2180 3,490,870	6	1,094,015	5
應付薪資及獎金	2201 19,850,805	33	2,207,549	9
負債準備－流動(附註六(十三))	2250 44,741,735	74	7,091,163	30
其他流動負債(附註六(十二))	2300 -	-	-	-
一年內到期長期借款(附註六(十一))	2322 24,890,930	41	4,883,614	21
非流動負債：				
長期借款(附註六(十一))	2540 3,692,500	6	3,692,500	15
負債準備－非流動(附註六(十三))	2550 11,741,399	19	11,767,321	49
其他非流動負債(附註六(十二)及(十六))	2600 -	-	-	-
淨確定福利負債(附註六(十五))	2640 719,690	1	517,331	2
負債總計				
權益(附註六(五)、(十七)及(十八))：				
歸屬母公司業主之權益：				
普通股股本	3110 239,802	-	239,802	1
資本公積	3200 973,790	2	2,023,591	9
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310 1,933,282	3	2,780,724	12
特別盈餘公積	3320 (1,592,477)	(2)	(1,515,948)	(6)
未分配盈餘	3350 15,774,704	26	16,724,597	70
其他權益	3400 43,798	-	-	-
歸屬母公司業主權益小計				
非控制權益	36XX 15,818,502	26	16,724,597	70
權益總計				
負債及權益總計				
	<u>\$ 60,560,237</u>	<u>100</u>	<u>23,815,760</u>	<u>100</u>
資產總計				
	<u>\$ 60,560,237</u>	<u>100</u>	<u>23,815,760</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：徐秀齡



經理人：Mark Lynn England



會計主管：徐秀齡

環球晶圓股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		105年度		104年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(二十)及七)	\$ 18,426,950	100	15,310,462	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十三)、(十四)、(十五)、(廿一)及七)	14,296,567	78	11,237,292	73
	營業毛利	4,130,383	22	4,073,170	27
	營業費用(附註六(三)、(五)、(十四)、(十五)、(廿一)及七)：				
6100	推銷費用	401,468	2	285,822	2
6200	管理費用	1,624,362	9	551,859	4
6300	研究發展費用	726,206	4	550,567	4
	營業費用合計	2,752,036	15	1,388,248	10
	營業淨利	1,378,347	7	2,684,922	17
	營業外收入及支出：				
7010	利息收入(附註七)	13,924	-	27,183	-
7020	其他利益及損失(附註六(廿二)及七)	53,037	-	106,850	1
7050	利息費用	(100,869)	(1)	(11,229)	-
		(33,908)	(1)	122,804	1
	稅前淨利	1,344,439	6	2,807,726	18
7950	所得稅費用(附註六(十六))	405,268	1	763,533	5
	本期淨利	939,171	5	2,044,193	13
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	38,819	-	(31,191)	-
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十六))	(6,599)	-	10,574	-
		32,220	-	(20,617)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(231,788)	(1)	375,920	2
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	175,871	1	(175,871)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十六))	(20,347)	-	(4,110)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(76,264)	-	195,939	1
8300	本期其他綜合損益	(44,044)	-	175,322	1
	本期綜合損益總額	\$ 895,127	5	\$ 2,219,515	14
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 939,485	5	2,044,193	13
8620	非控制權益	(314)	-	-	-
		\$ 939,171	5	\$ 2,044,193	13
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 895,176	5	2,219,515	14
8720	非控制權益	(49)	-	-	-
		\$ 895,127	5	\$ 2,219,515	14
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
9710	基本每股盈餘	\$ 2.54		\$ 5.80	
9810	稀釋每股盈餘	\$ 2.54		\$ 5.78	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：徐秀鈴



環球晶圓股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	保留盈餘			國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差			其他權益項目			歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總計
				法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合 計	合 計	備供出售 金融商品 未實現損益	合 計					
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 3,175,000	2,074	9,311,229	307,788	-	2,116,610	2,424,398	(1,711,887)	-	(1,711,887)	13,200,814	-	13,200,814	-	13,200,814
本期淨利	-	-	-	-	-	2,044,193	2,044,193	-	-	-	2,044,193	-	2,044,193	-	2,044,193
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(20,617)	(20,617)	312,014	(116,075)	195,939	175,322	-	175,322	-	175,322
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,023,576	2,023,576	312,014	(116,075)	195,939	2,219,515	-	2,219,515	-	2,219,515
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	-	-	-	209,543	-	(209,543)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	239,802	(239,802)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(1,667,250)	(1,667,250)	-	-	-	(1,667,250)	-	(1,667,250)	-	(1,667,250)
資本公積配發現金股利	-	-	(323,475)	-	-	-	-	-	-	-	(323,475)	-	(323,475)	-	(323,475)
現金增資	517,500	(2,074)	2,776,250	-	-	-	-	-	-	-	3,291,676	-	3,291,676	-	3,291,676
員工認股權憑證酬勞成本	-	-	3,317	-	-	-	-	-	-	-	3,317	-	3,317	-	3,317
民國一〇四年十二月三十一日餘額	3,692,500	-	11,767,321	517,331	239,802	2,023,591	2,780,724	(1,399,873)	(116,075)	(1,515,948)	16,724,597	-	16,724,597	-	16,724,597
本期淨利(損)	-	-	-	-	-	939,485	939,485	-	-	-	939,485	(314)	939,171	(314)	939,171
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	32,220	32,220	(192,604)	116,075	(76,529)	(44,309)	265	(44,044)	265	(44,044)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	971,705	971,705	(192,604)	116,075	(76,529)	895,176	(49)	895,127	(49)	895,127
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	-	-	-	202,359	-	(202,359)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(1,819,147)	(1,819,147)	-	-	-	(1,819,147)	-	(1,819,147)	-	(1,819,147)
資本公積配發現金股利	-	-	(27,103)	-	-	-	-	-	-	-	(27,103)	-	(27,103)	-	(27,103)
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,847	43,847	43,847	43,847
員工認股權憑證酬勞成本	-	-	1,181	-	-	-	-	-	-	-	1,181	-	1,181	-	1,181
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 3,692,500	-	11,741,399	719,690	239,802	973,790	1,933,282	(1,592,477)	-	(1,592,477)	15,774,704	43,798	15,818,502	43,798	15,818,502

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐秀蘭

經理人：Mark Lynn England

會計主管：徐秀鈴

環球晶圓股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,344,439	2,807,726
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,579,832	1,240,764
攤銷費用	13,951	13,681
呆帳費用提列數	10,318	501
利息收入	(13,924)	(27,183)
利息費用	100,869	11,229
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(39,237)	-
員工認股權憑證酬勞成本	1,181	3,317
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	13,368	5,264
處分備供出售金融資產重衡量利益	(81,131)	-
非金融資產減損損失	104,248	-
提列存貨跌價損失	12,448	8,158
不影響現金流量之收益費損項目合計	1,701,923	1,255,731
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)	136,107	(844,360)
存貨	(48,528)	(440,658)
預付材料款	267,099	362,393
其他營業資產	138,449	(48,281)
其他金融資產	95,113	23,457
與營業活動相關之資產之淨變動合計	588,240	(947,449)
應付票據及帳款(含關係人)	174,439	(406,158)
負債準備	(358,680)	(346,931)
淨確定福利負債	(4,226)	90,635
其他營業負債	292,064	(2,638)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	103,597	(665,092)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	691,837	(1,612,541)
調整項目合計	2,393,760	(356,810)
營運產生之現金流入	3,738,199	2,450,916
收取之利息	13,295	27,965
支付之利息	(89,318)	(11,510)
支付之所得稅	(984,413)	(107,835)
營業活動之淨現金流入	2,677,763	2,359,536
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	-	(709,612)
併購取得子公司之淨現金流出	(16,968,015)	-
取得不動產、廠房及設備	(1,476,644)	(1,129,957)
處分不動產、廠房及設備	21,689	96,528
存出保證金增加	(44,985)	(5,419)
受限制銀行存款減少(增加)	(263,608)	325,327
其他金融資產增加	-	(7,636)
投資活動之淨現金流出	(18,731,563)	(1,430,769)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

(續下頁)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：徐秀鈴



環球晶圓股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(承上頁)

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	105年度	104年度
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	11,495,397	(1,373,478)
舉借長期借款	14,857,812	-
償還長期借款	(6,326,348)	-
發放現金股利	(1,846,250)	(1,990,725)
現金增資	-	3,291,676
非控制權益增加	3,876	-
籌資活動之淨現金流入(出)	18,184,487	(72,527)
匯率變動之影響	(164,636)	120,342
本期現金及約當現金增加數	1,966,051	976,582
期初現金及約當現金餘額	3,661,928	2,685,346
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,627,979	3,661,928
購併交易所取得資產及所承擔負債之公允價值如下：		
現金及約當現金	\$ 1,656,544	
透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,857	
應收票據及帳款淨額	3,250,963	
存貨	4,113,279	
其他流動資產	844,522	
不動產、廠房及設備	22,084,055	
無形資產	1,851,198	
其他非流動資產	1,884,078	
商譽	1,899,032	
短期借款	(299,900)	
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(68,283)	
應付票據及帳款	(3,567,868)	
其他流動負債	(4,534,826)	
一年內到期長期借款	(4,966,615)	
長期借款	(1,359,733)	
其他非流動負債	(3,339,030)	
非控制權益	(39,971)	
取得子公司權益於收購日之公允價值	19,415,302	
減：對被收購者原有權益之公允價值	(790,743)	
取得子公司之現金	(1,656,544)	
取得控制力所支付之現金(扣除所取得之現金)	\$ 16,968,015	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：徐秀鈴



環球晶圓股份有限公司及其子公司
合併財務報告附註
民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

環球晶圓股份有限公司(以下稱本公司)係於民國一〇〇年十月一日由中美矽晶製品股份有限公司(以下簡稱中美矽晶公司)將其半導體事業部門相關營業、資產及負債分割予本公司，並於民國一〇〇年十月十八日經科學工業園區管理局核准設立，註冊地址為新竹科學工業園區工業東二路八號。本公司民國一〇五年十二月三十一日之合併財務報告之組成包括本公司及本公司之子公司(以下併稱「合併公司」)。合併公司主要營業項目為半導體矽晶材料及其元件之研究開發、設計、製造及銷售，與前述相關產品之技術、管理資訊顧問業務服務。

本公司之股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心准予辦理上櫃交易，於民國一〇四年九月二十五日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一〇六年三月二十一日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)尚未採用金融監督管理委員會認可國際財務報導準則之影響

依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)民國一〇五年七月十八日金管證審字第1050026834號令，公開發行以上公司應自民國一〇六年起全面採用經金管會認可並發布生效之國際會計準則理事會(以下稱理事會)於民國一〇五年一月一日前發布，並於民國一〇六年一月一日生效之國際財務報導準則編製財務報告。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第10號、國際財務報導準則第12號及國際會計準則第28號之修正「投資個體：適用合併報表例外規定」	105年1月1日
國際財務報導準則第11號之修正「取得聯合營運權益之會計處理」	105年1月1日
國際財務報導準則第14號「管制遞延帳戶」	105年1月1日
國際會計準則第1號之修正「揭露倡議」	105年1月1日
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	105年1月1日
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號之修正「農業：生產性植物」	105年1月1日

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際會計準則第19號之修正「確定福利計畫：員工提撥」	103年7月1日
國際會計準則第27號之修正「單獨財務報表之權益法」	105年1月1日
國際會計準則第36號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	103年1月1日
國際會計準則第39號之修正「衍生工具之約務更替與避險會計之持續適用」	103年1月1日
2010-2012及2011-2013週期之年度改善	103年7月1日
2012-2014年國際財務報導年度改善	105年1月1日
國際財務報導解釋第21號「公課」	103年1月1日

合併公司經評估後認為適用上述新認可之國際財務報導準則將不致對合併財務造成重大變動。

(二)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列理事會已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋。截至本合併財務報告發布日止，除國際財務報導準則第9號及第15號業經金管會通過自民國一〇七年一月一日生效外，金管會尚未發布其他準則生效日。

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	107年1月1日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」	107年1月1日
國際財務報導準則第16號「租賃」	108年1月1日
國際財務報導準則第2號之修正「股份基礎給付交易之分類及衡量」	107年1月1日
國際財務報導準則第15號之修正「國際財務報導準則第15號之闡釋」	107年1月1日
國際會計準則第7號之修正「揭露倡議」	106年1月1日
國際會計準則第12號之修正「因未實現損失所產生遞延所得稅資產之認列」	106年1月1日
國際財務報導準則第4號「保險合約」之修正(適用國際財務報導準則第9號「金融工具」及國際財務報導準則第4號「保險合約」)	107年1月1日

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
2014-2016年國際財務報導年度改善：	
國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」	106年1月1日
國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」及國際會計準則第28號「投資關聯企業及合資」	107年1月1日
國際財務報導解釋第22號「外幣交易及預收付對價」	107年1月1日
國際會計準則第40號之修正「投資性不動產之轉換」	107年1月1日

對合併公司可能攸關者如下：

發布日	新發布或修訂準則	主要修訂內容
103.5.28 105.4.12	國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」	新準則以單一分析模型按五個步驟決定企業認列收入之方法、時點及金額，將取代現行國際會計準則第18號「收入」及國際會計準則第11號「建造合約」以及其他收入相關的解釋。 105.4.12發布修正規定闡明下列項目：辨認履約義務、主理人及代理人之考量、智慧財產之授權及過渡處理。
102.11.19 103.7.24	國際財務報導準則第9號「金融工具」	新準則將取代國際會計準則第39號「金融工具：認列與衡量」，主要修正如下： • 分類及衡量：金融資產係按合約現金流量之特性及企業管理資產之經營模式判斷，分類為按攤銷後成本衡量、透過其他綜合損益按公允價值衡量及透過損益按公允價值衡量。另指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債，其歸因於信用風險之公允價值變動數係認列於其他綜合損益。 • 減損：新預期損失模式取代現行已發生損失模式。 • 避險會計：採用更多原則基礎法之規定，使避險會計更貼近風險管理，包括修正達成、繼續及停止採用避險會計之規定，並使更多類型之暴險可符合被避險項目之條件等。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

發布日	新發布或修訂準則	主要修訂內容
105.1.13	國際財務報導準則第16號「租賃」	新準則將租賃之會計處理修正如下： • 承租人所簽訂符合租賃定義之所有合約均應於資產負債表認列使用權資產及租賃負債。租賃期間內租賃費用則係以使用權資產折舊金額加計租賃負債之利息攤提金額衡量。 • 出租人所簽訂符合租賃定義之合約則應分類為營業租賃及融資租賃，其會計處理與國際會計準則第17號「租賃」類似。

合併公司評估國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」及第9號「金融工具」將不致對合併公司財務狀況與經營結果產生重大影響，現正持續評估國際財務報導準則第16號「租賃」對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。除附註三外，下列會計政策已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」)編製。

(二) 編製基礎

1. 衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本合併財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)；
- (2) 依公允價值衡量之備供出售金融資產；
- (3) 淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值衡量。

2. 功能性貨幣及表達貨幣

合併公司每一個體均係以各營運所處主要經濟環境之貨幣為其功能性貨幣。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣，新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三) 合併基礎

1. 合併財務報告編製原則

合併財務報告之編製主體包含本公司及由本公司所控制之個體(即子公司)。當本公司暴露於來自對被投資個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對被投資個體之權力有能力影響該等報酬時，本公司控制該個體。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

自對子公司取得控制之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至喪失控制之日為止。合併公司間之交易、餘額及任何未實現收益與費損，業於編製合併財務報告時已全數消除。子公司之綜合損益總額係分別歸屬至本公司業主及非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額亦然。

子公司之財務報告業已適當調整，俾使其會計政策與合併公司所使用之會計政策一致。

合併公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失對子公司之控制者，係作為與業主間之權益交易處理。非控制權益之調整數與所支付或收取對價公允價值間之差額，係直接認列於權益且歸屬於本公司業主。

2.列入合併財務報告之子公司

列入本合併財務報告之子公司包含：

名 稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			105.12.31	104.12.31
本公司	GlobalSemiconductor Inc.(以下稱GSI)	投資各項事業	100%	100%
本公司	GlobalWafers Inc.(以下稱GWI)	投資各項事業	100%	100%
本公司	GWafers合同會社(以下稱GWafers)	投資各項事業	100%	100%
本公司	GWafers Singapore Pte. Ltd.(以下稱GWafers Singapore)	投資各項事業	100%	-
本公司	Topsil Globalwafers A/S(以下稱Topsil A/S)	半導體矽晶圓製造及貿易	100%	-
GSI	昆山中辰矽晶有限公司(以下稱昆山中辰)	矽晶棒、矽晶圓等加工貿易	100%	100%
GWI	GlobiTech Incorporated(以下稱GTI)	磊晶、矽晶圓生產及磊晶代工等貿易	100%	100%
GWafers	GlobalWafers Japan Co., Ltd.(以下稱GWJ)	半導體矽晶圓製造及貿易	100%	100%
昆山中辰	上海葛羅禾半導體科技有限公司(以下稱上海葛羅禾)	銷售及行銷業務	60%	-
Topsil A/S	Topsil Semiconductor sp z o.o.(以下稱Topsil PL)	半導體矽晶圓製造及貿易	100%	-
Gwafers Singapore	SunEdison Semiconductor Limited(以下稱SSL)	投資、行銷及貿易業務	100%	-
SSL	SunEdison Semiconductor B.V.(以下稱SSBV)	投資各項事業	100%	-

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

名 稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			105.12.31	104.12.31
SSL	SunEdison Semiconductor Technology Pte Ltd.(以下稱SST)	投資各項事業	100%	-
SSBV	MEMC Japan Ltd.(以下稱MEMC Japan)	半導體矽晶圓製造及銷售	100%	-
SSBV	MEMC Electronic Materials, SpA(以下稱MEMC SpA)	半導體矽晶圓製造及銷售	100%	-
MEMC SpA	MEMC Electronic Materials France SarL(以下稱MEMC SarL)	貿易業務	100%	-
MEMC SpA	MEMC Electronic Materials GmbH(以下稱MEMC GmbH)	貿易業務	100%	-
MEMC SpA	MEMC Holding B.V.(以下稱MEMC BV)	投資各項事業	100%	-
SSBV、MEMC BV	MEMC Korea Company(以下稱MEMC Korea)	半導體矽晶圓製造及銷售	100%	-
SSBV	SunEdison Semiconductor, LLC(以下稱SunEdison LLC)	半導體矽晶圓研發、製造及銷售	100%	-
SSBV	MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd(以下稱MEMC Sdn Bhd)	半導體矽晶圓研發、製造及銷售	100%	-
SSBV	SunEdison Semiconductor Technology (Shanghai) Ltd(以下稱SunEdison Shanghai)	貿易業務	100%	-
SSBV	SunEdison Semiconductor Holdings B.V. (以下稱SSHBV)	投資各項事業	100%	-
SSBV、SSHBV	Taisil Electronic Materials Corp.(以下稱Taisil)	半導體矽晶圓製造及銷售	99.96%	-
SSHBV	MEMC Ipoh Sdn Bhd(以下稱MEMC Ipoh)	半導體矽晶圓製造及銷售	100%	-

本公司為提升合併公司整體營運效益，於民國一〇五年二月於新加坡設立子公司GWafers Singapore。

本公司為拓展中國市場，於民國一〇五年六月由昆山中辰與上海申和熱磁電子有限公司共同出資設立60%持股之孫公司上海葛羅禾，自投資日起將其編入合併報表。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

本公司為擴展歐洲事業版圖，於民國一〇五年五月二十日董事會決議收購取得丹麥上市公司 Topsil Semiconductor Material A/S 旗下之半導體事業群(以下稱Topsil)。爾後，Topsil於民國一〇五年七月一日正式併入合併公司。另，合併公司於民國一〇五年八月四日經董事會決議將Topsil丹麥廠正式更名為Topsil GlobalWafers A/S (以下稱Topsil A/S)，波蘭廠正式更名為Topsil Semiconductor sp z o.o.(以下稱Topsil PL)。

合併公司為提升全球市占率、客戶群及其他晶圓技術與產能，於民國一〇五年八月十八日經董事會決議由GWafers Singapore以每股美金12元現金收購SunEdison Semiconductor Limited(以下稱SSL)全部流通在外普通股，包括償付SSL現有淨債務。SSL及其子公司於民國一〇五年十二月二日正式併入合併公司。

3.未列入合併財務報告之子公司：無。

(四)外幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

除非貨幣性之備供出售金融資產，換算所產生之外幣兌換差異認列於其他綜合損益外，其餘係認列為損益。

2.國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，包括收購時產生之商譽及公允價值調整，係依報導日之匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

對國外營運機構之貨幣性應收或應付項目，若尚無清償計畫且不可能於可預見之未來予以清償時，其所產生之外幣兌換損益視為對該國外營運機構淨投資之一部分而認列為其他綜合損益。

(五)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於合併公司正常營業週期中實現，或意圖將其出售或消耗者。
- 2.主要為交易目的而持有者。
- 3.預期將於資產負債表日後十二個月內實現者。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

4.現金或約當現金，但不包括於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於合併公司正常營業週期中清償者。
- 2.主要為交易目的而持有者。
- 3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
- 4.合併公司不能無條件將清償期限延期至資產負債表日後至少十二個月者。

(六)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(七)金融工具

金融資產與金融負債係於合併公司成為該金融工具合約條款之一方時認列。

1.金融資產

合併公司之金融資產分類為：透過損益按公允價值衡量之金融資產、備供出售金融資產及應收款。

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其係因其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。

此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失(包含相關股利收入及利息收入)認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(2)備供出售金融資產

此類金融資產係指定為備供出售或非屬其他類別之非衍生金融資產。原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；後續評價按公允價值衡量，除減損損失、按有效利率法計算之利息收入、股利收入及貨幣性金融資產外幣兌換損益認列於損益外，其餘帳面金額之變動係認列為其他綜合損益，並累積於權益項下之備供出售金融資產未實現損益。於除列時，將權益項下之利益或損失累計金額重分類至損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

此類金融資產若屬「無活絡市場公開報價且公允價值無法可靠衡量」之權益投資，則以成本減除減損損失後之金額衡量，並列報於「以成本衡量之金融資產」。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

權益投資之股利收入於合併公司有權利收取股利之日認列(通常係除息日)，並列報於營業外收入及支出項下。

(3)應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收票據及應收帳款。原始認列時按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量，後續評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

利息收入係列報於營業外收入及支出項下。

(4)金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

金融資產減損之客觀證據包括發行人之重大財務困難、違約(如利息或本金支付之延滯或不償付)、債務人將進入破產或其他財務重整之可能性大增，及由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失等。此外，備供出售權益投資之公允價值大幅或持久性下跌至低於其成本時，亦屬客觀之減損證據。

針對應收帳款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含合併公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收帳款係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。當判斷應收帳款無法收回時，係沖銷備抵帳戶。原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

當備供出售金融資產發生減損時，原先已認列於其他綜合損益之累計利益與損失金額將重分類為損益。

備供出售權益工具原先認列於損益之減損損失不得迴轉並認列為損益。任何認列減損損失後之公允價值回升金額係認列於其他綜合損益，並累積於其他權益項目之項下。備供出售債務工具之公允價值回升金額若能客觀地連結至減損損失認列於損益後發生之事項，則予以迴轉並認列為損益。

應收帳款之呆帳損失及迴升係列報於營業費用。應收帳款以外金融資產之減損損失及迴升係列報於營業外收入及支出項下。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(5)金融資產之除列

合併公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產所有權幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

除列單一金融資產之整體時，其帳面金額與已收取或可收取對價總額加計認列於其他綜合損益並累計於「其他權益－備供出售金融資產未實現評價損益」之金額間之差額係認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

當非除列單一金融資產之整體時，合併公司以移轉日各部分之相對公允價值為基礎，將該金融資產之原帳面金額分攤至因持續參與而持續認列之部分及除列之部分。分攤予除列部分之帳面金額與因除列部分所收取之對價加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失中分攤予除列部分之總和間之差額係認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。已認列於其他綜合損益之累計利益或損失，係依其相對公允價值分攤予持續認列部分與除列部分。

2.金融負債及權益工具

(1)負債或權益之分類

合併公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具上定義分類為金融負債或權益。

權益工具係指表彰合併公司於資產減除其所有負債後剩餘權益之任何合約。合併公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

與金融負債相關之利息及損失或利益係認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(2)其他金融負債

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者包括長短期借款及應付帳款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；後續評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。未資本化為資產成本之利息費用列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融負債之除列

合併公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額(包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債)間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(4)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於合併公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

3. 衍生金融工具

合併公司為規避外幣風險之暴險而持有衍生金融工具。原始認列時係按公允價值衡量，交易成本則認列為損益；後續評價依公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失直接列入損益，並列報於營業外收入及支出項下之其他利益及損失。當衍生工具之公允價值為正值時，列為金融資產；公允價值為負值時，列為金融負債。

(八) 存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用的地點及狀態所發生之取得、產製或加工成本及其他成本，並採加權平均法計算。製成品及在製品存貨之成本包括依適當比例按正常產能分攤之製造費用。

淨變現價值係指正常營業下之估計售價減除估計完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(九) 不動產、廠房及設備

1. 認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出。自建資產成本包含原料及直接人工、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本，以及符合要件資產資本化之借款成本。為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊率或折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，係由不動產、廠房及設備之帳面金額與處分價款之差額決定，並以淨額認列於營業外收入及支出項下之「其他利益及損失」。

2. 後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入合併公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3. 折舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計算，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

租賃資產之折舊若可合理確認合併公司將於租賃期間屆滿時取得所有權，則依其耐用年限提列；其餘租賃資產係依租賃期間及其耐用年限兩者較短者提列。

土地無須提列折舊。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

- (1)房屋及建築：2~40年
- (2)機器設備：2~15年
- (3)其他設備及租賃資產：2~20年
- (4)房屋及建築之重大組成部分主要有廠房主建築物、機電動力工程及廢水處理系統等，並分別按其耐用年限25~40年、25年及4~15年予以計提折舊。

合併公司至少於每一年度報導日檢視折舊方法、耐用年限及殘值，若預期值與先前之估計不同時，於必要時適當調整，該變動按會計估計變動規定處理。

(十)租賃

依租賃條件，當合併公司承擔了幾乎所有之所有權風險與報酬者，分類為融資租賃。原始認列時，該租賃資產依公允價值及最低租賃給付現值孰低衡量，續後，則依該資產相關之會計政策處理。

融資租賃之最低租賃給付依比例分攤於財務成本及降低尚未支付之負債。財務成本則依負債餘額按固定之期間利率分攤於各租賃期間。

其他租賃係屬營業租賃，該等租賃資產未認列於合併公司之資產負債表。

營業租賃之租金給付(不包括保險及維護等服務成本)依直線基礎於租賃期間認列為費用。

取得土地使用權之支出，以取得成本為入帳基礎，並按合約及估計受益期間孰短，按五十年及九十九年平均攤提。

(十一)無形資產

1.商譽

(1)原始認列

收購子公司產生之商譽已包含於無形資產。

(2)後續衡量

商譽係依成本減累計減損予以衡量。關於採用權益法之投資，商譽之帳面金額係包含於投資之帳面金額內，且此類投資之減損損失並未分配至商譽及任何資產，而係作為採用權益法之投資帳面金額的一部分。

2.研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1)完成無形資產之技術可行性已達成，將使該無形資產將可供使用或出售。
- (2)意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
- (3)有能力使用或出售該無形資產。
- (4)無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5)具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6)歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

3.其他無形資產

合併公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

4.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方可將其資本化。所有其他支出於發生時認列於損益。

5.攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額。

除商譽外，無形資產自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益：

- (1)專利及商標：4~6年
- (2)資本化之發展成本：10年

合併公司至少於每一年度報導日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十二)非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，合併公司於每一報導日評估是否發生減損，並就有減損跡象之資產估計其可回收金額。若無法估計個別資產之可回收金額，則合併公司估計該項資產所屬現金產生單位之可回收金額以評估減損。

可回收金額為個別資產或現金產生單位之公允價值減出售成本與其使用價值孰高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於帳面金額，則將該個別資產或現金產生單位之帳面金額調整減少至可回收金額，並認列減損損失。減損損失係立即認列於當期損益。

商譽每年定期進行減損測試，並就可回收金額低於帳面金額之部分，認列減損損失。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

為減損測試之目的，企業合併取得之商譽應分攤至合併公司預期可自合併綜效受益之各現金產生單位(或現金產生單位群組)。若現金產生單位之可回收金額低於其帳面金額，減損損失係先就已分攤至該現金產生單位之商譽，減少其帳面金額，次就該單位內各資產之帳面金額等比例分攤至各資產。已認列之商譽減損損失，不得於後續期間迴轉。

合併公司於每一報導日重新評估是否有跡象顯示，商譽以外之非金融資產於以前年度所認列之減損損失可能已不存在或減少。若用以決定可回收金額之估計有任何改變，則迴轉減損損失，以增加個別資產或現金產生單位之帳面金額至其可回收金額，惟不超過若以前年度該個別資產或現金產生單位未認列減損損失之情況下，減除應提列折舊或攤銷後之帳面金額。

(十三)負債準備

負債準備之認列係因過去事件而負有現時義務，使合併公司未來很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務，且該義務之金額能可靠估計。負債準備係以反映目前市場對貨幣時間價值及負債特定風險評估之稅前折現率予以折現，折現之攤銷則認列為利息費用。

1.廠址復原

依據合併公司公佈之環境政策和適用之法規要求，針對環境整治義務提列復原負債準備，且於土地遭受污染期間認列相關費用及針對承租之土地提列復原負債準備，且於租賃期間認列相關費用。

2.虧損性合約

當合併公司預期一項合約之義務履行所不可避免之成本超過預期從該合約獲得之經濟效益時，予以認列該虧損性合約之負債準備。該項負債準備係以終止合約之預計成本與持續該合約之預計淨成本孰低者之現值衡量，並於認列虧損性合約負債準備前先行認列與該合約相關資產之所有減損損失。

(十四)收入認列

1.商品銷售

係正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在(通常為已簽訂之客戶訂單)、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回、相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

風險及報酬移轉之時點係視銷售合約個別條款而定。外銷交易主要採起運點交貨，風險及報酬係於港口將貨品運裝上船時移轉予買方；對於內銷交易，風險及報酬則通常於商品送達客戶倉庫驗收時移轉。

2. 勞務

合併公司提供勞務服務予客戶。提供勞務所產生之收入係按報導期間結束日之交易完成程度認列。

3. 政府補助款

合併公司對政府之研發補助係依合約按已發生成本佔預計總計畫成本之比例，逐期認列於營業外收入及支出項下。對政府補助設備支出之補助收入款，則列為資產帳面成本減項，於耐用年限內採直線法將補助透過減少折舊費用認列於損益。

(十五) 員工福利

1. 確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2. 確定福利計畫

非屬確定提撥計畫之退職福利計畫為確定福利計畫。合併公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係分別針對各項福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何計畫資產的公允價值均予以減除。折現率係以到期日與合併公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於財務報導日之利率為主。

企業淨義務每年由合格精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對合併公司有利時，認列資產係以未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於合併公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對合併公司而言，即具有經濟效益。

當計畫內容之福利改善，因員工過去服務使福利增加之部分，相關費用立即認列為損益。

淨確定福利負債(資產)之再衡量數包含(1)精算損益；(2)計畫資產報酬，但不包括包含於淨確定福利負債(資產)淨利息之金額；及(3)資產上限影響數之任何變動，但不包括包含於淨確定福利負債(資產)淨利息之金額。淨確定福利負債(資產)再衡量數認列於其他綜合損益項目下。合併公司並已選擇將該等已認列於其他綜合損益項目下之金額轉入保留盈餘。

合併公司於縮減或清償發生時，認列確定福利計畫之縮減或清償損益。縮減或清償損益包括任何計畫資產公允價值之變動及確定福利義務現值之變動。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使合併公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十六)股份基礎給付交易

給與員工之股份基礎給付獎酬以給與日之公允價值，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列酬勞成本並增加相對權益。認列之酬勞成本係隨預期符合服務條件之獎酬數量予以調整；而最終認列之金額係以既得日符合服務條件之獎酬數量為基礎衡量。

(十七)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。下列情況產生之暫時性差異不予認列遞延所得稅：

- 1.非屬企業合併之交易原始認列之資產或負債，且於交易當時不影響會計利潤及課稅所得(損失)者。
- 2.因投資子公司及合資權益所產生，且很有可能於可預見之未來不會迴轉者。
- 3.商譽之原始認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

合併公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；
 - (1)同一納稅主體；或
 - (2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

對於未使用之課稅損失及未使用所得稅抵減遞轉後期，與可減除暫時性差異，在很有可能未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

(十八) 企業合併

合併公司依收購日移轉對價之公允價值，包括歸屬於被收購方任何非控制權益之金額，減除所取得之可辨認資產及承擔之負債之淨額(通常為公允價值)來衡量商譽。若減除後之餘額為負數，則合併公司重新評估是否已正確辨認所有取得之資產及所有承擔之負債後，始將廉價購買利益認列於損益。

除與發行債務或權益工具相關者外，與企業合併相關之交易成本均應於發生時立即認列為合併公司之費用。

被收購者之非控制權益中，若屬現時所有權權益，且其持有者有權於清算發生時按比例份額享有企業淨資產者，合併公司係依逐筆交易基礎，選擇按收購日之公允價值或按現時所有權工具對被收購者可辨認淨資產之已認列金額所享有之比例份額衡量之。其他非控制權益則按其收購日之公允價值或依金管會認可之國際財務報導準則所規定之其他基礎衡量。

於分階段達成之企業合併中，合併公司以收購日之公允價值重新衡量其先前已持有被收購者之權益，若因而產生任何利益或損失，則認列為損益。對於被收購者權益價值之變動於收購日前已於其他綜合損益中認列之金額，應依合併公司若直接處分其先前已持有權益之相同方式處理，若處分該權益時宜將其重分類至損益，則該金額係重分類至損益。

若企業合併之原始會計處理於合併交易發生之報導日前尚未完成，合併公司對於尚不完整之會計處理項目係以暫定金額認列，並於衡量期間內予以追溯調整或認列額外之資產或負債，以反映於衡量期間所取得關於收購日已存在事實與情況之新資訊。衡量期間自收購日起不超過一年。

(十九) 每股盈餘

合併公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。合併公司基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括尚未經股東會決議且得採股票發放之員工酬勞。

(二十) 部門資訊

營運部門係合併公司之組成部分，從事可能賺得收入並發生費用(包括與合併公司內其他組成部分間交易相關之收入及費用)之經營活動。所有營運部門之營運結果均定期由合併公司主要營運決策者複核，以制定分配資源予該部門之決策並評量其績效。各營運部門均具單獨之財務資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依證券發行人財務報告編製準則編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理階層持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

本合併財務報告所採用之會計政策未有涉及重大判斷。

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險可能於次一年度造成調整之相關資訊如下：

(一)存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，合併公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動。存貨評價估列情形請詳附註六(四)。

(二)企業合併

合併公司為擴大全球銷售網絡及提昇產品研發能力，於民國一〇五年度收購Topsil及SSL全數股權，取得對該等公司之控制力。上述收購的交易價格係為購買該等營運個體之營業資產、技術及商譽等項目，有關所取得之可辨認資產與負債的公允價值認列可能涉及管理階層之假設及估計不確定性。有關企業合併之說明，請詳附註六(五)。

合併公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量金融、非金融資產及負債。合併公司財務及會計部門負責進行獨立公允價值驗證，藉獨立來源資料使評價結果貼近市場狀態、確認資料來源係獨立、可靠、與其他資源一致以及代表可執行價格，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

合併公司在衡量資產及負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，其歸類如下：

- 第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。
- 第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。
- 第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，合併公司係於報導日認列該移轉。衡量公允價值所採用假設之相關資訊詳下列附註六(廿三)金融工具。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	105.12.31	104.12.31
現金	\$ 778	485
銀行存款	5,236,389	2,504,011
定期存款	390,812	1,157,432
	<u>\$ 5,627,979</u>	<u>3,661,928</u>

合併公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(廿三)。

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債

	105.12.31	104.12.31
指定透過損益按公允價值衡量之金融資產：		
遠期外匯合約	\$ <u>2,442</u>	-
指定透過損益按公允價值衡量之金融負債：		
遠期外匯合約	\$ <u>23,631</u>	-

從事衍生金融工具交易用以規避因營業活動所暴露之匯率風險，合併公司因未適用避險會計列報為持有供交易之金融資產及金融負債之衍生工具明細如下：

105.12.31				
	合約金額(千元)		幣別	到期期間
賣出遠期外匯	USD	6,096	美元兌日圓	106.1.10~106.2.20
賣出遠期外匯	USD	14,600	美元兌歐元	106.1.24~106.2.23
賣出遠期外匯	USD	5,746	美元兌韓元	106.1.25
買入遠期外匯	NTD	25,559	新台幣兌美元	106.1.19
買入遠期外匯	JPY	775	日幣兌歐元	106.1.18
買入遠期外匯	JPY	1,539	日幣兌韓元	106.1.25

(三)應收票據及帳款淨額

	105.12.31	104.12.31
應收票據	\$ 108,416	93,251
應收帳款	7,486,768	4,369,993
減：備抵呆帳	(12,504)	(2,186)
備抵退回及折讓	<u>(17,278)</u>	<u>(2,328)</u>
	<u>\$ 7,565,402</u>	<u>4,458,730</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

應收款項備抵呆帳之變動如下：

	105年度	104年度
1月1日餘額	\$ 2,186	1,685
認列之減損損失	10,318	501
12月31日餘額	<u>\$ 12,504</u>	<u>2,186</u>

合併公司報導日已逾期但未減損應收款(含關係人)之帳齡分析如下：

	105.12.31	104.12.31
逾期1~30天	\$ 108,031	74,840
逾期31~60天	54,847	5,522
逾期61~90天	2,700	-
逾期91~120天	225	-
逾期121~150天	2,222	361
逾期151~180天	491	41
逾期181~365天	500	-
	<u>\$ 169,016</u>	<u>80,764</u>

上列已逾期但未提列減損之應收帳款，合併公司就部份客戶之應收帳款存有相對應的債務計83,108千元(約美金2,577千元)可供抵扣，餘經評估其信用品質未發生重大改變，故無減損疑慮。另，合併公司就該等應收帳款未取具任何擔保品。

合併公司為控制應收帳款之信用風險於報導日從事應收帳款讓售之情形如下：

合併公司與銀行及應收帳款承購商簽訂無追索權之出售應收帳款債權合約，依合約規定，合併公司於出售額度內無須擔保應收帳款債務人於債權移轉時及債務履行時之支付能力。合併公司於各報導日符合除列條件尚未到期之讓售應收帳款相關資訊明細如下：

單位：日圓千元

105.12.31					
讓售對象	除列金額	額 度	已 預 支 金 額	利 率 區 間	擔保項目
三菱UFJ等應收帳 款承購商	\$ 1,066,019	1,066,019	1,066,019	1.175%~ 1.475%	無
104.12.31					
讓售對象	除列金額	額 度	已 預 支 金 額	利 率 區 間	擔保項目
DAISHI BANK等	\$ 975,981	6,000,000	975,981	0.430%~ 1.475%	無

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

上述應收帳款讓售合約，其額度可循環使用。

合併公司與金融機構簽訂無追索權之應收帳款讓售合約，依合約約定，合併公司對於在特定期間內無法回收(不論是延遲支付或違約)之所有應收款項提供保證，仍保留該應收帳款之幾乎所有風險及報酬，因此不符合金融資產除列條件。於報導日未除列之已移轉應收帳款及相關金融負債之帳面金額如下：

單位：日圓千元

105.12.31					
讓售對象	已移轉應收 帳款金額	額 度	已預支金額 (列報於短 期借款)	利 率 區 間	擔保項目
DAISHI BANK	\$ 634,156	4,000,000	634,156	0.3573%~ 0.3737%	無

民國一〇五年十二月三十一日，合併公司之應收帳款已作為短期借款擔保之明細，請詳附註八。

(四)存 貨

	105.12.31	104.12.31
製成品	\$ 2,176,124	1,321,721
在製品	2,365,503	569,526
原料	2,633,636	1,223,422
物料	131,504	146,987
	<u>\$ 7,306,767</u>	<u>3,261,656</u>

營業成本組成明細如下：

	105年度	104年度
銷貨成本	\$ 14,238,436	11,165,024
提列存貨跌價損失	12,448	8,158
未分攤固定製造費用	45,683	64,110
	<u>\$ 14,296,567</u>	<u>11,237,292</u>

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(五)企業合併

1.合併公司於民國一〇五年七月一日透過收購丹麥上市公司旗下之半導體事業群Topsil 100%之股權而取得控制。Topsil是全球主要的Float Zone技術開發者及Float Zone晶圓製造公司，亦是全球領先的中子照射超純矽晶圓供應商。合併公司透過此次購併，得以擴大公司之營運規模，並整合其銷售路線，擴展歐洲事業版圖，讓產品組合更為完整。

合併公司民國一〇五年度因Topsil之收購交易所發生之法律費用及審查成本計130千元，該等費用認列於綜合損益表之「管理費用」項下。

合併公司以丹麥克朗407,600千元(1,964,069千元)收購Topsil 100%之股權。

收購日取得Topsil之可辨認資產與承擔之負債之公允價值明細如下：

現金及約當現金	\$ 5,943
應收票據及帳款淨額	153,566
存 貨(附註六(四))	669,483
其他流動資產	57,622
不動產、廠房及設備(附註六(七))	960,851
無形資產(附註六(八))	161,357
其他非流動資產	77,438
應付票據及帳款	(206,570)
其他流動負債	(203,272)
其他非流動負債	(94,321)
	<u>\$ 1,582,097</u>

因收購取得Topsil認列之商譽如下：

移轉對價	\$ 1,964,069
減：可辨認淨資產之公允價值	<u>(1,582,097)</u>
商譽	<u>\$ 381,972</u>

2.合併公司於民國一〇五年十二月二日收購SSL全部流通在外普通股，而取得對SSL之控制。SSL為世界領先半導體矽晶圓製造與供應商。自創立以來，SSL一直是矽晶圓設計與研發技術的領導者。SSL研發製造據點遍布美國、歐洲及亞洲，致力於研發下一代高效能半導體矽晶圓。合併公司透過此次購併，得以提升全球市占率、客戶群及其他晶圓技術與產能及擴大營運規模。

合併公司民國一〇五年度因SSL收購交易所發生之評估費用及專業諮詢等費用為304,579千元，帳列「管理費用」項下。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司以美金546,975千元(17,451,233千元)收購SSL 100%股權。

合併公司收購SSL股權並取得控制力之移轉對價包括：

項 目	金 額
現金(美金484,272千元)	\$ 15,450,709
替代之股份基礎給付報酬(註)	1,209,781
對被收購者原有權益之公允價值	<u>790,743</u>
	<u>\$ 17,451,233</u>

註：係以現金結清流通在外之未既得員工限制權利新股，及未執行之員工認股權憑證。

合併公司於收購日前已持有之SSL股權原帳列備供出售金融資產—非流動項下，於收購日依公允價值重衡量而認列利益81,131千元，該利益係認列於合併綜合損益表之其他利益及損失項下。

收購日取得SSL之可辨認資產與承擔之負債之公允價值明細如下：

現金及約當現金	\$ 1,650,601
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	7,857
應收票據及帳款淨額	3,097,397
存 貨(附註六(四))	3,443,796
其他流動資產	786,900
不動產、廠房及設備(附註六(七))	21,123,204
無形資產(附註六(八))	1,689,841
其他非流動資產(附註六(十六))	1,806,640
短期借款	(299,900)
透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	(68,283)
應付票據及帳款	(3,361,298)
其他流動負債(附註六(十三))	(4,331,554)
一年以內到期之長期借款	(4,966,615)
長期借款	(1,359,733)
其他非流動負債(附註六(十三)及(十五))	(3,244,709)
非控制權益	<u>(39,971)</u>
	<u>\$ 15,934,173</u>

因收購取得SSL認列之商譽如下：

移轉對價	\$ 17,451,233
減：可辨認淨資產之公允價值	<u>(15,934,173)</u>
商譽	<u>\$ 1,517,060</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

3.商譽主要係來自Topsil及SSL產品之市場佔有率及獲利能力，預期將藉由該公司與合併公司之業務整合以產生合併綜效，認列商譽預期無所得稅效果。

4.自收購日至民國一〇五年十二月三十一日止，Topsil及SSL所貢獻之收入及稅前淨損，分別為2,932,436千元及890,889千元。若此項收購發生於民國一〇五年一月一日，管理階層估計民國一〇五年一月一日至十二月三十一日合併公司之收入將達41,352,782千元，稅前淨損將為4,827,596千元。於決定該等金額時，管理階層係假設該收購發生於民國一〇五年一月一日，且假設收購日所產生之暫定公允價值調整係相同。

(六)備供出售金融資產－非流動

	105.12.31	104.12.31
國外上市(櫃)公司股票	\$ <u>-</u>	<u>533,741</u>

合併公司之備供出售金融資產均未有提供作質押擔保之情形。

如報導日權益證券價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)，對其他綜合損益項目之影響如下：

報導日證券價格	105年度	104年度
上漲10%	\$ <u>-</u>	<u>53,374</u>
下跌10%	\$ <u>-</u>	<u>(53,374)</u>

合併公司於民國一〇五年十二月二日取得對SSL之控制力，因此，依公允價值衡量其原持有帳列於備供出售金融資產之SSL股份，請詳附註六(五)說明。

(七)不動產、廠房及設備

1.合併公司不動產、廠房及設備之成本、折舊變動明細如下：

	土 地	房屋及 建 築	機器設備	其他設備	未完工程 及 待驗設備	總 計
成本：						
民國105年1月1日餘額	\$ 723,249	10,362,016	31,982,316	1,724,024	517,996	45,309,601
透過企業合併取得	2,283,872	5,018,381	12,567,026	311,464	1,903,312	22,084,055
增 添	-	24,020	384,403	173,681	642,791	1,224,895
重 分 類	-	237,933	1,559,513	101,167	(1,898,613)	-
處 分	-	(10,305)	(737,564)	(29,914)	(11,828)	(789,611)
匯率變動之影響	<u>30,018</u>	<u>47,557</u>	<u>170,160</u>	<u>(74,958)</u>	<u>(26,079)</u>	<u>146,698</u>
民國105年12月31日餘額	\$ <u>3,037,139</u>	<u>15,679,602</u>	<u>45,925,854</u>	<u>2,205,464</u>	<u>1,127,579</u>	<u>67,975,638</u>
民國104年1月1日餘額	\$ 701,606	10,028,466	30,406,557	1,808,292	264,662	43,209,583
增 添	-	44,120	1,048,316	142,259	236,017	1,470,712
處 分	-	(16,704)	(343,512)	(245,012)	-	(605,228)
匯率變動之影響	<u>21,643</u>	<u>306,134</u>	<u>870,955</u>	<u>18,485</u>	<u>17,317</u>	<u>1,234,534</u>
民國104年12月31日餘額	\$ <u>723,249</u>	<u>10,362,016</u>	<u>31,982,316</u>	<u>1,724,024</u>	<u>517,996</u>	<u>45,309,601</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	土 地	房屋及 建 築	機器設備	其他設備	未完工程 及 待驗設備	總 計
折舊：						
民國105年1月1日餘額	\$ -	6,030,859	28,602,654	1,315,178	-	35,948,691
本期折舊	-	328,589	1,078,650	172,593	-	1,579,832
處 分	-	(6,822)	(718,638)	(29,094)	-	(754,554)
匯率變動之影響	-	17,746	179,821	(31,438)	-	166,129
民國105年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>6,370,372</u>	<u>29,142,487</u>	<u>1,427,239</u>	<u>-</u>	<u>36,940,098</u>
民國104年1月1日餘額	\$ -	5,598,882	27,358,648	1,280,004	-	34,237,534
本期折舊	-	270,475	756,890	213,399	-	1,240,764
處 分	-	(15,747)	(293,578)	(194,111)	-	(503,436)
匯率變動之影響	-	177,249	780,694	15,886	-	973,829
民國104年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>6,030,859</u>	<u>28,602,654</u>	<u>1,315,178</u>	<u>-</u>	<u>35,948,691</u>
帳面價值：						
民國105年12月31日	<u>\$ 3,037,139</u>	<u>9,309,230</u>	<u>16,783,367</u>	<u>778,225</u>	<u>1,127,579</u>	<u>31,035,540</u>
民國104年1月1日	<u>\$ 701,606</u>	<u>4,429,584</u>	<u>3,047,909</u>	<u>528,288</u>	<u>264,662</u>	<u>8,972,049</u>
民國104年12月31日	<u>\$ 723,249</u>	<u>4,331,157</u>	<u>3,379,662</u>	<u>408,846</u>	<u>517,996</u>	<u>9,360,910</u>

2.擔 保

作為短期借款及融資額度擔保之明細，請詳附註八。

(八)無形資產

合併公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日無形資產之成本及攤銷明細如下：

	商 譽	專利權及 商 標	發展成本	總 計
成 本：				
民國105年1月1日餘額	\$ 701,566	-	-	701,566
企業合併取得	1,899,032	1,689,841	161,357	3,750,230
匯率變動影響數	(14,977)	18,272	(8,066)	(4,771)
民國105年12月31日餘額	<u>\$ 2,585,621</u>	<u>1,708,113</u>	<u>153,291</u>	<u>4,447,025</u>
民國104年1月1日餘額	\$ 676,453	-	-	676,453
匯率變動影響數	25,113	-	-	25,113
民國104年12月31日餘額	<u>\$ 701,566</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>701,566</u>
攤 銷：				
民國105年1月1日餘額	\$ -	-	-	-
本期攤銷	-	2,287	8,838	11,125
匯率變動影響數	-	(1)	(172)	(173)
民國105年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>2,286</u>	<u>8,666</u>	<u>10,952</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	商 譽	專利權及 商 標	發展成本	總 計
帳面價值：				
民國105年12月31日	\$ <u>2,585,621</u>	<u>1,705,827</u>	<u>144,625</u>	<u>4,436,073</u>
民國104年1月1日	\$ <u>676,453</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>676,453</u>
民國104年12月31日	\$ <u>701,566</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>701,566</u>

民國一〇五年度及一〇四年度無形資產之攤銷費用列報於合併綜合損益表之營業費用分別為11,125千元及0千元。

為減損測試之目的，商譽直接歸屬半導體事業部。合併公司每年至少一次於報導期間結束日針對合併公司帳上之商譽進行減損評估測試，係以該單位之預估未來現金流量作為可回收金額之計算基礎。

合併公司之商譽經評估並無減損之跡象。

合併公司之無形資產均未有提供作質押擔保之情形。

(九)其他資產－流動及非流動

	105.12.31	104.12.31
遞延所得稅資產	\$ 1,847,184	388,085
應退及留抵稅款	685,038	46,710
預付保險費	122,742	58,916
預付設備款	1,321	51,453
其他	275,386	76,881
	<u>\$ 2,931,671</u>	<u>622,045</u>

(十)短期借款

	105.12.31	104.12.31
無擔保銀行借款	\$ 12,178,614	695,890
擔保銀行借款	312,573	-
	<u>\$ 12,491,187</u>	<u>695,890</u>
未動用融資額度	<u>\$ 5,750,918</u>	<u>6,631,896</u>
期末借款利率區間	<u>0.33%~2.25%</u>	<u>1.53%~1.77%</u>

合併公司以資產設定抵押供銀行借款之擔保情形請詳附註八。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十一)長期借款

合併公司長期借款之明細、條件與條款如下：

105.12.31				
	幣別	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	NTD	1.154%~2.67%	106.11~110.12	\$ 14,857,812
減：一年內到期部份				(490,979)
合 計				\$ 14,366,833

合併公司於民國一〇五年十一月二十九日及十二月二日與兆豐銀行及其四家銀行簽訂聯合借款合同，取得美金400,000千元之融資額度。

依民國一〇五年十一月二十九日及十二月二日簽署之借款合同規定：

- 1.合併公司自動撥日後六個月起，經會計師查核簽證之年度及經核閱之第二季合併財務報表皆應維持特定之流動比率、利息保障倍數及財務槓桿比率。
- 2.借款用途僅限為收購SSL及償還先前SSL之借款。
- 3.合併公司應保持直接或間接持有SSL及其子公司股權達51%以上。
- 4.若上述借款有違約情事，本公司不得支付任何現金股利、不得償還除上述借款外之利息和借款，及以其他方式分配現金予股東或其他借款人。

依上述合約規定合併公司若於合約簽署日後一個月內之實際動撥金額小於總融資約定額度之80%，合併公司需就此差額部份0.1%支付一次性承諾費。截至民國一〇五年十二月三十一日止，合併公司對上述承諾費應支付金額為美金80千元，帳列其他流動負債項下。

上述約定條款之首次檢覈日為款項動撥日起算後六個月，合併公司於民國一〇五年十二月三十一日之合併財務報告雖暫未能符合合約所訂流動比率之限制條件，然未違反借款合同；另，合併公司有關流動比率改善計畫請詳附註十一。

(十二)融資租賃負債

合併公司採融資租賃方式取得部分不動產、廠房及設備，相關應付之融資租賃負債如下，帳列其他流動負債項下及其他非流動負債項下：

	105.12.31			104.12.31		
	未來最低 租金給付	利 息	最低租金 給付現值	未來最低 租金給付	利 息	最低租金 給付現值
一年內	\$ 81,570	(2,925)	78,645	5,021	(33)	4,988
一年至五年	3,682	(47)	3,635	7,818	(214)	7,604
	<u>\$ 85,252</u>	<u>(2,972)</u>	<u>82,280</u>	<u>12,839</u>	<u>(247)</u>	<u>12,592</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十三)負債準備

	廠址復原	虧損性合約	合 計
民國105年1月1日餘額	\$ 29,094	877,310	906,404
企業合併所承擔	38,411	-	38,411
當期新增(迴轉)之負債準備	74,827	(433,507)	(358,680)
匯率影響數	630	40,836	41,466
民國105年12月31日餘額	<u>\$ 142,962</u>	<u>484,639</u>	<u>627,601</u>
流 動	\$ 9,690	408,703	418,393
非流動	133,272	75,936	209,208
合 計	<u>\$ 142,962</u>	<u>484,639</u>	<u>627,601</u>
民國104年1月1日餘額	\$ 27,641	1,201,679	1,229,320
當期新增(迴轉)之負債準備	584	(347,515)	(346,931)
匯率影響數	869	23,146	24,015
民國104年12月31日餘額	<u>\$ 29,094</u>	<u>877,310</u>	<u>906,404</u>
流 動	\$ -	588,585	588,585
非流動	29,094	288,725	317,819
合 計	<u>\$ 29,094</u>	<u>877,310</u>	<u>906,404</u>

1.廠址復原

廠址復原係合併公司依據廠房租賃合約約定，於租期屆滿不續承租時，合併公司負有將該廠房復原之義務，及依據合併公司公佈之環境政策和適用之法規要求，針對環境整治義務提列復原負債準備。

2.虧損性合約

合併公司與多家矽原料供應商簽訂之長期採購合約，於合約約定期間內將合約約定之供貨量及價格交付完畢。並於合約規定期間分期預付購料款予供應商，預付款項不可退還，交易亦不可取消，供應商保證供應約定數量矽原料予合併公司。合併公司業已依購料合約條件估列負債準備，調整認列於營業成本項下。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十四)營業租賃

1.承租人租賃

不可取消之營業租賃的應付租金付款情形如下：

	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
一年內	\$ 337,585	96,259
一年至五年	707,013	368,704
五年以上	<u>111,856</u>	<u>191,247</u>
	<u>\$ 1,156,454</u>	<u>656,210</u>

民國一〇五年度及一〇四年度營業租賃列報於損益之費用分別為167,550千元及114,203千元。

合併公司位於日本小國、秦野及德山等地區廠房之土地、建物及其他設備係向日商Covalent Materials Corporation等公司承租，土地及建物之租賃期間為民國一〇〇年十一月三十日至民國一二四年三月三十一日止，每年租金合計約為30,155千元。

合併公司位於新竹科學工業園區廠房之基地係向科學工業園區管理局承租，原租賃期間自民國八十九年十月一日起至民國一二三年十二月三十一日止。依約租金應按政府規定地價之調整幅度調整，每年租金約為31,355千元。

合併公司向中美矽晶公司承租廠房供生產製造使用，租賃期間自民國一〇五年二月一日起至民國一〇七年一月三十一日止，每年租金為17,548千元。

2.長期預付租金

合併公司以營業租賃承租土地使用權，租賃期間分別為五十及九十九年，租金一次給付。民國一〇五年度及一〇四年度列報於損益之費用分別為263千元及246千元。截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日止，尚未攤銷之餘額分別為44,555千元及9,152千元。

(十五)員工福利

1.確定福利計劃

合併公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
確定福利義務現值	\$ (8,805,750)	(1,113,403)
計畫資產之公允價值	<u>5,314,880</u>	<u>19,388</u>
淨確定福利負債	<u>\$ (3,490,870)</u>	<u>(1,094,015)</u>

上列確定福利計劃均係依據員工服務年資所獲得之基數計算。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(1)確定福利義務現值之變動

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度確定福利義務現值變動如下：

	105年度	104年度
1月1日確定福利義務	\$ 1,113,403	989,433
企業合併承受之負債	7,520,330	-
當期服務成本及利息	146,281	85,491
淨確定福利負債再衡量數		
—因經驗調整所產生之精算損益	3,296	(10,395)
—因人口統計假設變動所產生之精算損益	2,726	3,950
—因財務假設變動所產生之精算損益	1,182	37,847
福利支付	(37,100)	(24,102)
匯率變動之影響	55,632	31,179
12月31日確定福利義務	<u>\$ 8,805,750</u>	<u>1,113,403</u>

(2)計畫資產公允價值之變動

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	105年度	104年度
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 19,388	17,244
企業合併購入之資產	5,088,643	-
利息收入	14,686	292
淨確定福利負債再衡量數		
—計畫資產報酬(不含當期利息)	46,023	211
已提撥至計劃之金額	100,765	1,641
福利支付	(2,044)	-
匯率變動之影響	47,419	-
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 5,314,880</u>	<u>19,388</u>

台灣之確定福利計劃之計畫資產依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局（以下簡稱勞動基金局）統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。合併公司民國一〇五年十二月三十一日之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計191,596千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動部勞動基金運用局網站公布之資訊。

韓國之確定福利計劃之計畫資產係附息之銀行定存，利率為1.74%~2.20%。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

義大利之確定福利計劃之計畫資產係提撥至National Social Security Pension Fund (INPS)。

美國之確定福利計劃之計畫資產之計畫資產係存放於信託基金，該信託基金之資金運用於不同風險及報酬率的商品，投資組合包括：現金、有價證券及收益型基金等。

(3)認列為損益之費用

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度認列費用之明細如下：

	105年度	104年度
當期服務成本	\$ 123,879	77,747
淨確定福利負債之淨利息	7,716	7,452
	\$ 131,595	85,199
營業成本	\$ 103,659	65,245
推銷費用	6,635	3,410
管理費用	13,026	7,730
研究發展費用	8,275	8,814
	\$ 131,595	85,199

(4)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

合併公司截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日累計認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	105年度	104年度
1月1日累積餘額	\$ (135,922)	(108,311)
本期認列	38,819	(31,191)
匯率變動之影響	(418)	3,580
12月31日累積餘額	\$ (97,521)	(135,922)

(5)精算假設

合併公司於財務報導結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	105.12.31	104.12.31
折現率	0.20%~3.75%	0.44%~1.375%
未來薪資增加	0%~4.91%	1.40%~7.00%

合併公司預計於民國一〇五年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之金額為140,599千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為1.07~19.42年。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(6) 敏感度分析

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日當採用之主要精算假設變動0.25%時，對確定福利義務現值之影響如下：

<u>精算假設</u>	<u>對確定福利義務之影響</u>	
	<u>增加0.25%</u>	<u>減少0.25%</u>
105年12月31日		
折現率	\$ <u>(226,832)</u>	<u>234,340</u>
未來薪資增加	\$ <u>82,985</u>	<u>(111,700)</u>
104年12月31日		
折現率	\$ <u>(34,916)</u>	<u>36,593</u>
未來薪資增加	\$ <u>29,253</u>	<u>(27,966)</u>

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨退休金負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

2. 確定提撥計畫

合併公司之國內公司確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資百分之六之提繳率，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司之國內公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。

國外子公司採確定提撥之退休辦法者，依當地法令規定提撥退休金，並將當期應提撥之退休金數額認列當期費用。

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為48,053千元及12,944千元，已提撥至勞工保險局。

合併公司之國外公司民國一〇五年度及一〇四年度所認列之退休金費用分別為28,617千元及18,508千元。

(十六) 所得稅

1. 所得稅費用

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度之所得稅費用明細如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
當期所得稅費用	\$ 509,902	614,983
遞延所得稅費用	(104,634)	148,550
	<u>\$ 405,268</u>	<u>763,533</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度認列於其他綜合損益之下的所得稅明細如下：

	105年度	104年度
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	\$ 6,599	(10,574)
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(39,449)	63,906
備供出售金融資產未實現評價損益	59,796	(59,796)
	<u>\$ 26,946</u>	<u>(6,464)</u>

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度之所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	105年度	104年度
稅前淨利	\$ 1,344,439	2,807,726
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	228,555	477,313
外國轄區稅率差異影響數	99,277	461,722
永久性差異調整	(122,332)	(143,112)
未認列暫時性差異之變動及其他	220,517	(7,949)
未分配盈餘加徵10%稅額	207	-
投資抵減增加數	(20,956)	(24,441)
	<u>\$ 405,268</u>	<u>763,533</u>

2.遞延所得稅資產及負債

(1)合併公司未認列為遞延所得稅資產之項目如下：

	105.12.31	104.12.31
可減除暫時性差異	\$ <u>706,036</u>	<u>266,838</u>

該等項目未認列為遞延所得稅資產，係因合併公司於未來並非很有可能足夠之課稅所得以供該暫時性差異使用。

(2)合併公司未認列為遞延所得稅負債之項目如下：

	105.12.31	104.12.31
與投資子公司相關之暫時性差異彙總金額	\$ <u>(56,003)</u>	<u>(46,179)</u>

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日與投資子公司相關之暫時性差異因合併公司控制該項暫時性差異迴轉之時點，且確認於可預見之未來不會迴轉，故未認列遞延所得稅負債。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(3)已認列之遞延所得稅資產及負債

	104.12.31	收購 子公司	認列於 損益表	認列於 其他綜合 損益表	匯 率 影響數	105.12.31
資產：						
存貨備抵損失	\$ 4,994	126,251	(8,024)	-	1,369	124,590
淨確定福利負債	38,319	227,193	23,491	1,628	2,455	293,086
虧損扣除	-	398,077	84,923	-	4,277	487,277
國外營運機構財 務報表換算之兌 換損失	215,313	-	-	39,449	-	254,762
備供出售金融資 產未實現評價損 失	59,796	-	-	(59,796)	-	-
未實現兌換損失	-	124,142	54,941	-	1,338	180,421
採權益法之投資	-	-	150,514	(9,875)	-	140,639
不動產、廠房及 設備折舊年限差 異	-	101,212	(8,971)	-	1,098	93,339
其他	69,663	205,866	948	-	(3,407)	273,070
	<u>\$ 388,085</u>	<u>1,182,741</u>	<u>297,822</u>	<u>(28,594)</u>	<u>7,130</u>	<u>1,847,184</u>
負債：						
採權益法之投資	\$ (446,866)	-	(80,798)	1,648	-	(526,016)
不動產、廠房及 設備折舊年限差 異	(285,611)	(109,748)	(87,223)	-	5,763	(476,819)
收購價格調整	-	(488,837)	2,663	-	(5,287)	(491,461)
其他	(2,388)	(97,065)	(27,830)	-	(1,050)	(128,333)
	<u>\$ (734,865)</u>	<u>(695,650)</u>	<u>(193,188)</u>	<u>1,648</u>	<u>(574)</u>	<u>(1,622,629)</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	104.1.1	收購 子公司	認列於 損益表	認列於 其他綜合 損益表	匯 率 影響數	104.12.31
資產：						
存貨備抵損失	\$ 4,336	-	658	-	-	4,994
淨確定福利負債	28,902	-	-	8,310	1,107	38,319
虧損扣除	118,097	-	(118,097)	-	-	-
國外營運機構財 務報表換算之兌 換損失	279,219	-	-	(63,906)	-	215,313
備供出售金融資 產未實現評價損 失	-	-	-	59,796	-	59,796
其他	20,769	-	48,295	-	599	69,663
	<u>\$ 451,323</u>	<u>-</u>	<u>(69,144)</u>	<u>4,200</u>	<u>1,706</u>	<u>388,085</u>
負債：						
採權益法之投資	\$ (346,528)	-	(102,602)	2,264	-	(446,866)
不動產、廠房及設 備折舊年限差異	(287,364)	-	11,390	-	(9,637)	(285,611)
其他	(14,194)	-	11,806	-	-	(2,388)
	<u>\$ (648,086)</u>	<u>-</u>	<u>(79,406)</u>	<u>2,264</u>	<u>(9,637)</u>	<u>(734,865)</u>

3.所得稅核定情形

截至民國一〇五年十二月三十一日止，本公司營利事業所得稅分別經主管稽徵機關核定至民國一〇二年度。

4.本公司兩稅合一相關資訊如下：

	105.12.31	104.12.31
未分配盈餘所屬年度：		
八十七年度以後	\$ <u>973,790</u>	<u>2,023,591</u>
可扣抵稅額帳戶餘額	\$ <u>65,032</u>	<u>-</u>
	105年度 (預計)	104年度 (實際)
對中華民國居住者盈餘分配之稅額扣抵比率	<u>12.42%</u>	<u>5.25%</u>

前述兩稅合一相關資訊係依據財政部民國一〇二年十月十七日台財稅第10204562810號函規定處理之金額。依新修正之所得稅法第66條之6，屬於中華民國境內居住之個人股東其可扣抵稅額比率予以減半，並自民國一〇四年一月一日起分派盈餘時開始適用。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十七)資本及其他權益

1.普通股股本

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，本公司額定股本總額皆為4,000,000千元，每股面額10元，皆為400,000千股(皆含保留員工認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債、可認購股份數額200,000千元)。額定股本業已辦妥變更登記。實收股本皆為3,692,500千元。

本公司於民國一〇三年十一月十三日經董事會決議辦理現金增資發行新股317,500千元，每股面額10元，計發行新股31,750千股，以每股65元溢價發行，發行總金額為2,063,750千元，溢價總額為1,746,250千元，帳列資本公積項下。此項增資案業經金融監督管理委員會核准，並以民國一〇四年一月二十九日為增資基準日，所有發行股份之股款均已收取，且相關法定登記程序已辦理完竣。

本公司為配合股票初次上櫃前承銷，於民國一〇四年七月二十三日經董事會決議辦理現金增資發行新股200,000千元，每股面額10元，計發行新股20,000千股，以每股61.5元溢價發行，發行總金額為1,230,000千元，溢價總額為1,030,000千元，帳列資本公積項下。此項增資案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，並以民國一〇四年九月二十四日為增資基準日，所有發行股份之股款均已收取，且相關法定登記程序已辦理完竣。

2.資本公積

本公司資本公積餘額內容如下：

	105.12.31	104.12.31
普通股股票溢價	\$ 11,680,672	11,707,775
母公司給予員工認股權等	60,727	59,546
	<u>\$ 11,741,399</u>	<u>11,767,321</u>

依民國一〇一年一月修正之公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

本公司民國一〇五年六月二十二日及一〇四年六月二十三日分別經股東會決議以資本公積配發現金27,103千元(每股0.0734元)及323,475千元(每股0.9262元)，相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢之。

3.保留盈餘

依本公司之章程規定，年度決算如有盈餘，按下列順序分配之：

(1)彌補虧損。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

- (2)提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- (3)依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- (4)當年度盈餘扣除上列一至三項後，如尚有盈餘併同以前年度未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，提請股東常會決議分派之。

本公司為維持公司永續經營發展及每股盈餘之穩定成長，股東紅利以當年度稅後盈餘扣除當年度依法應提列特別盈餘公積後之百分之五十以上為原則，分配比率為現金股利不低於百分之五十。

(1)法定盈餘公積

依民國一〇一年一月修正之公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

(2)特別盈餘公積

依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額，自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，該項特別盈餘公積餘額皆為239,802千元。

(3)盈餘分配

本公司分別於民國一〇五年六月二十二日及一〇四年六月二十三日經股東會決議民國一〇四年度及一〇三年度盈餘分配案，有關分派之股利、員工紅利及董監酬勞如下：

	<u>104年度</u>	<u>103年度</u>
分派予普通股業主之股利：		
現金(每股股利分別為4.9266元及4.7738元)	\$ <u>1,819,147</u>	<u>1,667,250</u>
董監酬勞		8,000
員工紅利－現金紅利		<u>82,380</u>
		<u>90,380</u>

上述民國一〇四年度及一〇三年度盈餘分配，與本公司董事會擬議內容並無差異，相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢之。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

5.其他權益

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產	合 計
民國105年1月1日	\$ (1,399,873)	(116,075)	(1,515,948)
外幣換算差異(稅後淨額)	(192,604)	-	(192,604)
處分備供出售金融資產重衡量利 益	-	116,075	116,075
民國105年12月31日餘額	<u>\$ (1,592,477)</u>	<u>-</u>	<u>(1,592,477)</u>
民國104年1月1日	\$ (1,711,887)	-	(1,711,887)
外幣換算差異(稅後淨額)	312,014	-	312,014
備供出售金融資產未實現損失	-	(116,075)	(116,075)
民國104年12月31日餘額	<u>\$ (1,399,873)</u>	<u>(116,075)</u>	<u>(1,515,948)</u>

(十八)股份基礎給付

中美矽晶公司於民國九十九年六月經董事會決議，發行九十九年度第一次員工認股權憑證10,000,000單位，且業已於民國九十九年十一月十二日申報生效，並於民國一〇〇年八月十日發行，每單位可認購中美矽晶公司普通股1股，存續期間六年，員工自被授與認股權之日起屆滿二年、三年、四年及五年得分別行使認股權之累積比例為40%、60%、80%及100%。

截至民國一〇五年十二月三十一日止，中美矽晶公司發行之員工認股權憑證因分割而給予本公司員工之情形彙列如下：

種 類	申報生 效日期	給與日	既 得 期 間	給 與 單位數 (千單位)	每股認購 價格(元)	衡 量 日 每股市價 (元)	調 整 後 履約價格 (元)
99年第一次 員工認股權	99.11.12	100.8.10	服務期間 2~4年	3,475	60.50	60.50	50.20

本公司於民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日認列酬勞性員工認股權計畫之酬勞成本分別計1,181千元及3,317千元。上述於民國一〇〇年八月十日給與之員工認股權採用Black-Scholes選擇權評價模式估計給與日之公平價值，各項假設之加權平均資訊列示如下：

股利率	3.6%
預期價格波動性	48.065%
無風險利率	1.2905%
預期存續期間	6年

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

本公司上述酬勞性員工認股選擇權憑證於民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日相關之數量及加權平均行使價格之資訊揭露如下：

員工認股權	105年度		104年度	
	數量 (千股)	調整後加權 平均行使 價格(元)	數量 (千股)	調整後加權 平均行使 價格(元)
期初流通在外	2,881	\$ 52.40	3,006	55.10
本期移轉	70	50.20	(85)	52.40
本期行使	-	-	-	-
本期沒收(失效數)	67	50.20	40	52.40
期末流通在外	<u>2,884</u>	50.20	<u>2,881</u>	52.40
期末可行使之員工認股權	<u>2,884</u>	50.20	<u>2,305</u>	52.40
員工認股權每股平均公平市 價(元)	\$ <u>23.36</u>		<u>23.36</u>	

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日流通在外之員工認股權，其加權平均剩餘存續期間分別為0.66年及1.66年。

(十九)每股盈餘

1.基本每股盈餘

	105年度	104年度
歸屬於本公司普通股權益持有人之淨利	\$ <u>939,485</u>	<u>2,044,193</u>
普通股加權平均流通在外股數(千股)	<u>369,250</u>	<u>352,239</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>2.54</u>	<u>5.80</u>

2.稀釋每股盈餘

	105年度	104年度
歸屬於本公司普通股權益持有人之淨利	\$ <u>939,485</u>	<u>2,044,193</u>
普通股加權平均流通在外股數(千股)	369,250	352,239
得採股票發行之員工酬勞之影響(千股)	556	1,649
	<u>369,806</u>	<u>353,888</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>2.54</u>	<u>5.78</u>

(二十)收入

	105年度	104年度
商品銷售	\$ 18,421,835	15,306,786
勞務提供	5,115	3,676
	<u>\$ 18,426,950</u>	<u>15,310,462</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(廿一)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。董事酬勞以現金方式分派，員工酬勞以股票或現金方式分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

本公司民國一〇五年度及一〇四年度員工酬勞提列金額分別為41,400千元及73,870千元，董事酬勞提列金額分別為3,500千元及5,000千元，係以本公司該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業成本或營業費用，其中員工酬勞以股票發放者，係依據董事會決議前一日之普通股收盤價計算配發股數。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為次年度之損益。

(廿二)其他利益及損失

	105年度	104年度
外幣兌換利益	\$ 76,766	55,596
提前償還借款額外費用	(189,746)	-
處分備供出售金融資產重衡量利益	81,131	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	61,893	-
政府補助款	5,673	35,165
其他	17,320	16,089
	<u>\$ 53,037</u>	<u>106,850</u>

(廿三)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中狀況

合併公司重要之客戶係與矽晶圓產業相關，而且合併公司通常依授信程序給予客戶信用額度，因此合併公司之信用風險主要受矽晶圓產業之影響。截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日止，合併公司應收票據及帳款(含關係人)餘額之48%及68%係由十家客戶組成，雖有信用風險集中之情形，惟合併公司已定期評估應收帳款回收之可能性並提列適當備抵呆帳。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2. 流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息但不包含淨額協議之影響。

	帳面金額	合 約 現金流量	6個月 以內	6-12個月	1-2年	2-5年
105年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 12,491,187	(12,629,928)	(5,166,228)	(7,463,700)	-	-
應付票據及帳款(含 關係人)	5,125,640	(5,125,640)	(5,125,640)	-	-	-
融資租賃負債	82,280	(85,252)	(40,297)	(41,273)	(3,682)	-
長期借款(含一年內 到期長期借款)	14,857,812	(17,122,582)	-	(647,519)	(1,803,759)	(14,671,304)
遠期外匯合約：						
流 出	23,631	(1,568,165)	(1,568,165)	-	-	-
流 入	-	1,528,727	1,528,727	-	-	-
	<u>\$32,580,550</u>	<u>(35,002,840)</u>	<u>(10,371,603)</u>	<u>(8,152,492)</u>	<u>2,091,815</u>	<u>(2,103,573)</u>
104年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 695,890	(707,401)	-	(707,401)	-	-
應付票據及帳款(含 關係人)	1,383,333	(1,383,333)	(1,383,333)	-	-	-
融資租賃負債	12,592	(12,839)	(2,505)	(2,516)	(4,764)	(3,054)
	<u>\$ 2,091,815</u>	<u>(2,103,573)</u>	<u>(1,385,838)</u>	<u>(709,917)</u>	<u>(4,764)</u>	<u>(3,054)</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

合併公司於民國一〇五年十二月三十一日之流動資產雖低於流動負債，然合併公司已採行因應措施，擬辦理現金增資以改善財務結構，相關說明請詳附註十一。

3. 匯率風險

(1) 匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	105.12.31		
	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美 元	\$ 163,857	32.25	5,284,388
日 圓	696,203	0.2756	191,874
人 民 幣	5,842	4.617	26,973
歐 元	13,923	33.90	471,990

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

105.12.31			
	外幣	匯率	台幣
<u>非貨幣性項目</u>			
美 元	6,000	32.25	註
<u>金融負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美 元	7,874	32.25	253,937
日 圓	91,314	0.2756	25,166
<u>非貨幣性項目</u>			
美 元	20,442	32.25	註
日 圓	2,314	0.2756	註
104.12.31			
	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美 元	\$ 55,926	32.825	1,835,771
日 圓	79,460	0.2727	21,669
人 民 幣	23,526	4.995	117,512
<u>金融負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美 元	3,328	32.825	109,242
日 圓	92,578	0.2727	25,246

註：係持有遠期外匯合約以年底之公平價值評價，其相關資訊請詳附註六(二)。

(2) 敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金及約當現金、應收帳款、備供出售金融資產－非流動、借款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日當新台幣相對於美金、日圓及人民幣貶值或升值5%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇五年度及一〇四年度之稅前淨利將分別增加或減少284,806千元及92,023千元；權益將分別增加或減少0千元及26,687千元。兩期分析係採用相同基礎。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇五年度及一〇四年度外幣兌換利益(含已實現及未實現)分別為76,766千元及55,596千元。

4. 利率分析

下列敏感度分析係依利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。

若利率增加或減少0.25%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司民國一〇五年度及一〇四年度之淨利將減少或增加55,280千元及增加或減少4,522千元，主因係合併公司之變動利率銀行存款及借款。

5. 公允價值資訊

(1) 金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債及備供出售金融資產係以重複性為基礎按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

		105.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 2,442	-	2,442	-	2,442
放款及應收款					
現金及約當現金	\$ 5,627,979	-	-	-	-
應收票據及帳款(含關係人)	7,642,237	-	-	-	-
其他金融資產—流動及非流動	916,584	-	-	-	-
	\$ 14,186,800	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債	\$ 23,631	-	23,631	-	23,631
按攤銷後成本衡量之金融負債					
短期借款	\$ 12,491,187	-	-	-	-
應付票據及帳款(含關係人)	5,125,640	-	-	-	-
融資租賃負債—流動及非流動	82,280	-	82,280	-	82,280
長期借款(含一年到期之長期借款)	14,857,812	-	-	-	-
	\$ 32,556,919	-	82,280	-	82,280

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

		104.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
備供出售金融資產－非流動					
上市(櫃)公司股票	\$ 533,741	533,741	-	-	533,741
放款及應收款					
現金及約當現金	\$ 3,661,928	-	-	-	-
應收票據及帳款(含關係人)	4,537,699	-	-	-	-
其他金融資產－流動及非流動	221,559	-	-	-	-
	\$ 8,421,186	-	-	-	-
按攤銷後成本衡量之金融負債					
短期借款	\$ 695,890	-	-	-	-
應付票據及帳款(含關係人)	1,383,333	-	-	-	-
融資租賃負債－流動及非流動	12,592	-	12,592	-	12,592
	\$ 2,091,815	-	12,592	-	12,592

(2)非按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

合併公司估計非按公允價值衡量之工具所使用之方法及假設如下：

按攤銷後成本衡量之金融負債若有成交或造市者之報價資料者，則以最近成交價格及報價資料作為評估公允價值之基礎。若無市場價值可供參考時，則採用評價方法估計。採用評價方法所使用之估計及假設為現金流量之折現值估計公允價值。

(3)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

合併公司持有之金融工具為上市(櫃)公司股票，係具標準條款與條件並於活躍市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

遠期外匯合約通常係依據目前之遠期匯率評價。

民國一〇五年度及一〇四年度並無任何公允價值層級移轉情形。

(廿四)財務風險管理

1.概 要

合併公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

(1)信用風險

(2)流動性風險

(3)市場風險

本附註表達合併公司上述各項風險之暴險資訊、合併公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳合併財務報告各該附註。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2.風險管理架構

董事會全權負責及監督本公司之風險管理架構並訂有風險管理政策與程序。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色，該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

合併公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析合併公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及公司運作之變化。並透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律、且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

合併公司之審計委員會監督管理人員如何監控合併公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核合併公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助合併公司審計委員會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予審計委員會。

3.信用風險

合併公司主要的潛在信用風險係源自於現金及應收帳款等之金融商品。合併公司之現金存放於不同之金融機構。合併公司控制暴露於每一金融機構之信用風險，而且認為合併公司之現金不會有重大之信用風險顯著集中之虞。

截至民國一〇五年十二月三十一日合併公司僅提供背書保證予持有100%股權之子公司。

4.流動性風險

合併公司之資本及營運資金足以支應履行所有合約義務，故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市場價格變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響合併公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

(1)匯率風險

合併公司暴露於非以各該集團企業之功能性貨幣計價之銷售、採購及借款交易所產生之匯率風險。集團企業之功能性貨幣以新台幣為主、亦有人民幣、美元、歐元及日幣等。該等交易主要之計價貨幣有新台幣、美元、歐元及日幣。

借款利息係以借款本金幣別計價。一般而言，借款幣別係與合併公司營運產生之現金流量之幣別相同，主要係新台幣，惟亦有美金及日幣。

有關其他外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，合併公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(2)利率風險

合併公司持有浮動利率之資產與負債，因而產生現金流量利率暴險。

(3)權益工具價格

合併公司因上市櫃權益證券投資而產生權益價格暴險。該權益投資非持有供交易而係屬策略性投資。變動風險請詳附註六(六)。

(廿五)資本管理

董事會之政策係維持健全之資本基礎，以維繫投資人、債權人及市場之信心以及支持未來營運之發展。資本包含合併公司之股本、資本公積、保留盈餘及非控制權益。董事會控管資本報酬率，同時控管普通股股利水準。

報導日之負債資本比率如下：

	105.12.31	104.12.31
負債總額	\$ 44,741,735	7,091,163
減：現金及約當現金	(5,627,979)	(3,661,928)
淨負債	<u>\$ 39,113,756</u>	<u>3,429,235</u>
權益總額	<u>\$ 15,818,502</u>	<u>16,724,597</u>
負債資本比率	<u>247.27 %</u>	<u>20.50 %</u>

民國一〇五年十二月三十一日負債資本比率增加，主要係因應收購子公司及營運週轉，對銀行之長短期借款增加。

合併公司為有效改善財務結構，規劃將辦理現金增資，請詳附註十一說明。

七、關係人交易

中美矽晶公司為合併公司之母公司及所歸屬集團之最終控制者，截止民國一〇五年十二月三十一日持有本公司流通在外普通股股份之60.20%，中美矽晶公司已編製供大眾使用之合併財務報告。

(一)主要管理人員交易

主要管理人員報酬包括：

	105年度	104年度
短期員工福利	\$ 121,314	109,257
退職後福利	432	477
股份基礎給付	344	965
	<u>\$ 122,090</u>	<u>110,699</u>

合併公司於民國一〇五年度及一〇四年度皆提供成本計1,500千元之汽車1輛，供主要管理人員使用。

有關股份基礎給付之說明請詳附註六(十八)。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(二)其他關係人交易

1.營業收入

合併公司對關係人之重大銷售金額如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
母公司	\$ 17,515	19,887
其他關係人	<u>245,560</u>	<u>282,361</u>
	<u>\$ 263,075</u>	<u>302,248</u>

合併公司銷貨予關係人之價格係以一般市場價格為基準，考量銷售區域、銷售數量不同等因素而酌予調整。

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度售予一般客戶約定收款期間均為月結0~210天；對主要關係人約定收款期間分別為月結30天~次月結60天及月結60天~次月結60天。

2.進貨及委託加工

合併公司向關係人進貨及委託加工金額如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
母公司	\$ <u>391,033</u>	<u>187,551</u>

合併公司向關係人採購之貨物及委託加工係以一般市場價格為基準。

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度與一般廠商付款條件分別為月結0天~次月結120天及月結0天~月結150天；向關係人進貨付款條件分別為月結15~60天及月結60天。

3.應收關係人款項

合併公司應收關係人款項明細如下：

<u>帳列項目</u>	<u>關係人類別</u>	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
應收關係人款項	母公司	\$ 1,742	2,130
應收關係人款項	其他關係人	<u>74,306</u>	<u>76,310</u>
		<u>\$ 76,048</u>	<u>78,440</u>

4.應付關係人款項

合併公司應付關係人款項明細如下：

<u>帳列項目</u>	<u>關係人類別</u>	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
應付關係人款項	母公司	\$ <u>220,905</u>	<u>43,068</u>

5.管理費用

合併公司每月支付中美矽晶公司管理費用，民國一〇五年度及一〇四年度之管理費用分別為21,235千元及15,584千元，帳列管理費用項下；截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，尚未結清款項分別為5,356千元及2,014千元，帳列應付關係人款項。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

6.技術服務費用

合併公司支付關係人技術服務費用，帳列研發費用如下：

	105年度	104年度
母公司	\$ <u>7,099</u>	<u>10,848</u>

截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，尚未支付之應付技術服務費分別為2,226千元及2,835千元。

7.資金貸與

合併公司資金貸予關係人其實際動支情形如下：

關係人	104年度				
	最高餘額	實際動支 餘 額	期末餘額	利率區間	利息收入
母公司	\$ <u>1,200,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	1.8%	<u>-</u>

8.背書保證

合併公司民國一〇五年度及一〇四年度間為取得銀行融資而由關係人提供合併公司背書保證最高額度彙列如下：

	105年度	104年度
母公司	\$ <u>165,181</u>	<u>143,948</u>

截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日背書保證餘額彙列如下：

	105.12.31	104.12.31
母公司	\$ <u>-</u>	<u>143,318</u>

9.各項墊款

截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，合併公司因關係人間相互墊付購料款、保險、水電費及人力支援等款項而尚未結清之應收(付)關係人款項，列於應收關係人款項及應付關係人款項並彙列如下：

	105.12.31	104.12.31
母公司	\$ 320	430
母公司	(1,421)	(334)
其他關係人	396	28
其他關係人	(38)	-
	\$ <u>(743)</u>	<u>124</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

10.財產交易

(1)取得不動產、廠房及設備

合併公司向關係人取得不動產、廠房及設備之價款彙總如下：

	105年度	104年度
母公司	\$ -	3,697
其他關係人	768	-
	<u>\$ 768</u>	<u>3,697</u>

截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日止，上述交易款項業已全數支付。

11.其他

(1)合併公司直接銷售予關係人，因視為存貨移轉，故銷貨收入及相關成本業於財務報表表達時予以沖銷，不視為合併公司之收入及成本。民國一〇五年度及一〇四年度上述銷售交易金額如下：

	105年度	104年度
母公司	<u>\$ -</u>	<u>8,301</u>

(2)合併公司與母公司訂有廠房租賃合約，付款條件為次月結15天後付款，相關租賃計付之租金支出及應付關係人款項明細如下：

		105年度	104年度
母公司		<u>\$ 15,090</u>	<u>2,400</u>
帳列項目	關係人類別	105.12.31	104.12.31
應付關係人款項	母公司	<u>\$ 3,113</u>	<u>420</u>

合併公司出租廠房予母公司，收款條件為次月結45天後收款，相關租賃之租金收入及應收關係人款項明細如下：

		105年度	104年度
母公司		<u>\$ 816</u>	<u>816</u>
帳列項目	關係人類別	105.12.31	104.12.31
應收關係人款項	母公司	<u>\$ 71</u>	<u>71</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

八、抵質押之資產

合併公司提供抵質押擔保之資產帳面價值明細如下：

<u>資產名稱</u>	<u>抵質押擔保標的</u>	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
應收票據及帳款淨額	短期借款	\$ 174,773	-
銀行存款(列於其他金融資產－流動)	承兌匯票保證金	17,779	18,793
不動產、廠房及設備	短期借款	2,923,956	3,039,827
銀行存款(列於其他金融資產－流動)	短期借款	264,622	-
銀行存款(列於其他金融資產－流動)	中油用氣量之擔保	6,700	-
銀行存款(列於其他金融資產－非流動)	提供銀行開立新竹科學工業園區管理局租約之擔保	35,668	5,018
銀行存款(列於其他金融資產－非流動)	銀行借款備償戶保證金	78,600	-
存出保證金(列於其他金融資產－非流動)	購料保證金	<u>165,563</u>	<u>163,821</u>
		<u>\$ 3,667,661</u>	<u>3,227,459</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

除附註六(十四)所述外，合併公司其他重大或有負債及未認列之合約承諾如下：

(一)重大未認列之合約承諾：

1.合併公司依據現行有效合約尚未進貨之金額分別如下：

	(外幣單位：千元)	
	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
美金	<u>\$ 88,967</u>	<u>121,169</u>
歐元	<u>\$ 40,087</u>	<u>28,954</u>
日圓	<u>\$ 8,215,699</u>	<u>9,406,301</u>
新台幣	<u>\$ 60,385</u>	<u>-</u>
韓元	<u>\$ 2,064,737</u>	<u>-</u>
馬來幣	<u>\$ 4,663</u>	<u>-</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2. 合併公司已開立而未使用之信用狀：

(外幣單位：千元)

	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
新台幣	\$ <u>91,914</u>	<u>-</u>
美金	\$ <u>8,005</u>	<u>-</u>
歐元	\$ <u>6,202</u>	<u>-</u>
日圓	\$ <u>3,800</u>	<u>-</u>
馬來幣	\$ <u>4,975</u>	<u>-</u>

3. 截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日止，已簽約或訂購尚未交驗之重大建造工程款及廠房設備為11,456千元及91,156千元。

4. 合併公司與某些客戶訂有長期銷售合約，客戶依約需履行最低訂貨數量。

(二)或有負債：無。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項

合併公司為改善財務結構及因應資本支出需求，於民國一〇六年三月二十一日經董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計至少發行59,200仟股，最多不超過74,000仟股。

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	105年度			104年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	2,240,995	653,482	2,894,477	1,745,974	452,712	2,198,686
勞健保費用	452,107	133,398	585,505	297,665	58,338	356,003
退休金費用	166,269	41,996	208,265	89,324	27,327	116,651
其他員工福利費用	292,677	77,444	370,121	327,743	98,836	426,579
折舊費用	1,411,930	167,902	1,579,832	1,151,900	88,864	1,240,764
攤銷費用	711	13,240	13,951	9,234	4,447	13,681

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊：

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日合併公司依證券發行人財務報告編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：請詳附表一。
- 2.為他人背書保證：請詳附表二。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：無。
- 4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表三。
- 5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表四。
- 6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- 7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：請詳附表五。
- 8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表六。
- 9.從事衍生性商品交易：請詳附註六(二)。
- 10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形：請詳附表七。

(二)轉投資事業相關資訊：請詳附表八。

(三)大陸投資資訊：

- 1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：請詳附表九(一)。
- 2.轉投資大陸地區限額：請詳附表九(二)。
- 3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一〇五年一月一日至十二月三十一日與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項(於編製合併報告時業已沖銷)，請詳「重大交易事項相關資訊」以及「母子公司間業務關係及重要交易往來情形」之說明。

十四、部門資訊

(一)一般資訊及部門資訊

合併公司主要營運項目為半導體產品之研究、開發、設計、製造及銷售，為單一營運部門。營運部門資訊與合併財務報告一致，收入(來自外部客戶收入)及部門損益請詳合併綜合損益表；部門資產請詳合併資產負債表。

環球晶圓股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(二)產品別及勞務別資訊

合併公司來自外部客戶收入資訊如下：

	105年度	104年度
半導體晶錠產品	\$ 167,912	1,177,490
半導體晶片產品	17,850,126	13,614,573
其他	408,912	518,399
	<u>\$ 18,426,950</u>	<u>15,310,462</u>

(三)地區別資訊

合併公司地區別資訊如下，其中收入係依據客戶所在地理位置歸類，而非流動資產則依據資產所在地理位置歸類。

1.來自外部客戶收入：

地區	105年度	104年度
台灣	\$ 4,233,637	3,562,834
日本	5,794,323	5,766,590
美國	2,474,094	2,044,748
中國	1,788,033	1,223,183
韓國	674,000	119,998
其他國家	3,462,863	2,593,109
	<u>\$ 18,426,950</u>	<u>15,310,462</u>

2.非流動資產：

地區	105.12.31	104.12.31
美國	\$ 26,349,705	3,647,086
日本	5,726,798	5,891,008
台灣	2,154,882	610,010
丹麥	1,405,867	-
中國	411,921	553,526
	<u>\$ 36,049,173</u>	<u>10,701,630</u>

(四)重要客戶資訊

合併公司佔營業收入淨額10%以上之重要客戶資訊如下：

	105年度	104年度
H公司集團	<u>\$ 1,962,297</u>	<u>2,771,154</u>

環球晶圓股份有限公司及其子公司

資金貸與他人

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表一

單位：千元

編號	貸出 資金 之公司	貸 與 對 象	往來科目	是否 為關 係人	本期最高 餘額	期末餘額	本期實際 動支餘額	利率 區間	資金貸 與性質 (註1)	業務往來 金額	有短期融 通資金必 要之原因	提列備 抵呆帳 金額	擔保品		對個別對象 資金貸與限 額(註2、4)	資金貸與 總限額 (註3、4)
													名稱	價值		
0	本公司	Topsil	應收關係 人融資款	是	500,000	200,000	96,682 (USD2,998)	2%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,577,470	1,577,470
0	本公司	GWafers Singapore	應收關係 人融資款	是	1,593,500 (USD50,000)	-	-	2.5%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,577,470	1,577,470
0	本公司	SSBV	應收關係 人融資款	是	1,593,500 (USD50,000)	1,451,250 (USD45,000)	566,091 (USD17,553)	2.5%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,577,470	1,577,470
1	GWJ	本公司	應收關係 人融資款	是	1,504,000 (JPY5,000,000)	1,378,000 (JPY5,000,000)	1,378,000 (JPY5,000,000)	0.44%	1	5,110,592	業務往來	-	-	-	5,110,592	4,171,518
2	SSBV	MEMC Korea	應收關係 人融資款	是	1,290,000 (USD40,000)	1,290,000 (USD40,000)	1,212,846 (USD37,608)	7%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,290,000	1,290,000
2	SSBV	MEMC SpA	應收關係 人融資款	是	248,516 (EUR7,331)	248,516 (EUR7,331)	248,516 (EUR7,331)	-	2	-	營業週轉	-	-	-	248,516	248,516
2	SSBV	SSL	應收關係 人融資款	是	3,708,750 (USD115,000)	1,967,090 (USD60,995)	1,967,090 (USD60,995)	7%	2	-	營業週轉	-	-	-	3,708,750	3,708,750
3	MEMC SpA	SSL	應收關係 人融資款	是	2,644,200 (EUR78,000)	2,644,200 (EUR78,000)	2,410,191 (EUR71,907)	3.49%	2	-	營業週轉	-	-	-	2,644,200	2,644,200

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高餘額	期末餘額	本期實際動支餘額	利率區間	資金貸與性質(註1)	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品名稱	擔保價值	對個別對象資金貸與限額(註2、4)	資金貸與總限額(註3、4)
4	Taisil	MEMC Ipoh	應收關係人融資款	是	1,612,500 (USD50,000)	1,612,500 (USD50,000)	403,125 (USD12,500)	3%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,612,500	1,612,500
4	Taisil	SSL	應收關係人融資款	是	12,900,000 (USD400,000)	12,900,000 (USD400,000)	12,508,978 (USD387,875)	2%	2	-	營業週轉	-	-	-	12,900,000	12,900,000

註1：資金貸與性質之填寫方法如下：

(1)有業務往來者請填1。

(2)有短期融通資金之必要者請填2。

註2：資金貸與有業務往來公司者，個別貸與金額以不超過雙方最近一年度業務往來金額為限；資金貸與有短期融通資金必要之公司，個別貸與金額以不超過貸出資金之百分之十為限；本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之二十為限。另，本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂後資金貸與有業務往來公司者，個別貸與金額以不超過雙方最近一年度業務往來金額為限；資金貸與有短期融通資金必要之公司，個別貸與金額以不超過貸出資金之百分之四十為限；本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限。

註3：資金貸與有業務往來公司者，貸與總金額以不超過貸出資金公司淨值的百分之四十為限；資金貸與有短期融通資金必要之公司，該貸與總金額以不超過貸出資金公司淨值的百分之十為限；本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限。另，本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂後資金貸與有業務往來公司者，貸與總金額以不超過貸出資金公司淨值的百分之四十為限；資金貸與有短期融通資金必要之公司，該貸與總金額以不超過貸出資金公司淨值的百分之四十為限；本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，貸與總金額以不超過本公司淨值之二倍為限。

註4：本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，資金貸與若非屬進銷貨之其他業務往來關係者，雙方須簽有合約且資金貸與額度最高不得逾該合約的總金額。

註5：合併公司因集團內公司之短期資金需求，GTI於民國一〇六年三月八日資金貸與SunEdison LLC 709,550千元。

註6：上述與合併個體有關之交易於編製合併財務報告時業已沖銷。

環球晶圓股份有限公司及其子公司

為他人背書保證

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表二

單位：千元

背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證 限額(註2、3)	本期最高 背書保證 餘額	期末背書 保證餘額	實際動支 金額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書 保證金額 佔最近期 財務報表 淨值之比率	背書保證 最高限額 (註1)	屬母公 司對子 公司背 書保證	屬子公 司對母 公司背 書保證	屬對 大陸地 區背書 保證
	公司名稱	關係										
0	本公司	GWJ 本公司間接持 有之子公司	6,309,882	314,300 (JPY 1,000,000)	275,600 (JPY 1,000,000)	-	-	1.75%	7,887,352	Y	N	N
0	本公司	SSBV 本公司間接持 有之子公司	(註3)	6,450,000 (USD 200,000)	6,450,000 (USD 200,000)	6,450,000 (USD 200,000)	-	40.89%	7,887,352	Y	N	N

註1：提供背書保證者公司之累積對外背書保證之總額，以不超過提供背書保證者公司之最近期財務報表淨值的百分之五十為限。另，本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「背書保證辦法」，修訂後本公司之累積對外背書保證之總額，以不超過提供本公司之最近期財務報表淨值的三倍為限。

註2：提供背書保證者公司之對單一企業背書保證之額度，以不超過最近期財務報表提供背書保證者公司之淨值的百分之十為限。惟對子公司則以本公司淨值的百分之四十為限。另，本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「背書保證辦法」，修訂後本公司對單一企業背書保證之額度，以不超過最近期財務報表本公司淨值的百分之十為限。惟對子公司則以本公司淨值的一倍為限。

註3：惟對下列企業背書保證不受上述二款規定限制：

- (1) 提供背書保證者公司所直接或間接持有表決權股份百分之百之公司；及
- (2) 直接或間接持有提供背書保證者公司之表決權股份百分之五十之母公司及該母公司所直接或間接持有表決權股份百分之五十之公司。

環球晶圓股份有限公司及其子公司

累積買進或賣出同一有價證券金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表三

單位：千元／千股；千單位

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		買 入		賣 出			期 末		
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分損益	股數	金額
本公司	Topsil股票	採權益法之長期股權投資	Topsil Semiconductor Material A/S	無	-	-	1,000	1,964,069	-	-	-	-	1,000	1,964,069
GWafers Singapore	SSL股票	採權益法之長期股權投資	原股東	無	-	-	40,318	16,660,490	-	-	-	-	40,318	16,660,490
GWafers Singapore	SSL股票	採權益法之長期股權投資	GTI	關聯企業	-	-	2,074	790,743	-	-	-	-	2,074	790,743
GTI	海外公司股票	備供出售金融資產－非流動	GWafers Singapore	關聯企業	2,074	533,741	-	-	2,074	790,743	533,741	257,002	-	-

註：上述與合併個體有關之交易於編製合併財務報告時業已沖銷。

環球晶圓股份有限公司及其子公司

取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表四

單位：千元

取得不動產之公司	財產名稱	事實發生日	交易金額	價款支付情形	交易對象	關係	交易對象為關係人者，其前次移轉資料				價格決定之參考依據	取得目的及使用情形	其他約定事項
							所有人	與發行人之關係	移轉日期	金額			
本公司	不動產及廠房	105 年 7 月	469,860	-	Topsil	無	-	-	-	-	依公允價值入帳	供營運使用	無
GWafers Singapore	不動產及廠房	105 年 12 月	6,832,393	-	SSL	無	-	-	-	-	依公允價值入帳	供營運使用	無

註：上述係因企業合併取得Topsil及SSL及其子公司之不動產及廠房，請詳附註六(五)及(七)。

環球晶圓股份有限公司及其子公司

與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表五

單位：千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交 易 情 形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	中美矽晶	本公司之母公司	進貨	385,830	4%	月結60天	-	-	(220,905)	(12)%	
本公司	GTI	本公司間接持有之子公司	進貨	1,003,410	10%	月結60天	-	-	(118,321)	(6)%	
本公司	昆山中辰	本公司間接持有之子公司	進貨	1,770,573	18%	月結60天	-	-	(318,956)	(17)%	
本公司	GWJ	本公司間接持有之子公司	進貨	5,110,592	53%	月結60天	-	-	(1,092,536)	(57)%	
GTI	本公司	本公司間接持有之子公司	進貨	2,384,335	35%	月結60天	-	-	(588,067)	(29)%	
昆山中辰	本公司	本公司間接持有之子公司	進貨	947,160	14%	月結60天	-	-	(51,297)	(2)%	
GWJ	本公司	本公司間接持有之子公司	進貨	1,186,025	18%	月結60天	-	-	(211,762)	(10)%	
朋程科技	本公司	母公司中美矽晶與該公司董事長為同一人	進貨	245,560	4%	月結60天	-	-	(74,253)	(4)%	

註：上述與合併個體有關之交易於編製合併財務報告時業已沖銷。

環球晶圓股份有限公司及其子公司
應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上
民國一〇五年十二月三十一日

附表六

單位：千元

帳列應收款 項之公司	交易對象 名稱	關 係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額 (註1)	提列備抵 呆帳金額
					金額	處理方式		
本公司	GTI	本公司間接持有之子公司	588,067	3.4	-	-	402,017	-
本公司	GWJ	本公司間接持有之子公司	211,762	5.6	-	-	182,332	-
本公司	SSBV	本公司間接持有之子公司	566,091	註3	-	-	-	-
GTI	本公司	本公司間接持有之子公司	118,321	14.8	-	-	97,800	-
昆山中辰	本公司	本公司間接持有之子公司	318,956	6.0	-	-	249,308	-
GWJ	本公司	本公司間接持有之子公司	1,092,536	4.8	-	-	788,887	-
GWJ	本公司	本公司間接持有之子公司	1,378,000	註3	-	-	-	-
SSL	本公司	本公司間接持有之子公司	1,631,850	註2	-	-	1,631,850	-
SSL	MEMC Japan	均為本公司間接持有之子公司	493,529	4.1	-	-	119,257	-
SSL	MEMC Korea	均為本公司間接持有之子公司	421,907	3.0	-	-	-	-
SSL	Taisil	均為本公司間接持有之子公司	765,651	3.0	-	-	-	-
SSL	SunEdison LLC	均為本公司間接持有之子公司	4,890,844	1.7	-	-	33,638	-
SSL	MEMC SpA	均為本公司間接持有之子公司	464,139	9.3	-	-	-	-
MEMC SpA	SSL	均為本公司間接持有之子公司	286,322	10.0	-	-	-	-
MEMC SpA	SSL	均為本公司間接持有之子公司	2,410,191	註3	-	-	-	-
SSBV	MEMC Korea	均為本公司間接持有之子公司	1,212,846	註3	-	-	-	-

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額 (註1)	提列備抵 呆帳金額
					金額	處理方式		
SSBV	MEMC SpA	均為本公司間接持有之子公司	248,516	註3	-	-	-	-
SSBV	SSL	均為本公司間接持有之子公司	1,967,090	註3	-	-	-	-
SunEdison LLC	MEMC Japan	均為本公司間接持有之子公司	348,750	1.0	-	-	-	-
SunEdison LLC	MEMC Korea	均為本公司間接持有之子公司	261,694	1.6	-	-	-	-
SunEdison LLC	MEMC SpA	均為本公司間接持有之子公司	171,410	1.8	-	-	-	-
SunEdison LLC	SSL	均為本公司間接持有之子公司	589,145	0.6	-	-	-	-
MEMC Korea	SunEdison LLC	均為本公司間接持有之子公司	338,830	0.2	-	-	-	-
MEMC Korea	SSL	均為本公司間接持有之子公司	1,214,926	2.0	-	-	-	-
MEMC Japan	SSL	均為本公司間接持有之子公司	464,102	3.5	-	-	464,102	-
MEMC Sdn Bhd	SSL	均為本公司間接持有之子公司	240,593	7.6	-	-	240,593	-
MEMC Ipoh	SSL	均為本公司間接持有之子公司	727,192	2.8	-	-	94,532	-
Taisil	SunEdison LLC	均為本公司間接持有之子公司	123,906	0.3	-	-	75,228	-
Taisil	MEMC Ipoh	均為本公司間接持有之子公司	403,125	註3	-	-	-	-
Taisil	SSL	均為本公司間接持有之子公司	12,508,978	註3	-	-	-	-
Taisil	SSL	均為本公司間接持有之子公司	1,536,057	1.1	-	-	354,155	-

註1：截至民國一〇五年三月六日止收回金額。

註2：係出售無形資產產生之應收關係人款。

註3：係資金融通產生之應收關係人款。

註4：上述與合併個體有關之交易於編製合併財務報告時業已沖銷。

環球晶圓股份有限公司及其子公司
母子公司間業已銷除之重大交易事項
民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表七

單位：千元

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形		
				科目	金額	交易條件
1	本公司	GTI	母公司對間接持有之子公司	進貨	1,003,410	月結60天
1	本公司	昆山中辰	母公司對間接持有之子公司	進貨	1,770,573	月結60天
1	本公司	GWJ	母公司對間接持有之子公司	進貨	5,110,592	月結60天
1	本公司	GWJ	母公司對間接持有之子公司	應付帳款	1,092,536	月結60天
1	本公司	GTI	母公司對間接持有之子公司	銷貨	2,384,335	月結60天
1	本公司	昆山中辰	母公司對間接持有之子公司	銷貨	947,160	月結60天
1	本公司	GWJ	母公司對間接持有之子公司	銷貨	1,186,025	月結60天
1	本公司	SSL	母公司對間接持有之子公司	應付關係人款	1,631,850	月結30天
2	SSL	Taisil	均為間接持有之子公司	應收關係人款	765,651	出貨後60天
2	SSL	SunEdison LLC	均為間接持有之子公司	應收關係人款	4,890,844	出貨後60天
3	GWJ	本公司	間接持有之子公司對母公司	應收關係人融資金	1,378,000	-
4	SSBV	MEMC Korea	均為間接持有之子公司	應收關係人融資金	1,212,846	-
4	SSBV	SSL	均為間接持有之子公司	應收關係人融資金	1,967,090	-
5	MEMC SpA	SSL	均為間接持有之子公司	應收關係人融資金	2,410,191	-
6	MEMC Korea	SSL	均為間接持有之子公司	應收關係人款	1,214,926	出貨後30天
						佔合併總資產收或總資產之比率
						5%
						10%
						28%
						2%
						13%
						5%
						6%
						3%
						1%
						8%
						2%
						2%
						3%
						4%
						2%

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總資產或總資產之比率
7	Taisil	SSL	均為間接持有之子公司	應收關係人融資款	12,508,978	-	20%
7	Taisil	SSL	均為間接持有之子公司	應收關係人款	1,536,057	出貨後30天	3%
8	MEMC Ipoh	SSL	均為間接持有之子公司	應收關係人款	727,192	出貨後30天	1%

註：其他交易均未達合併總營收或總資產比率之1%，不予揭露。

環球晶圓股份有限公司及其子公司
轉投資事業相關資訊(不包含大陸被投資公司)

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表八

單位：千元／千股

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比例	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	GW1	Cayman	投資各項事業	2,241,668 (USD73,423)	2,241,668 (USD73,423)	90,000	100.00%	3,539,870	100.00%	57,788	57,788	子公司
本公司	GSI	Cayman	投資各項事業及與大陸子公司之三角貿易中心	756,809 (USD26,555)	756,809 (USD26,555)	25,000	100.00%	941,279	100.00%	67,882	67,882	子公司
本公司	GWafers	日本	投資各項事業	5,448,015 (JPY13,827,513)	5,448,015 (JPY13,827,513)	(註1)	100.00%	9,460,291	100.00%	918,344	918,344	子公司
本公司	GWafers Singapore	新加坡	投資各項事業	17,504,000 (USD550,000)	-	550,000	100.00%	16,779,342	100.00%	(744,986)	(744,986)	子公司
本公司	Topsil A/S	丹麥	半導體矽晶圓製造及貿易	註3	-	1,000	100.00%	1,735,192	100.00%	(146,057)	(144,673)	子公司
GW1	GTI	Texas	磊晶矽晶圓生產及磊晶代工等貿易	2,241,668 (USD73,423)	2,241,668 (USD73,423)	1	100.00%	3,539,870	100.00%	73,937	57,788	註2 孫公司
GWafers	GWJ	日本	半導體矽晶圓製造及貿易	5,484,300 (JPY13,142,798)	5,484,300 (JPY13,142,798)	128	100.00%	9,452,298	100.00%	475,716	918,779	註2 孫公司
Topsil A/S	Topsil PL	波蘭	半導體矽晶圓製造及貿易	註3	-	1	100.00%	(46,388)	100.00%	(56,594)	(56,594)	註2 孫公司
GWafers Singapore	SSL	新加坡	投資、行銷及貿易業務	17,451,233	-	42,392	100.00%	16,681,956	100.00%	(739,168)	(744,832)	孫公司
SSL	SSBV	荷蘭	投資各項事業	註4	-	0.1	100.00%	30,288,122	100.00%	(217,823)	(217,823)	註2 孫公司
SSL	SST	新加坡	投資各項事業	註4	-	0.001	100.00%	-	100.00%	-	-	孫公司
SSBV	MEMC Japan	日本	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	-	100.00%	220,989	100.00%	649	649	孫公司

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比例	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
SSBV	MEMC SpA	義大利	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	65,000	100.00%	7,307,106	100.00%	(176,688)	(176,688)	孫公司
MEMC SpA	MEMC SarL	法國	貿易業務	註4	-	0.5	100.00%	1,691	100.00%	(2,497)	(2,497)	孫公司
MEMC SpA	MEMC GmbH	德國	貿易業務	註4	-	0.002	100.00%	4,510	100.00%	(73)	(73)	孫公司
MEMC SpA	MEMC BV	荷蘭	投資各項事業	註4	-	0.2	100.00%	1,288,506	100.00%	(90,269)	(90,269)	孫公司
MEMC BV	MEMC Korea	韓國	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	6,880	40.00%	1,290,678	40.00%	(215,265)	(86,106)	孫公司
SSBV	MEMC Korea	韓國	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	10,320	60.00%	2,076,582	60.00%	(215,265)	(129,159)	孫公司
SSBV	SunEdison LLC	美國	半導體矽晶圓研發、製造及銷售	註4	-	1	100.00%	3,371,238	100.00%	(785,309)	(785,309)	孫公司
SSBV	MEMC Sdn Bhd	馬來西亞	半導體矽晶圓研發、製造及銷售	註4	-	1,036	100.00%	1,131,880	100.00%	(23,868)	(23,868)	孫公司
SSBV	SSH BV	荷蘭	投資各項事業	註4	-	0.1	100.00%	8,081,774	100.00%	-	-	孫公司
SSBV	Taisil	台灣	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	252,770	54.95%	11,142,092	54.95%	38,019	20,892	孫公司
SSH BV	Taisil	台灣	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	207,046	45.01%	9,116,257	45.01%	38,019	17,113	孫公司
SSH BV	MEMC Ipoh	馬來西亞	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	699,374	100.00%	(1,034,480)	100.00%	8,750	8,750	孫公司

註1：為有限公司。

註2：投資損益認列包含投資成本與取得股權淨值攤銷數。

註3：合併公司本期收購Topsil A/S及Topsil PL，投資金額總計1,964,069千元(DKK407,600千元)。

註4：合併公司本期收購SSL及其子公司，投資金額總計17,451,233千元(USD546,975千元)。

註5：上述與合併個體有關之交易於編製合併財務報告時業已沖銷。

環球晶圓股份有限公司及其子公司
對大陸之投資概況及轉投資大陸地區限額
民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表九

(一)轉投資大陸地區之事業相關資訊

單位：千元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期末初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	環球晶圓公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益(註4)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
昆山中辰	矽晶棒矽晶圓等加工貿易	769,177 (註6)	(註1)	713,300 (USD21,729)	-	-	713,300 (USD21,729)	58,924	100%	100%	58,924	906,997	-
SunEdison Shanghai	貿易業務	7,527 (RMB1,500)	(註2)	(註2)	-	-	(註2)	220	100%	100%	220	13,199	-
上海葛羅禾	銷售及行銷業務	9,756 (RMB2,000)	(註3)	-	-	-	-	(821)	60%	60%	(492)	5,072	-

(二)轉投資大陸地區限額

公司別	本期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
本公司	713,300 (USD21,729)	818,233 (USD25,000)(註5)	9,491,101(註6)

註1：透過GSI再投資大陸公司。

註2：透過SSBV再投資大陸公司，係本期收購SSL所取得。

註3：上海葛羅禾係透過昆山中辰之自有資金投資設立，無自台灣匯出款，故不列入投資限額計算。

註4：係依經會計師查核之財務報表認列投資損益。

註5：按歷史匯率換算。

註6：依據投審會民國九十七年八月二十九日「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定之限額60%乘民國一〇五年十二月三十一日本公司淨值計算。

註7：係包含盈餘轉增資。



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

環球晶圓股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

環球晶圓股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達環球晶圓股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與環球晶圓股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對環球晶圓股份有限公司民國一〇五年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入認列。相關之說明，請詳個體財務報告附註六(十七)收入。

關鍵查核事項之說明：

環球晶圓股份有限公司營業收入來源為半導體矽晶材料及其元件之銷售，營業收入認列時點係依與客戶約定的交易條件決定，考量營業收入的交易量大，且來自於全球化之營運據點，因此，本會計師將收入認列列為執行環球晶圓股份有限公司個體財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解環球晶圓股份有限公司所採用的收入認列會計政策，並與銷售條款及收入認列條件比較以評估所採用政策的適當性；瞭解銷貨收入之內部控制制度設計，並抽樣測試其執行的有效性；抽樣測試個別收入交易，核對至客戶訂單、出貨證明及收款文件；抽樣選取年度結束日前後期間銷售交易作為樣本，檢視該等銷貨交易的銷售條件、出貨文件及客戶確認文件等，評估年末銷貨交易是否認列於適當的期間。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之假設及估計不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)。相關之說明，請詳個體財務報告附註六(四)存貨。

關鍵查核事項之說明：

環球晶圓股份有限公司主要係從事半導體矽晶材料之製造及銷售業務，相關產品應用面雖廣，然仍存有技術改變、庫存過時或呆滯的風險，考量存貨為環球晶圓股份有限公司的重要資產而需持續關注，因此，本會計師將存貨評價列為執行環球晶圓股份有限公司個體財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解環球晶圓股份有限公司存貨評價的提列政策，並評估其存貨評價是否已按既訂之會計政策執行；執行抽樣程序測試存貨庫齡報表的正確性，並分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣選取個別存貨項目為樣本，檢視各該存貨項目評價時所採用淨變現價值的來源及其合理性。

三、企業合併

有關企業合併之會計政策請詳個體財務報告附註四(十七)企業合併；企業合併之假設及估計不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)。相關之說明，請詳個體財務報告附註六(五)企業合併。

關鍵查核事項之說明：

環球晶圓股份有限公司為擴大全球銷售網絡及提昇產品研發能力，於民國一〇五年度收購Topsil Semiconductor Materials A/S旗下之半導體事業群及SunEdison Semiconductor Limited全數股權，取得對該等公司之控制力；上述收購的交易價格係為購買該等營運個體之營業資產、技術及商譽等項目，考量收購交易所涉及的會計處理係屬複雜，因此，本會計師將其列為環球晶圓股份有限公司個體財務報告查核重要之評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：檢視股權收購合約，了解其交易對象、價款及相關約定，以辨認是否有影響此項交易之會計處理的特殊條款或應於個體財務報告額外揭露的事項；檢視環球晶圓股份有限公司將收購價格分攤於所取得之可辨認資產與負債的計算，並瞭解其所採用之公允價值的來源及合理性；檢視期後重大交易事項，辨認報導日後是否存有重大調整收購價格的情形；評估上述收購交易於個體財務報告之揭露是否適當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估環球晶圓股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算環球晶圓股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

環球晶圓股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對環球晶圓股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使環球晶圓股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致環球晶圓股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對環球晶圓股份有限公司民國一〇五年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾 漢 鈺

曾漢鈺



會 計 師：

黃 泳 華

黃泳華



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民 國 一〇六 年 三 月 二十 一 日

環球晶圓股份有限公司

資產負債表

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105.12.31	104.12.31		105.12.31	104.12.31
	金額	金額		金額	金額
資產			負債及權益		
流動資產：			流動負債：		
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,501,000	2,147,611	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 11,745,000	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動			2170 應付票據及帳款	192,895	170,275
(附註六(二))	2,442	-	2180 應付關係人款項(附註七)	4,777,195	1,376,948
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	1,122,313	1,025,424	2201 應付薪資及獎金	114,917	150,540
1180 應收關係人款項(附註七)	1,618,545	1,229,990	2300 其他流動負債	189,822	200,490
130X 存貨(附註六(四))	1,410,305	892,618	2322 一年內到期長期借款(附註六(十))	297,479	-
1421 預付材料款	120,801	96,509		17,317,308	1,898,253
1470 其他流動資產	35,100	37,637	非流動負債：		
	6,810,506	5,429,789	2540 長期借款(附註六(十一))	8,156,327	-
非流動資產：			2600 其他非流動負債(附註六(十二)及(十三))	599,430	515,905
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	32,361,431	12,843,098		8,755,757	515,905
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七)	334,997	300,965		26,073,065	2,414,158
1780 無形資產(附註六(八)及七)	1,631,850	-	負債總計		
1900 其他非流動資產(附註六(十三))	437,112	271,558	權益(附註六(十四)及(十五))：		
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	85,159	5,471	3110 普通股股本	3,692,500	3,692,500
1995 長期預付材料款	186,714	287,874	3200 資本公積	11,741,399	11,767,321
	35,037,263	13,708,966	保留盈餘：		
			3310 法定盈餘公積	719,690	517,331
			3320 特別盈餘公積	239,802	239,802
			3350 未分配盈餘	973,790	2,023,591
				1,933,282	2,780,724
			3400 其他權益	(1,592,477)	(1,515,948)
			權益總計	15,774,704	16,724,597
資產總計	\$ 41,847,769	19,138,755	負債及權益總計	\$ 41,847,769	19,138,755
				100	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：徐秀鈴

環球晶圓股份有限公司

綜合損益表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度		104年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 6,749,320	100	6,898,559	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十一)、(十二)及七)	5,389,211	80	5,944,524	86
營業毛利	1,360,109	20	954,035	14
營業費用(附註六(三)、(五)、(十一)、(十二)及七)：				
6100 推銷費用	95,883	1	91,494	1
6200 管理費用	367,409	6	83,678	1
6300 研究發展費用	228,984	3	178,891	3
營業費用合計	692,276	10	354,063	5
營業淨利	667,833	10	599,972	9
營業外收入及支出：				
7010 利息收入(附註七)	13,718	-	24,825	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九)及七)	203,477	3	54,226	1
7050 利息費用	(38,253)	-	(974)	-
7370 採用權益法認列之子公司損益之份額	154,355	2	1,577,539	23
營業外收入及支出合計	333,297	5	1,655,616	24
稅前淨利	1,001,130	15	2,255,588	33
7950 所得稅費用(附註六(十三))	61,645	1	211,395	3
本期淨利	939,485	14	2,044,193	30
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	(9,577)	-	(11,522)	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額—確定福利計畫之再衡量數	48,396	-	(13,318)	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(6,599)	-	4,223	-
	32,220	-	(20,617)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(232,053)	(4)	375,920	5
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	116,075	2	(116,075)	(2)
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十三))	39,449	1	(63,906)	(1)
後續可能重分類至損益之項目合計	(76,529)	(1)	195,939	2
8300 本期其他綜合損益	(44,309)	(1)	175,322	2
本期綜合損益總額	\$ 895,176	13	2,219,515	32
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
基本每股盈餘	\$ 2.54		5.80	
稀釋每股盈餘	\$ 2.54		5.78	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：徐秀鈴





環球晶圓股份有限公司

權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月二日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	保留盈餘			國外營運 機構財務 報表換算 之兌換差	國外營運 機構財務 報表換算 之兌換差	其他權益項目
				法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘			
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 3,175,000	2,074	9,311,229	307,788	-	2,116,610	(1,711,887)	-	權益總計
本期淨利	-	-	-	-	-	2,044,193	-	-	13,200,814
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(20,617)	312,014	(116,075)	2,044,193
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,023,576	312,014	(116,075)	175,322
盈餘指撥及分配：									2,219,515
提列法定盈餘公積	-	-	-	209,543	-	(209,543)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	239,802	(239,802)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(1,667,250)	-	-	(1,667,250)
資本公積配發現金股利	-	-	(323,475)	-	-	-	-	-	(323,475)
現金增資	517,500	(2,074)	2,776,250	-	-	-	-	-	3,291,676
員工認股權憑證酬勞成本	-	-	3,317	-	-	-	-	-	3,317
民國一〇四年十二月三十一日餘額	3,692,500	-	11,767,321	517,331	239,802	2,023,591	(1,399,873)	(116,075)	16,724,597
本期淨利	-	-	-	-	-	939,485	-	-	939,485
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	32,220	(192,604)	116,075	(44,309)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	971,705	(192,604)	116,075	895,176
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	202,359	-	(202,359)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(1,819,147)	-	-	(1,819,147)
資本公積配發現金股利	-	-	(27,103)	-	-	-	-	-	(27,103)
員工認股權憑證酬勞成本	-	-	1,181	-	-	-	-	-	1,181
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 3,692,500	-	11,741,399	719,690	239,802	973,790	(1,592,477)	-	15,774,704

註：本公司民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日董事酬勞分別為3,500千元及5,000千元、員工酬勞分別為41,400千元及73,870千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：徐秀鈴



環球晶圓股份有限公司

現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,001,130	2,255,588
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	98,885	108,742
呆帳費用提列數	5,683	373
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(2,442)	-
利息費用	38,253	974
利息收入	(13,718)	(24,825)
員工認股權憑證酬勞成本	1,181	3,317
採用權益法認列之子公司損益之份額及未實現銷貨毛利變動	(117,846)	(1,519,505)
提列存貨跌價及呆滯損失	9,915	3,874
非金融資產減損損失	(21,543)	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	(1,632)	(1,427,050)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款(含關係人)	172,819	(262,540)
存貨	(506,059)	(223,724)
預付材料款	76,868	186,033
其他營業資產	2,056	31,350
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(254,316)	(268,881)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(含關係人)	413,017	(133,000)
其他營業負債	7,792	(93,831)
淨確定福利負債	(34,944)	113
與營業活動相關之負債之淨變動合計	385,865	(226,718)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	131,549	(495,599)
調整項目合計	129,917	(1,922,649)
營運產生之現金流入	1,131,047	332,939
收取之利息	13,027	25,607
支付之利息	(23,703)	(1,430)
支付所得稅	(173,941)	(6,054)
營業活動之淨現金流入	946,430	351,062

(續下頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：徐秀鈴



環球晶圓股份有限公司

現金流量表(本土頁)

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	105年度	104年度
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(113,066)	(150,670)
存出保證金增加	(1,088)	(313)
應收關係人款項增加	(662,774)	-
其他金融資產減少(增加)	(78,600)	1,018
採用權益法之投資增加	(19,468,069)	-
投資活動之淨現金流出	(20,323,597)	(149,965)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	11,745,000	(897,000)
舉借長期借款	8,453,806	-
應付關係人帳款增加	1,378,000	-
發放現金股利	(1,846,250)	(1,990,725)
現金增資	-	3,291,676
籌資活動之淨現金流入	19,730,556	403,951
本期現金及約當現金增加數	353,389	605,048
期初現金及約當現金餘額	2,147,611	1,542,563
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,501,000	2,147,611

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：徐秀鈴



環球晶圓股份有限公司
個體財務報告附註
民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

環球晶圓股份有限公司(以下稱本公司)係於民國一〇〇年十月一日由中美矽晶製品股份有限公司(以下簡稱中美矽晶公司)將其半導體事業部門相關營業、資產及負債分割予本公司，並於民國一〇〇年十月十八日經科學工業園區管理局核准設立，註冊地址為新竹科學工業園區工業東二路八號。本公司主要營業項目為半導體矽晶材料及其元件之研究開發、設計、製造及銷售，與前述相關產品之技術、管理資訊顧問業務服務。

本公司之股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心准予辦理上櫃交易，於民國一〇四年九月二十五日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國一〇六年三月二十一日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)尚未採用金融監督管理委員會認可國際財務報導準則之影響

依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)民國一〇五年七月十八日金管證審字第1050026834號令，公開發行以上公司應自民國一〇六年起全面採用經金管會認可並發布生效之國際會計準則理事會(以下稱理事會)於民國一〇五年一月一日前發布，並於民國一〇六年一月一日生效之國際財務報導準則編製財務報告。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第10號、國際財務報導準則第12號及國際會計準則第28號之修正「投資個體：適用合併報表例外規定」	105年1月1日
國際財務報導準則第11號之修正「取得聯合營運權益之會計處理」	105年1月1日
國際財務報導準則第14號「管制遞延帳戶」	105年1月1日
國際會計準則第1號之修正「揭露倡議」	105年1月1日
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	105年1月1日
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號之修正「農業：生產性植物」	105年1月1日
國際會計準則第19號之修正「確定福利計畫：員工提撥」	103年7月1日

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際會計準則第27號之修正「單獨財務報表之權益法」	105年1月1日
國際會計準則第36號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	103年1月1日
國際會計準則第39號之修正「衍生工具之約務更替與避險會計之持續適用」	103年1月1日
2010-2012及2011-2013週期之年度改善	103年7月1日
2012-2014年國際財務報導年度改善	105年1月1日
國際財務報導解釋第21號「公課」	103年1月1日

本公司經評估後認為適用上述新認可之國際財務報導準則將不致對個體財務報告造成重大變動。

(二)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列理事會已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋。截至本個體財務報告發布日止，除國際財務報導準則第9號及第15號業經金管會通過自民國一〇七年一月一日生效外，金管會尚未發布其他準則生效日。

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	107年1月1日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」	107年1月1日
國際財務報導準則第16號「租賃」	108年1月1日
國際財務報導準則第2號之修正「股份基礎給付交易之分類及衡量」	107年1月1日
國際財務報導準則第15號之修正「國際財務報導準則第15號之闡釋」	107年1月1日
國際會計準則第7號之修正「揭露倡議」	106年1月1日
國際會計準則第12號之修正「因未實現損失所產生遞延所得稅資產之認列」	106年1月1日
國際財務報導準則第4號「保險合約」之修正(適用國際財務報導準則第9號「金融工具」及國際財務報導準則第4號「保險合約」)	107年1月1日

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
2014-2016年國際財務報導年度改善：	
國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」	106年1月1日
國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」及國際會計準則第28號「投資關聯企業及合資」	107年1月1日
國際財務報導解釋第22號「外幣交易及預收付對價」	107年1月1日
國際會計準則第40號之修正「投資性不動產之轉換」	107年1月1日

對本公司可能攸關者如下：

發布日	新發布或修訂準則	主要修訂內容
103.5.28 105.4.12	國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」	新準則以單一分析模型按五個步驟決定企業認列收入之方法、時點及金額，將取代現行國際會計準則第18號「收入」及國際會計準則第11號「建造合約」以及其他收入相關的解釋。 105.4.12發布修正規定闡明下列項目：辨認履約義務、主理人及代理人之考量、智慧財產之授權及過渡處理。
102.11.19 103.7.24	國際財務報導準則第9號「金融工具」	新準則將取代國際會計準則第39號「金融工具：認列與衡量」，主要修正如下： • 分類及衡量：金融資產係按合約現金流量之特性及企業管理資產之經營模式判斷，分類為按攤銷後成本衡量、透過其他綜合損益按公允價值衡量及透過損益按公允價值衡量。另指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債，其歸因於信用風險之公允價值變動數係認列於其他綜合損益。 • 減損：新預期損失模式取代現行已發生損失模式。 • 避險會計：採用更多原則基礎法之規定，使避險會計更貼近風險管理，包括修正達成、繼續及停止採用避險會計之規定，並使更多類型之暴險可符合被避險項目之條件等。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

發布日	新發布或修訂準則	主要修訂內容
105.1.13	國際財務報導準則第16號「租賃」	新準則將租賃之會計處理修正如下： • 承租人所簽訂符合租賃定義之所有合約均應於資產負債表認列使用權資產及租賃負債。租賃期間內租賃費用則係以使用權資產折舊金額加計租賃負債之利息攤提金額衡量。 • 出租人所簽訂符合租賃定義之合約則應分類為營業租賃及融資租賃，其會計處理與國際會計準則第17號「租賃」類似。

本公司評估國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」及第9號「金融工具」將不致對本公司財務狀況與經營結果產生重大影響，現正持續評估國際財務報導準則第16號「租賃」對本公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本個體財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。除附註三外，下列會計政策已一致適用於本個體財務報告之所有表達期間。

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製。

(二) 編製基礎

1. 衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本個體財務報告係依歷史成本為基礎編製：

(1) 透過損益按公允價值衡量金融資產；

(2) 淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值衡量。

2. 功能性貨幣及表達貨幣

本公司每一個體均係以各營運所處主要經濟環境之貨幣為其功能性貨幣。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣，新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三) 外幣

1. 外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。換算所產生之外幣兌換差異認列為損益。

2. 國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，包括收購時產生之商譽及公允價值調整，係依報導日之匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

(四) 資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

1. 預期於本公司正常營業週期中實現，或意圖將其出售或消耗者。
2. 主要為交易目的而持有者。
3. 預期將於資產負債表日後十二個月內實現者。
4. 現金或約當現金，但不包括於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

1. 預期將於本公司正常營業週期中清償者。
2. 主要為交易目的而持有者。
3. 預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
4. 本公司不能無條件將清償期限延期至資產負債表日後至少十二個月者。

(五) 現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(六) 金融工具

金融資產與金融負債係於本公司成為該金融工具合約條款之一方時認列。

1. 金融資產

本公司之金融資產係為透過損益按公允價值衡量之金融資產及應收款。

(1) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其係因其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失(包含相關股利收入及利息收入)認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(2)應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收票據及應收帳款。原始認列時按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量，後續評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

利息收入係列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

金融資產減損之客觀證據包括發行人之重大財務困難、違約(如利息或本金支付之延滯或不償付)、債務人將進入破產或其他財務重整之可能性大增，及由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失等。

針對應收帳款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含本公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收帳款係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。當判斷應收帳款無法收回時，係沖銷備抵帳戶。原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

應收帳款之呆帳損失及迴升係列報於營業費用。應收帳款以外金融資產之減損損失及迴升係列報於營業外收入及支出項下。

(4)金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產所有權幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

2.金融負債及權益工具

(1)負債或權益之分類

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

權益工具係指表彰本公司於資產減除其所有負債後剩餘權益之任何合約。本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

與金融負債相關之利息及損失或利益係認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(2)其他金融負債

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者包括長短期借款及應付帳款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；後續評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。未資本化為資產成本之利息費用列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融負債之除列

本公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額(包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債)間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(4)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於本公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

3.衍生金融工具

本公司為規避外幣風險之暴險而持有衍生金融工具。原始認列時係按公允價值衡量，交易成本則認列為損益；後續評價依公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失直接列入損益，並列報於營業外收入及支出項下之其他利益及損失。當衍生工具之公允價值為正值時，列為金融資產；公允價值為負值時，列為金融負債。

(七)存 貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用的地點及狀態所發生之取得、產製或加工成本及其他成本，並採加權平均法計算。製成品及在製品存貨之成本包括依適當比例按正常產能分攤之製造費用。

淨變現價值係指正常營業下之估計售價減除估計完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(八)投資子公司

於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司係採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。

(九)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出。自建資產成本包含原料及直接人工、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本，以及符合要件資產資本化之借款成本。為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊率或折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，係由不動產、廠房及設備之帳面金額與處分價款之差額決定，並以淨額認列於營業外收入及支出項下之「其他利益及損失」。

2.後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入本公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3.折 舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計算，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

(1)房屋及建築：2~40年

(2)機器設備：2~15年

(3)其他設備：2~20年

(4)房屋及建築之重大組成部分主要有廠房主建築物、機電動力工程及廢水處理系統等，並分別按其耐用年限25~40年、25年及4~15年予以計提折舊。

本公司至少於每一年度報導日檢視折舊方法、耐用年限及殘值，若預期值與先前之估計不同時，於必要時適當調整，該變動按會計估計變動規定處理。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十) 租賃

本公司之租賃係屬營業租賃，該等租賃資產未認列於本公司之資產負債表。

營業租賃之租金給付(不包括保險及維護等服務成本)依直線基礎於租賃期間認列為費用。

(十一) 無形資產

1. 研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1) 完成無形資產之技術可行性已達成，將使該無形資產將可供使用或出售。
- (2) 意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
- (3) 有能力使用或出售該無形資產。
- (4) 無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5) 具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6) 歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

2. 其他無形資產

本公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

3. 後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方可將其資本化。所有其他支出於發生時認列於損益。

4. 攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額。

無形資產自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益。

本公司至少於每一年度報導日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十二) 非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，本公司於每一報導日評估是否發生減損，並就有減損跡象之資產估計其可回收金額。若無法估計個別資產之可回收金額，則本公司估計該項資產所屬現金產生單位之可回收金額以評估減損。

可回收金額為個別資產或現金產生單位之公允價值減出售成本與其使用價值孰高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於帳面金額，則將該個別資產或現金產生單位之帳面金額調整減少至可回收金額，並認列減損損失。減損損失係立即認列於當期損益。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司於每一報導日重新評估是否有跡象顯示，商譽以外之非金融資產於以前年度所認列之減損損失可能已不存在或減少。若用以決定可回收金額之估計有任何改變，則迴轉減損損失，以增加個別資產或現金產生單位之帳面金額至其可回收金額，惟不超過若以前年度該個別資產或現金產生單位未認列減損損失之情況下，減除應提列折舊或攤銷後之帳面金額。

(十三)收入認列

1.商品銷售

係正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在(通常為已簽訂之客戶訂單)、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回、相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

風險及報酬移轉之時點係視銷售合約個別條款而定。外銷交易主要採起運點交貨，風險及報酬係於港口將貨品運裝上船時移轉予買方；對於內銷交易，風險及報酬則通常於商品送達客戶倉庫驗收時移轉。

2.勞務

本公司提供勞務服務予客戶。提供勞務所產生之收入係按報導期間結束日之交易完成程度認列。

3.政府補助款

本公司取得之政府研發補助係依已發生成本佔預計總成本之比例，逐期認列於營業外收入及支出項下。

(十四)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2.確定福利計畫

非屬確定提撥計畫之退職福利計畫為確定福利計畫。本公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係分別針對各項福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何計畫資產的公允價值均予以減除。折現率係以到期日與本公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於財務報導日之利率為主。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

企業淨義務每年由合格精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對本公司有利時，認列資產係以未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於本公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對本公司而言，即具有經濟效益。

當計畫內容之福利改善，因員工過去服務使福利增加之部分，相關費用立即認列為損益。

淨確定福利負債(資產)之再衡量數包含(1)精算損益；(2)計畫資產報酬，但不包括包含於淨確定福利負債(資產)淨利息之金額；及(3)資產上限影響數之任何變動，但不包括包含於淨確定福利負債(資產)淨利息之金額。淨確定福利負債(資產)再衡量數認列於其他綜合損益項目下。本公司並已選擇將該等已認列於其他綜合損益項目下之金額轉入保留盈餘。

本公司於縮減或清償發生時，認列確定福利計畫之縮減或清償損益。縮減或清償損益包括任何計畫資產公允價值之變動及確定福利義務現值之變動。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使本公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十五)股份基礎給付交易

給與員工之股份基礎給付獎酬係以給與日之公允價值，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列酬勞成本並增加相對權益。認列之酬勞成本係隨預期符合服務條件之獎酬數量予以調整；而最終認列之金額係以既得日符合服務條件之獎酬數量為基礎衡量。

(十六)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。下列情況產生之暫時性差異不予認列遞延所得稅：

- 1.非屬企業合併之交易原始認列之資產或負債，且於交易當時不影響會計利潤及課稅所得(損失)者。
- 2.因投資子公司及合資權益所產生，且很有可能於可預見之未來不會迴轉者。
- 3.商譽之原始認列。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

本公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；

(1)同一納稅主體；或

(2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於未使用之課稅損失及未使用所得稅抵減遞轉後期，與可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

(十七)企業合併

本公司依收購日移轉對價之公允價值，包括歸屬於被收購者任何非控制權益之金額，減除所取得之可辨認資產及承擔之負債之淨額(通常為公允價值)來衡量商譽。若減除後之餘額為負數，則本公司重新評估是否已正確辨認所有取得之資產及所有承擔之負債後，始將廉價購買利益認列於損益。

除與發行債務或權益工具相關者外，與企業合併相關之交易成本均應於發生時立即認列為本公司之費用。

若企業合併之原始會計處理於合併交易發生之報導日前尚未完成，本公司對於尚不完整之會計處理項目係以暫定金額認列，並於衡量期間內予以追溯調整或認列額外之資產或負債，以反映於衡量期間所取得關於收購日已存在事實與情況之新資訊。衡量期間自收購日起不超過一年。

(十八)每股盈餘

本公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。本公司基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括尚未經股東會決議且得採股票發放之員工酬勞。

(十九)部門資訊

本公司已於合併財務報表揭露部門資訊，因此個體財務報表不揭露部門資訊。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依證券發行人財務報告編製準則編製本個體財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理當局持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

本個體財務報告所採用之會計政策未有涉及重大判斷。

對於假設及估計之不確定性中，可能於次一年度造成調整之相關資訊如下：

(一)存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，本公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動。存貨評價估列情形請詳附註六(四)。

(二)企業合併

本公司為擴大全球銷售網絡及提昇產品研發能力，於民國一〇五年度收購Topsil Semiconductor Materials A/S 旗下之半導體事業群(以下稱Topsil)及SunEdison Semiconductor Limited (以下稱SSL)全數股權，取得對該等公司之控制力。上述收購的交易價格係為購買該等營運個體之營業資產、技術及商譽等項目，有關所取得之可辨認資產與負債的公允價值認列可能涉及管理階層之假設及估計不確定性。有關取得子公司之說明，請詳附註六(五)。

本公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量金融、非金融資產及負債。本公司財務及會計部門負責進行獨立公允價值驗證，藉獨立來源資料使評價結果貼近市場狀態、確認資料來源係獨立、可靠、與其他資源一致以及代表可執行價格，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

本公司在衡量資產及負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，其歸類如下：

- 第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。
- 第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。
- 第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，本公司係於報導日認列該移轉。衡量公允價值所採用假設之相關資訊詳下列附註六(二十)金融工具。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	105.12.31	104.12.31
現金	\$ 100	100
銀行存款	2,316,565	990,079
定期存款	184,335	1,157,432
	<u>\$ 2,501,000</u>	<u>2,147,611</u>

本公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(二十)。

(二)透過損益按公允價值衡量之金融負債

	105.12.31	104.12.31
指定透過損益按公允價值衡量之金融負債：		
遠期外匯合約	<u>\$ 2,442</u>	<u>-</u>

從事衍生金融工具交易用以規避因營業活動所暴露之匯率風險，本公司因未適用避險會計列報為持有供交易之金融負債之衍生工具明細如下：

	105.12.31		
	合約金額(千元)	幣別	到期期間
賣出遠期外匯	USD 6,000	美元兌日幣	106.2.20

(三)應收票據及帳款淨額

	105.12.31	104.12.31
應收帳款	\$ 1,145,976	1,028,454
減：備抵呆帳	(6,385)	(702)
備抵退回及折讓	(17,278)	(2,328)
	<u>\$ 1,122,313</u>	<u>1,025,424</u>

應收款項備抵呆帳之變動如下：

	105年度	104年度
1月1日餘額	\$ 702	329
認列之減損損失	5,683	373
12月31日餘額	<u>\$ 6,385</u>	<u>702</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司報導日已逾期但未減損應收款項之帳齡分析如下：

	105.12.31	104.12.31
逾期1~30天	\$ 24,452	13,071
逾期31~60天	7,420	3,980
逾期61~90天	423	-
逾期121~150天	1,254	-
逾期151~180天	390	-
	<u>\$ 33,939</u>	<u>17,051</u>

(四)存 貨

	105.12.31	104.12.31
商品	\$ 348,351	297,655
製成品	128,272	122,316
在製品	22,295	15,108
原料	863,675	400,424
物料	47,712	57,115
	<u>\$ 1,410,305</u>	<u>892,618</u>

營業成本組成明細如下：

	105年度	104年度
銷貨成本	\$ 5,333,613	5,876,540
提列存貨跌價損失	9,915	3,874
未分攤固定製造費用	45,683	64,110
	<u>\$ 5,389,211</u>	<u>5,944,524</u>

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，本公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

(五)企業合併

本公司於民國一〇五年七月一日透過收購丹麥上市公司旗下之半導體事業群Topsil 100%之股權，而取得對Topsil之控制。

本公司於民國一〇五年十二月二日透過子公司Gwafers Singapore Pte. Ltd.收購SSL全部流通在外普通股，而取得對SSL之控制。

上述交易移轉對價及收購日取得之可辨認資產及所承受之負債說明請詳合併財務報告。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(六)採用權益法之投資

本公司於財務報導期間結束日採用權益法之投資列示如下：

	105.12.31	104.12.31
子公司	\$ <u>32,361,431</u>	<u>12,843,098</u>

1.子公司

相關資訊請參閱民國一〇五年度合併財務報告。

2.擔保

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，本公司之採用權益法之投資均未提供作質押擔保之情形。

(七)不動產、廠房及設備

1.本公司不動產、廠房及設備之成本、折舊變動明細如下：

	房屋及 建 築	機器設備	其他設備	待驗設備	總 計
成本：					
民國105年1月1日餘額	\$ 179,143	849,898	102,193	4,471	1,135,705
增 添	8,251	45,171	48,381	31,114	132,917
處 分	(4,924)	(98,248)	(21,071)	-	(124,243)
重 分 類	<u>-</u>	<u>2,519</u>	<u>1,952</u>	<u>(4,471)</u>	<u>-</u>
民國105年12月31日餘額	<u>\$ 182,470</u>	<u>799,340</u>	<u>131,455</u>	<u>31,114</u>	<u>1,144,379</u>
民國104年1月1日餘額	\$ 181,540	779,980	49,976	9,710	1,021,206
增 添	7,871	89,586	53,773	4,471	155,701
處 分	(10,268)	(26,593)	(4,341)	-	(41,202)
重 分 類	<u>-</u>	<u>6,925</u>	<u>2,785</u>	<u>(9,710)</u>	<u>-</u>
民國104年12月31日餘額	<u>\$ 179,143</u>	<u>849,898</u>	<u>102,193</u>	<u>4,471</u>	<u>1,135,705</u>
折舊：					
民國105年1月1日餘額	\$ 117,396	674,324	43,020	-	834,740
本期折舊	10,674	69,930	18,281	-	98,885
處 分	<u>(4,924)</u>	<u>(98,248)</u>	<u>(21,071)</u>	<u>-</u>	<u>(124,243)</u>
民國105年12月31日餘額	<u>\$ 123,146</u>	<u>646,006</u>	<u>40,230</u>	<u>-</u>	<u>809,382</u>
民國104年1月1日餘額	\$ 117,163	616,983	33,054	-	767,200
本期折舊	10,501	83,934	14,307	-	108,742
處 分	<u>(10,268)</u>	<u>(26,593)</u>	<u>(4,341)</u>	<u>-</u>	<u>(41,202)</u>
民國104年12月31日餘額	<u>\$ 117,396</u>	<u>674,324</u>	<u>43,020</u>	<u>-</u>	<u>834,740</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

	房屋及 建 築	機器設備	其他設備	待驗設備	總 計
帳面價值：					
民國105年12月31日	\$ <u>59,324</u>	<u>153,334</u>	<u>91,225</u>	<u>31,114</u>	<u>334,997</u>
民國104年1月1日	\$ <u>64,377</u>	<u>162,997</u>	<u>16,922</u>	<u>9,710</u>	<u>254,006</u>
民國104年12月31日	\$ <u>61,747</u>	<u>175,574</u>	<u>59,173</u>	<u>4,471</u>	<u>300,965</u>

2.擔 保

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，本公司之不動產、廠房及設備均未提供作質押擔保之情形。

(八)無形資產

本公司無形資產為商標權及專利權，相關取得成本及攤銷明細如下：

	105年度
成本：	
1月1日餘額	\$ -
增添	<u>1,631,850</u>
12月31日餘額	<u>1,631,850</u>
帳面價值：	
12月31日餘額	\$ <u><u>1,631,850</u></u>

民國一〇五年十二月三十一日，本公司之無形資產未有提供作質抵押擔保之情形。

(九)短期借款

	105.12.31	104.12.31
無擔保銀行借款	\$ <u>11,745,000</u>	<u>-</u>
未動用融資額度	\$ <u>2,803,026</u>	<u>5,497,750</u>
借款利率區間	<u>0.88%~1.60%</u>	<u>-</u>

(十)長期借款

本公司長期借款之明細、條件與條款如下：

	105.12.31			
	幣別	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	NTD	1.154%~2.0854%	106.11~110.12	\$ 8,453,806
減：一年內到期部份				<u>(297,479)</u>
合 計				\$ <u><u>8,156,327</u></u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司於民國一〇五年十一月二十九日與兆豐銀行及其四家銀行簽訂聯合借款合同，取得美金200,000千元(或等值新台幣)之融資額度。

依民國一〇五年十一月二十九日簽署之借款合同規定：

- 1.本公司自動撥日後六個月起，經會計師查核簽證之年度及經核閱之第二季合併財務報表皆應維持特定之流動比率、利息保障倍數及財務槓桿比率；
- 2.借款僅限作為收購SunEdison Semiconductor Limited之用途；
- 3.本公司應保持直接或間接持有SunEdison Semiconductor Limited及其子公司股權達51%以上；
- 4.若上述借款有違約情事，本公司不得支付任何現金股利、不得償還除上述借款外之利息和借款及以其他方式分配現金予股東或其他借款人。

依上述合約規定本公司若於合約簽署日後一個月內之實際動撥金額小於總融資約定額度之80%，本公司需就此差額部份0.1%支付一次性承諾費。截至民國一〇五年十二月三十一日止，本公司對上述承諾費應支付金額為美金80千元，帳列其他流動負債項下。

上述約定條款之首次檢覈日為款項動撥日起算後六個月，本公司於民國一〇五年十二月三十一日之合併財務報告雖暫未能符合合約所訂流動比率之限制條件，然未違反借款合同；另，本公司有關流動比率改善計畫請詳附註十一。

(十一)營業租賃

不可取消營業租賃之未來最低租賃給付總額如下：

	105.12.31	104.12.31
一年內	\$ 20,471	6,873
一年至五年	9,702	11,163
	<u>\$ 30,173</u>	<u>18,036</u>

民國一〇五年度及一〇四年度營業租賃列報於損益之費用分別為24,526千元及9,182千元。

本公司位於新竹科學工業園區廠房之基地係向科學工業園區管理局承租，原租賃期間自民國八十九年十月一日起至民國一〇九年十二月三十一日止，計二十年。依約租金應按政府規定地價之調整幅度調整，每年租金約為2,747千元。

本公司向母公司中美矽晶公司承租廠房供生產製造使用，租賃期間自民國一〇五年二月一日起至一〇七年一月三十一日止，每年租金為17,548千元。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十二)員工福利

1.確定福利計劃

本公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
確定福利義務現值	\$ (95,273)	(86,039)
計畫資產之公允價值	<u>53,989</u>	<u>19,388</u>
淨確定福利負債	<u>\$ (41,284)</u>	<u>(66,651)</u>

本公司之確定福利計畫提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

本公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局（以下簡稱勞動基金局）統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計53,989千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動部勞動基金運用局網站公布之資訊。

(2)確定福利義務現值之變動

本公司民國一〇五年度及一〇四年度確定福利義務現值變動如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
1月1日確定福利義務	\$ 86,039	72,260
當期服務成本及利息	2,111	2,046
淨確定福利負債再衡量數		
—因經驗調整所產生之精算損益	5,359	5,725
—因人口統計假設變動所產生之精算損益	2,726	3,950
—因財務假設變動所產生之精算損益	1,182	2,058
計畫資產支付數	<u>(2,144)</u>	<u>-</u>
12月31日確定福利義務	<u>\$ 95,273</u>	<u>86,039</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(3)計畫資產公允價值之變動

本公司民國一〇五年度及一〇四年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 19,388	17,244
利息收入	636	292
淨確定福利負債再衡量數		
—計畫資產報酬(不含當期利息)	(310)	211
已提撥至計劃之金額	36,419	1,641
計畫資產支付數	<u>(2,144)</u>	<u>-</u>
12月31日計畫資產之公允價值	<u><u>\$ 53,989</u></u>	<u><u>19,388</u></u>

(4)認列為損益之費用

本公司民國一〇五年度及一〇四年度認列費用之明細如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
當期服務成本	\$ 928	872
淨確定福利負債之淨利息	<u>547</u>	<u>882</u>
	<u><u>\$ 1,475</u></u>	<u><u>1,754</u></u>
營業成本	\$ 1,091	1,382
推銷費用	87	123
管理費用	2	53
研究發展費用	<u>295</u>	<u>196</u>
	<u><u>\$ 1,475</u></u>	<u><u>1,754</u></u>

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

本公司截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日累計認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
1月1日累積餘額	\$ (32,479)	(20,957)
本期認列	<u>(9,577)</u>	<u>(11,522)</u>
12月31日累積餘額	<u><u>\$ (42,056)</u></u>	<u><u>(32,479)</u></u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(6) 精算假設

本公司於財務報導結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
折現率	1.250%	1.375%
未來薪資增加	2.000%	2.000%

本公司預計於民國一〇五年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為60,254千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為10.5年。

(7) 敏感度分析

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日當採用之主要精算假設變動0.25%時，對確定福利義務現值之影響如下：

<u>精算假設</u>	<u>對確定福利義務之影響</u>	
	<u>增加0.25%</u>	<u>減少0.25%</u>
105年12月31日		
折現率	\$ <u>(2,479)</u>	<u>2,574</u>
調薪率	\$ <u>2,502</u>	<u>(2,423)</u>
104年12月31日		
折現率	\$ <u>(2,227)</u>	<u>2,312</u>
調薪率	\$ <u>2,245</u>	<u>(2,174)</u>

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨退休金負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

2. 確定提撥計畫

本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資百分之六之提繳率，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。

本公司民國一〇五年度及一〇四年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為14,319千元及12,944千元，已提撥至勞工保險局。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十三)所得稅

1.所得稅費用

本公司民國一〇五年度及一〇四年度之所得稅費用明細如下：

	105年度	104年度
當期所得稅費用	\$ 105,308	130,564
遞延所得稅費用	(43,663)	80,831
	<u>\$ 61,645</u>	<u>211,395</u>

本公司民國一〇五年度及一〇四年度認列於其他綜合損益之下的所得稅費用明細如下：

	105年度	104年度
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	\$ 6,599	(4,223)
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(39,449)	63,906
	<u>\$ (32,850)</u>	<u>59,683</u>

本公司民國一〇五年度及一〇四年度之所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	105年度	104年度
稅前淨利	\$ 1,001,130	2,255,588
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	170,192	383,450
投資抵減增加數	(11,277)	(10,000)
未分配盈餘加徵10%稅額	207	-
永久性差異調整	(84,417)	(153,900)
前期高低估數及未認列暫時性差異之變動	(13,060)	(8,155)
	<u>\$ 61,645</u>	<u>211,395</u>

2.遞延所得稅資產及負債

(1)本公司未認列為遞延所得稅資產之項目如下：

	105.12.31	104.12.31
可減除暫時性差異	\$ 11,142	28,748

因本公司預期於可預見之短期不會實現，故未認列為遞延所得稅資產。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2)本公司未認列為遞延所得稅負債之項目如下：

	105.12.31	104.12.31
與投資子公司相關之暫時性差異彙總金額	\$ <u>(56,003)</u>	<u>(46,179)</u>

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日與投資子公司相關之暫時性差異因本公司控制該項暫時性差異迴轉之時點，且確認於可預見之未來不會迴轉，故未認列遞延所得稅負債。

(3)已認列之遞延所得稅資產及負債

	104.1.1	認列於 損 益	認列於 其他綜 合損益	104.12.31	認列於 損 益	認列於 其他綜 合損益	105.12.31
遞延所得稅資產：							
備抵存貨跌價損失	\$ 4,336	658	-	4,994	1,686	-	6,680
採用權益法之投資	-	-	-	-	150,514	(9,875)	140,639
國外營運機構財務報 表換算之兌換損失	279,219	-	(63,906)	215,313	-	39,449	254,762
其他	18,813	9,307	1,959	30,079	2,003	1,628	33,710
	<u>\$ 302,368</u>	<u>9,965</u>	<u>(61,947)</u>	<u>250,386</u>	<u>154,203</u>	<u>31,202</u>	<u>435,791</u>
遞延所得稅負債：							
採用權益法之投資	\$ (346,528)	(102,602)	2,264	(446,866)	(80,798)	1,648	(526,016)
其他	(14,194)	11,806	-	(2,388)	(29,742)	-	(32,130)
	<u>\$ (360,722)</u>	<u>(90,796)</u>	<u>2,264</u>	<u>(449,254)</u>	<u>(110,540)</u>	<u>1,648</u>	<u>(558,146)</u>

3.所得稅核定情形

本公司營利事業所得稅結算申報已奉稽徵機關核定至民國一〇二年度。

4.本公司兩稅合一相關資訊如下：

	105.12.31	104.12.31
未分配盈餘所屬年度：		
八十七年度以後	\$ <u>973,790</u>	<u>2,023,591</u>
可扣抵稅額帳戶餘額	\$ <u>65,032</u>	<u>-</u>
	105年度 (預計)	104年度 (實際)
對中華民國居住者盈餘分配之稅額扣抵比率	<u>12.42%</u>	<u>5.25%</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

前述兩稅合一相關資訊係依據財政部民國一〇二年十月十七日台財稅第10204562810號函規定處理之金額。依新修正之所得稅法第66條之6，屬於中華民國境內居住之個人股東其可扣抵稅額比率予以減半，並自民國一〇四年一月一日起分派盈餘時開始適用。

(十四)資本及其他權益

1.普通股股本

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，本公司額定股本總額皆為4,000,000千元，每股面額10元，皆為400,000千股(皆含保留員工認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債、可認購股份數額200,000千元)。額定股本業已辦妥變更登記。實收股本皆為3,692,500千元。

本公司於民國一〇三年十一月十三日經董事會決議辦理現金增資發行新股317,500千元，每股面額10元，計發行新股31,750千股，以每股65元溢價發行，發行總金額為2,063,750千元，溢價總額為1,746,250千元，帳列資本公積項下。此項增資案業經金融監督管理委員會核准，並以民國一〇四年一月二十九日為增資基準日，所有發行股份之股款均已收取，且相關法定登記程序已辦理完竣。

本公司為配合股票初次上櫃前承銷，於民國一〇四年七月二十三日經董事會決議辦理現金增資發行新股200,000千元，每股面額10元，計發行新股20,000千股，以每股61.5元溢價發行，發行總金額為1,230,000千元，溢價總額為1,030,000千元，帳列資本公積項下。此項增資案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，並以民國一〇四年九月二十四日為增資基準日，所有發行股份之股款均已收取，且相關法定登記程序已辦理完竣。

2.資本公積

本公司資本公積餘額內容如下：

	105.12.31	104.12.31
普通股股票溢價	\$ 11,680,672	11,707,775
母公司給予員工認股權等	60,727	59,546
	<u>\$ 11,741,399</u>	<u>11,767,321</u>

依民國一〇一年一月修正之公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

本公司於民國一〇五年六月二十二日及一〇四年六月二十三日分別經股東會決議以資本公積配發現金27,103千元(每股0.0734元)及323,475千元(每股0.9262元)，相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢之。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.保留盈餘

依本公司之章程規定，年度決算如有盈餘，按下列順序分配之：

- (1)彌補虧損。
- (2)提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- (3)依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- (4)當年度盈餘扣除上列一至三項後，如尚有盈餘併同以前年度未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，提請股東常會決議分派之。

本公司為維持公司永續經營發展及每股盈餘之穩定成長，股東紅利以當年度稅後盈餘扣除當年度依法應提列特別盈餘公積後之百分之五十以上為原則，分配比率為現金股利不低於百分之五十。

(1)法定盈餘公積

依民國一〇一年一月修正之公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

(2)特別盈餘公積

依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額，自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，該項特別盈餘公積餘額皆為239,802千元。

(3)盈餘分配

本公司分別於民國一〇五年六月二十二日及一〇四年六月二十三日經股東會決議民國一〇四年及一〇三年度盈餘分配案，有關分派之股利、員工紅利及董監酬勞如下：

	<u>104年度</u>	<u>103年度</u>
分派予普通股業主之股利：		
現金(每股股利分別為4.9266元及4.7738元)	\$ <u>1,819,147</u>	<u>1,667,250</u>
董監酬勞		\$ 8,000
員工紅利－現金紅利		<u>82,380</u>
		\$ <u>90,380</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

上述民國一〇四年度及一〇三年度盈餘分配，與本公司董事會擬議內容並無差異。相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢之。

5.其他權益

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產	合 計
民國105年1月1日	\$ (1,399,873)	(116,075)	(1,515,948)
外幣換算差異(稅後淨額)	(192,604)	-	(192,604)
處分投資累計重分類至損益	-	116,075	116,075
民國105年12月31日餘額	<u>\$ (1,592,477)</u>	<u>-</u>	<u>(1,592,477)</u>
民國104年1月1日	\$ (1,711,887)	-	(1,711,887)
外幣換算差異(稅後淨額)	312,014	-	312,014
備供出售金融資產未實現損益	-	(116,075)	(116,075)
民國104年12月31日餘額	<u>\$ (1,399,873)</u>	<u>(116,075)</u>	<u>(1,515,948)</u>

(十五)股份基礎給付

中美矽晶公司於民國九十九年六月經董事會決議，發行九十九年度第一次員工認股權憑證10,000,000單位，且業已於民國九十九年十一月十二日申報生效，並於民國一〇〇年八月十日發行，每單位可認購中美矽晶公司普通股1股，存續期間六年，員工自被授與認股權之日起屆滿二年、三年、四年及五年得分別行使認股權之累積比例為40%、60%、80%及100%。

截至民國一〇五年十二月三十一日止，中美矽晶公司發行之員工認股權憑證因分割而給予本公司員工之情形彙列如下：

種 類	申報生 效日期	給與日	既 得 期 間	給 與 單位數 (千單位)	每股認購 價格(元)	衡 量 日 每股市價 (元)	調 整 後 履約價格 (元)
99年第一次 員工認股權	99.11.12	100.8.10	服務期間 2~4年	3,475	60.50	60.50	50.20

本公司於民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日認列酬勞性員工認股權計畫之酬勞成本分別計1,181千元及3,317千元。上述於民國一〇〇年八月十日給與之員工認股權採用Black-Scholes選擇權評價模式估計給與日之公平價值，各項假設之加權平均資訊列示如下：

股利率	3.6%
預期價格波動性	48.065%
無風險利率	1.2905%
預期存續期間	6年

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司上述酬勞性員工認股選擇權憑證於民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日相關之數量及加權平均行使價格之資訊揭露如下：

員工認股權	105年		104年	
	數量 (千股)	調整後加權 平均行使 價格(元)	數量 (千股)	調整後加權 平均行使 價格(元)
期初流通在外	2,881	\$ 52.40	3,006	57.40
本期移轉	70	50.20	(85)	52.40
本期行使	-	-	-	-
本期沒收(失效數)	67	50.20	40	52.40
期末流通在外	<u>2,884</u>	50.20	<u>2,881</u>	52.40
期末可行使之員工認股權	<u>2,884</u>	50.20	<u>2,305</u>	52.40
員工認股權每股平均公平市 價(元)	\$ <u>23.36</u>		<u>23.36</u>	

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日流通在外之員工認股權，其加權平均剩餘存續期間分別為0.66年及1.66年。

(十六)每股盈餘

1.基本每股盈餘

	105年度	104年度
歸屬於本公司普通股權益持有人淨利	\$ <u>939,485</u>	<u>2,044,193</u>
普通股加權平均流通在外股數(千股)	<u>369,250</u>	<u>352,239</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>2.54</u>	<u>5.80</u>

2.稀釋每股盈餘

	105年度	104年度
歸屬於本公司普通股權益持有人淨利	\$ <u>939,485</u>	<u>2,044,193</u>
普通股加權平均流通在外股數(千股)	369,250	352,239
得採股票發行之員工酬勞之影響(千股)	556	1,649
	<u>369,806</u>	<u>353,888</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>2.54</u>	<u>5.78</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十七)收入

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
商品銷售	\$ 6,461,314	6,628,601
勞務提供(附註七)	<u>288,006</u>	<u>269,958</u>
	<u>\$ 6,749,320</u>	<u>6,898,559</u>

(十八)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。董事酬勞以現金方式分派，員工酬勞以股票或現金方式分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

本公司民國一〇五年度及一〇四年度員工酬勞提列金額分別為41,400千元及73,870千元，董事酬勞提列金額分別為3,500千元及5,000千元，係以本公司該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業成本或營業費用，其中員工酬勞以股票發放者，係依據董事會決議前一日之普通股收盤價計算配發股數。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為次年度之損益。

(十九)其他利益及損失

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
外幣兌換利益	\$ 187,352	31,171
其他	<u>16,125</u>	<u>23,055</u>
	<u>\$ 203,477</u>	<u>54,226</u>

(二十)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中狀況

本公司重要之客戶係與矽晶圓產業相關，而且本公司通常依授信程序給予客戶信用額度，因此本公司之信用風險主要受矽晶圓產業之影響。截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，本公司應收票據及帳款(含關係人)餘額之70%及74%係由十家客戶組成，雖有信用風險集中之情形，惟本公司已定期評估應收帳款回收之可能性並提列適當備抵呆帳。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

2. 流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息但不包含淨額協議之影響。

	帳面金額	合 約 現金流量	6個月 以內	6-12個月	1-2年	2-5年
105年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 11,745,000	(11,878,904)	(4,415,204)	(7,463,700)	-	-
應付票據及帳款 (含關係人)	4,970,090	(4,976,153)	(3,592,090)	(1,384,063)	-	-
長期借款(含一年內 到期長期借款)	<u>8,453,806</u>	<u>(9,970,257)</u>	<u>-</u>	<u>(458,297)</u>	<u>(1,269,533)</u>	<u>(8,242,427)</u>
	<u>\$ 25,168,896</u>	<u>(26,825,314)</u>	<u>(8,007,294)</u>	<u>(9,306,060)</u>	<u>(1,269,533)</u>	<u>(8,242,427)</u>
104年12月31日						
非衍生金融負債						
應付票據及帳款 (含關係人)	<u>\$ 1,547,223</u>	<u>(1,547,223)</u>	<u>(1,547,223)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

本公司於民國一〇五年十二月三十一日之流動資產雖低於流動負債，然本公司已採行因應措施，擬辦理現金增資以改善財務結構，相關說明請詳附註十一。

3. 匯率風險

(1) 匯率風險之暴險

本公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	105.12.31		
	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美 元	\$ 154,806	32.25	4,992,494
日 圓	312,517	0.2756	86,130
人 民 幣	5,524	4.617	25,504
<u>採權益法之長期股權投資</u>			
美 元	659,240	32.25	21,260,491
日 圓	34,326,166	0.2756	9,460,291
丹 麥 幣	378,037	4.59	1,735,192

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

		105.12.31		
		外幣	匯率	台幣
<u>金融負債</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美	元	98,432	32.25	3,174,432
日	圓	6,163,530	0.2756	1,698,669
		104.12.31		
		外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美	元	\$ 81,927	32.825	2,689,254
日	圓	307,939	0.2727	83,975
人	民 幣	23,526	4.995	117,512
<u>採權益法之長期股權投資</u>				
美	元	133,256	32.825	4,374,131
日	圓	31,268,798	0.2727	8,527,001
<u>金融負債</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美	元	42,785	32.825	1,404,418
日	圓	194,696	0.2727	53,094

(2) 敏感性分析

本公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金及約當現金、應收帳款、借款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日當新台幣相對於美金、人民幣及日圓貶值或升值5%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇五年度及一〇四年度之稅前淨利將分別增加或減少11,551千元及71,662千元。兩期分析係採用相同基礎。

(3) 貨幣性項目之兌換損益

本公司貨幣性項目之兌換損益(含已實現及未實現)換算為功能性貨幣之金額，匯率資訊如下：

	105年度		104年度	
	兌換損益	平均匯率	兌換損益	平均匯率
美元	\$ 1,292	32.263	31,371	31.739
日圓	186,658	0.2972	(613)	0.2624

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

	105年度		104年度	
	兌換損益	平均匯率	兌換損益	平均匯率
歐元	845	35.70	1,886	35.24
人民幣	(1,436)	4.849	(1,639)	5.033
瑞士法郎	(7)	32.72	166	33.00

4.利率分析

下列敏感度分析係依利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。

若利率增加或減少0.25%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司民國一〇五年度及一〇四年度之淨利將減少或增加44,705千元及增加或減少2,475千元，主因係本公司之變動利率銀行存款及借款。

5.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

本公司金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

		105.12.31				
		公允價值				
		帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產		\$ 2,442	-	2,442	-	2,442
放款及應收款						
現金及約當現金	\$ 2,501,000	-	-	-	-	-
應收票據及帳款(含關係人)	2,740,858	-	-	-	-	-
其他金融資產－非流動	85,159	-	-	-	-	-
	\$ 5,327,017	-	-	-	-	-
按攤銷後成本衡量之金融負債						
短期借款	\$ 11,745,000	-	-	-	-	-
應付票據及帳款(含關係人)	4,970,090	-	-	-	-	-
長期借款(含一年內到期長期借款)	8,453,806	-	-	-	-	-
	\$ 25,168,896	-	-	-	-	-

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

104.12.31

		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
放款及應收款					
現金及約當現金	\$ 2,147,611	-	-	-	-
應收票據及帳款(含關係人)	2,255,414	-	-	-	-
其他金融資產－非流動	5,471	-	-	-	-
	<u>\$ 4,408,496</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款(含關係人)	<u>\$ 1,547,223</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(2)非按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

本公司估計非按公允價值衡量之工具所使用之方法及假設如下：

按攤銷後成本衡量之金融負債若有成交或造市者之報價資料者，則以最近成交價格及報價資料作為評估公允價值之基礎。若無市場價值可供參考時，則採用評價方法估計。採用評價方法所使用之估計及假設為現金流量之折現值估計公允價值。

(3)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

遠期外匯合約通常係依據目前之遠期匯率評價。

民國一〇五年度及一〇四年度並無任何公允價值層級移轉情形。

(廿一)財務風險管理

1.概 要

本公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

(1)信用風險

(2)流動性風險

(3)市場風險

本附註表達本公司上述各項風險之暴險資訊、本公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳個體財務報告各該附註。

2.風險管理架構

董事會全權負責及監督本公司之風險管理架構並訂有風險管理政策與程序。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色，該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析本公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及公司運作之變化。並透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律、且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之審計委員會監督管理人員如何監控合併公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核本公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助本公司審計委員會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予審計委員會。

3.信用風險

本公司主要的潛在信用風險係源自於現金及應收帳款等之金融商品。本公司之現金存放於不同之金融機構。本公司控制暴露於每一金融機構之信用風險，而且認為本公司之現金不會有重大之信用風險顯著集中之虞。

4.流動性風險

本公司之資本及營運資金足以支應履行所有合約義務，故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市場價格變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響本公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

(1)匯率風險

本公司暴露於非以各該集團企業之功能性貨幣計價之銷售、採購及借款交易所產生之匯率風險。集團企業之功能性貨幣以新台幣為主、亦有人民幣、美金及日幣。該等交易主要之計價貨幣有新台幣、美元及日幣。

借款利息係以借款本金幣別計價。一般而言，借款幣別係與本公司營運產生之現金流量之幣別相同，主要係新台幣。

有關其他外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，本公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

(2)利率風險

本公司持有浮動利率之資產與負債，因而產生現金流量利率暴險。

(廿二)資本管理

董事會之政策係維持健全之資本基礎，以維繫投資人、債權人及市場之信心以及支持未來營運之發展。資本包含本公司之股本、資本公積及保留盈餘。董事會控管資本報酬率，同時控管普通股股利水準。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

報導日之負債資本比率如下：

	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
負債總額	\$ 26,073,065	2,414,158
減：現金及約當現金	<u>(2,501,000)</u>	<u>(2,147,611)</u>
淨負債	<u>\$ 23,572,065</u>	<u>266,547</u>
權益總額	<u>\$ 15,774,704</u>	<u>16,724,597</u>
負債資本比率	<u>149.43%</u>	<u>1.59%</u>

民國一〇五年十二月三十一日負債資本比率增加，主要係因應收購子公司及營運週轉，對銀行之長短期借款增加。

本公司為有效改善財務結構，規劃將辦理現金增資，請詳附註十一說明。

七、關係人交易

(一)母子公司間關係

本公司直接或間接持有之子公司明細如下：

	<u>設立地</u>	<u>業主權益(持股%)</u>	
		<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
GlobalSemiconductor Inc. (以下稱GSI)	Cayman	100%	100%
GlobalWafers Inc. (以下稱GWI)	Cayman	100%	100%
GWafers合同會社(以下稱GWafers)	日本	100%	100%
GWafers Singapore Pte. Ltd.(以下稱GWafers Singapore)	新加坡	100%	-
Topsil Globalwafers A/S(以下稱Topsil A/S)	丹麥	100%	-
昆山中辰矽晶有限公司(以下稱昆山中辰)	江蘇省昆山市	100%	100%
GlobiTech Incorporated. (以下稱GTI)	Texas	100%	100%
GlobalWafers Japan Co., Ltd. (以下稱GWJ)	日本	100%	100%
上海葛羅禾半導體科技有限公司(以下稱上海葛羅禾)	上海	60%	-
Topsil Semiconductor sp z o.o. (以下稱Topsil PL)	波蘭	100%	-
SunEdison Semiconductor Limited(以下稱SSL)	新加坡	100%	-
SunEdison Semiconductor B.V.(以下稱SSBV)	荷蘭	100%	-
SunEdison Semiconductor Technology Pte Ltd. (以下稱SST)	新加坡	100%	-

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

	設立地	業主權益(持股%)	
		105.12.31	104.12.31
MEMC Japan Ltd.(以下稱MEMC Japan)	日本	100%	-
MEMC Electronic Materials, SpA(以下稱MEMC SpA)	義大利	100%	-
MEMC Electronic Materials France SarL(以下稱MEMC SarL)	法國	100%	-
MEMC Electronic Materials GmbH(以下稱MEMC GmbH)	德國	100%	-
MEMC Holding B.V.(以下稱MEMC BV)	荷蘭	100%	-
MEMC Korea Company(以下稱MEMC Korea)	韓國	100%	-
SunEdison Semiconductor LLC(以下稱SunEdison LLC)	美國	100%	-
MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd(以下稱MEMC Sdn Bhd)	馬來西亞	100%	-
SunEdison Semiconductor Technology (Shanghai) Ltd(以下稱SunEdison Shanghai)	上海	100%	-
SunEdison Semiconductor Holdings B.V.(以下稱SSHBV)	荷蘭	100%	-
Taisil Electronic Materials Corp. (以下稱Taisil)	台灣	99.96%	-
MEMC Ipoh Sdn Bhd (以下稱MEMC Ipoh)	馬來西亞	100%	-

(二)母公司與最終控制者

中美矽晶公司為本公司之母公司及所歸屬集團之最終控制者，截至民國一〇五年十二月三十一日止持有本公司流通在外普通股股份之60.20%，中美矽晶公司已編製供大眾使用之合併財務報告。

(三)主要管理人員交易

主要管理人員報酬包括：

	105年度	104年度
短期員工福利	\$ 50,300	41,515
退職後福利	432	477
股份基礎給付	344	965
	<u>\$ 51,076</u>	<u>42,957</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司於民國一〇五年度及一〇四年度皆提供成本計1,500千元之汽車1輛，供主要管理人員使用。

有關股份基礎給付之說明請詳附註六(十五)。

(四)其他關係人交易

1.營業收入

本公司對關係人之重大銷售金額如下：

	105年度	104年度
母公司	\$ 17,515	19,887
其他關係人	<u>245,560</u>	<u>282,361</u>
	<u>\$ 263,075</u>	<u>302,248</u>

本公司銷貨予關係人之價格係以一般市場價格為基準，考量銷售區域、銷售數量不同等因素而酌予調整。

本公司民國一〇五年度及一〇四年度售予一般客戶約定收款期間分別為月結0天~月結120天及月結0天~次月結120天；對主要關係人約定收款期間分別為月結30天~次月結60天及月結60天~次月結60天。

2.進貨及委託加工

本公司向關係人進貨及委託加工金額如下：

	105年度	104年度
母公司	\$ 385,830	187,514
子公司	<u>7,909,103</u>	<u>7,735,738</u>
	<u>\$ 8,294,933</u>	<u>7,923,252</u>

本公司向關係人採購之貨物及委託加工係以一般市場價格為基準。

本公司民國一〇五年度及一〇四年度與一般廠商付款條件分別為月結0天~次月結120天及月結0天~月結150天；向關係人進貨付款條件皆為月結15天~月結60天。

3.應收關係人款項

本公司應收關係人款項明細如下：

帳列項目	關係人類別	105.12.31	104.12.31
應收關係人款項	母公司	\$ 1,742	2,130
應收關係人款項	其他關係人	<u>74,306</u>	<u>76,310</u>
		<u>\$ 76,048</u>	<u>78,440</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

4.應付關係人款項

本公司應付關係人款項明細如下：

帳列項目	關係人類別	105.12.31	104.12.31
應付關係人款項	母公司	\$ 220,905	43,068
應付關係人款項	子公司	1,534,418	1,323,501
		<u>\$ 1,755,323</u>	<u>1,366,569</u>

5.管理費用

本公司每月支付中美矽晶公司管理費用，民國一〇五年度及一〇四年度之管理費用分別為9,621千元及15,584千元，帳列管理費用項下；截至民國一〇五年十二月三十一日及一〇四年十二月三十一日，尚未結清款項分別為2,453千元及2,014千元，帳列應付關係人款項。

6.技術服務費用

本公司支付關係人技術服務費用，帳列研發費用如下：

	105年度	104年度
母公司	<u>\$ 7,099</u>	<u>10,848</u>

截至民國一〇五年十二月三十一日及一〇四年十二月三十一日，尚未支付之應付技術服務費分別為2,226千元及2,835千元，帳列應付關係人款項。

7.資金貸與

本公司資金貸與關係人其實際動支情形如下：

105年度					
關係人	最高餘額	實際動支 餘 額	期末餘額	利率區間	利息收入
子公司	<u>\$ 3,544,750</u>	<u>662,773</u>	<u>1,651,250</u>	2.0~2.5%	<u>1,733</u>
104年度					
關係人	最高餘額	實際動支 餘 額	期末餘額	利率區間	利息收入
母公司	<u>\$ 1,200,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	1.8%	<u>-</u>

截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，因資金貸與之利息收入所產生之應收關係人款項為1,172千元及0千元。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

8.資金融通

本公司民國一〇五年度向關係人資金融通，其實際動支情形金額如下：

關 係 人	105年度		
	期末餘額	利率區間	利息支出
子公司	\$ <u>1,378,000</u>	0.44 %	<u>1,093</u>

截至民國一〇五年十二月三十一日，上述資金融通之利息支出已全數支付。

9.背書保證

本公司民國一〇五年度及一〇四年度間，為關係人取得銀行融資而提供背書保證最高額度如下：

單位：千元

	105年度		104年度	
子公司	JPY	1,000,000	JPY	1,000,000
子公司	USD	200,000		-

截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日背書保證餘額彙列如下：

單位：千元

	105.12.31		104.12.31	
子公司	JPY	1,000,000	JPY	1,000,000
子公司	USD	200,000		-

10.各項墊款

截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日止，本公司因關係人間相互墊付購料款、保險、水電費及人力支援等款項而尚未結清之應收(付)關係人款項，列於應收關係人款項及應付關係人款項並彙列如下：

	105.12.31	104.12.31
母公司	\$ 229	345
母公司	(1,421)	(334)
子公司	13,331	1,450
子公司	(2,771)	(4,776)
其他關係人	254	28
其他關係人	(38)	-
	<u>\$ 9,584</u>	<u>(3,287)</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

11.財產交易

(1)取得不動產、廠房及設備

本公司向關係人取得不動產、廠房及設備之價款彙總如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
母公司	\$ -	3,697
子公司	433	-
其他關係人	768	-
	<u>\$ 1,201</u>	<u>3,697</u>

截至民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日，上述價款本公司已全數支付。

(2)取得無形資產

本公司向關係人取得無形資產之價款彙總如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
子公司	\$ <u>1,631,850</u>	<u>-</u>

截至民國一〇五年十二月三十一日止，尚未結清款項為1,631,850千元，帳列應付關係人款項。

12.其他

- (1)本公司直接銷售予關係人，因視為存貨移轉，故銷貨收入及相關成本業於財務報表表達時予以沖銷，不視為本公司之銷貨及成本。民國一〇五年度及一〇四年度上述銷售交易金額如下：

	<u>105年度</u>	<u>104年度</u>
母公司	\$ -	8,301
子公司	4,549,307	4,053,490
	<u>\$ 4,549,307</u>	<u>4,061,791</u>

本公司民國一〇五年度及一〇四年度為子公司代購原料產生之勞務收入分別為264,064千元及247,112千元。

另，本公司與子公司協議收取佣金收入，民國一〇五年度及一〇四年度產生之佣金收入合計分別為23,942千元及22,846千元，列於勞務收入。

上述交易所產生之應收帳款餘額如下：

<u>帳列項目</u>	<u>關係人類別</u>	<u>105.12.31</u>	<u>104.12.31</u>
應收關係人款項	子公司	\$ <u>864,667</u>	<u>1,149,656</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2)本公司與母公司訂有廠房租賃合約，付款條件為次月結15天後付款，相關租賃計付之租金支出及應付關係人款項明細如下：

		105年度	104年度
母公司		\$ <u>15,090</u>	<u>2,400</u>
帳列項目	關係人類別	105.12.31	104.12.31
應付關係人款項	母公司	\$ <u>3,113</u>	<u>420</u>

本公司出租廠房予母公司，收款條件為次月結45天後收款，相關租賃之租金收入及應收關係人款項明細如下：

		105年度	104年度
母公司		\$ <u>816</u>	<u>816</u>
帳列項目	關係人類別	105.12.31	104.12.31
應收關係人款項	母公司	\$ <u>71</u>	<u>71</u>

八、抵質押之資產

本公司提供抵質押擔保之資產帳面價值明細如下：

資產名稱	抵質押擔保標的	105.12.31	104.12.31
定期存款(列於其他金融資產－非流動)	提供銀行開立新竹科學工業園區管理局土地租約之擔保	\$ 5,018	5,018
定期存款(列於其他金融資產－非流動)	銀行借款備償戶保證金	78,600	-
		\$ <u>83,618</u>	<u>5,018</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

除附註六(十一)及附註七所述外，本公司其他重大或有負債及未認列之合約承諾如下：

(一)重大未認列之合約承諾：

1.本公司依據現行有效合約尚未進貨之金額分別如下：

(外幣單位：千元)

	105.12.31	104.12.31
美金	\$ <u>57,953</u>	<u>78,989</u>
歐元	\$ <u>6,608</u>	<u>9,526</u>

2.本公司已開立而未使用之信用狀：

(外幣單位：千元)

	105.12.31	104.12.31
日圓	\$ <u>3,800</u>	<u>-</u>

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

(二)或有負債：無。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項

本公司為改善財務結構及因應資本支出需求，於民國一〇六年三月二十一日經董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計至少發行59,200仟股，最多不超過74,000仟股。

十二、其 他

員工福利及折舊功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	105年度			104年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	235,104	115,335	350,439	235,063	95,540	330,603
勞健保費用	21,885	8,853	30,738	22,239	7,559	29,798
退休金費用	10,330	5,464	15,794	10,152	4,546	14,698
其他員工福利費用	12,618	3,960	16,578	9,594	2,770	12,364
折舊費用	75,924	22,961	98,885	100,907	7,835	108,742

本公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日員工人數分別為488人及475人。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊：

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日本公司依證券發行人財務報告編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：請詳附表一。
- 2.為他人背書保證：請詳附表二。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：無。
- 4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表三。
- 5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表四。
- 6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

環球晶圓股份有限公司個體財務報告附註(續)

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：請詳附表五。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表六。

9.從事衍生性商品交易：請詳附註六(二)。

(二)轉投資事業相關資訊：請詳附表七。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：請詳附表八(一)。

2.轉投資大陸地區限額：請詳附表八(二)。

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

本公司民國一〇五年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

請詳民國一〇五年度合併財務報告。

環球晶圓股份有限公司及其子公司

資金貸與他人

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表一

單位：千元

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高餘額	期末餘額	本期實際動支餘額	利率區間	資金貸與性質(註1)	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額(註2、4)	資金貸與總限額(註3、4)
													名稱	價值		
0	本公司	Topsil	應收關係人融資金	是	500,000	200,000	96,682 (USD2,998)	2%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,577,470	1,577,470
0	本公司	GWafers Singapore	應收關係人融資金	是	1,593,500 (USD50,000)	-	-	2.5%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,577,470	1,577,470
0	本公司	SSBV	應收關係人融資金	是	1,593,500 (USD50,000)	1,451,250 (USD45,000)	566,091 (USD17,553)	2.5%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,577,470	1,577,470
1	GWJ	本公司	應收關係人融資金	是	1,504,000 (JPY5,000,000)	1,378,000 (JPY5,000,000)	1,378,000 (JPY5,000,000)	0.44%	1	5,110,592	業務往來	-	-	-	5,110,592	4,171,518
2	SSBV	MEMC Korea	應收關係人融資金	是	1,290,000 (USD40,000)	1,290,000 (USD40,000)	1,212,846 (USD37,608)	7%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,290,000	1,290,000
2	SSBV	MEMC SpA	應收關係人融資金	是	248,516 (EUR7,331)	248,516 (EUR7,331)	248,516 (EUR7,331)	-	2	-	營業週轉	-	-	-	248,516	248,516
2	SSBV	SSL	應收關係人融資金	是	3,708,750 (USD115,000)	1,967,090 (USD60,995)	1,967,090 (USD60,995)	7%	2	-	營業週轉	-	-	-	3,708,750	3,708,750
3	MEMC SpA	SSL	應收關係人融資金	是	2,644,200 (EUR78,000)	2,644,200 (EUR78,000)	2,410,191 (EUR71,907)	3.49%	2	-	營業週轉	-	-	-	2,644,200	2,644,200

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高餘額	期末餘額	本期實際動支餘額	利率區間	資金質與性質(註1)	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品名稱	擔保品價值	對個別對象資金貸與限額(註2、4)	資金貸與總限額(註3、4)
4	Taisil	MEMC Ipoh	應收關係人融貸款	是	1,612,500 (USD50,000)	1,612,500 (USD50,000)	403,125 (USD12,500)	3%	2	-	營業週轉	-	-	-	1,612,500	1,612,500
4	Taisil	SSL	應收關係人融貸款	是	12,900,000 (USD400,000)	12,900,000 (USD400,000)	12,508,978 (USD387,875)	2%	2	-	營業週轉	-	-	-	12,900,000	12,900,000

註1：資金貸與性質之填寫方法如下：

(1)有業務往來者請填1。

(2)有短期融通資金之必要者請填2。

註2：資金貸與有業務往來公司者，個別貸與金額以不超過雙方最近一年度業務往來金額為限；資金貸與有短期融通資金必要之公司，個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之十為限；本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之二十為限。另，本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂後資金貸與有業務往來公司者，個別貸與金額以不超過雙方最近一年度業務往來金額為限；資金貸與有短期融通資金必要之公司，個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限；本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限。

註3：資金貸與有業務往來公司者，貸與總金額以不超過貸出資金公司淨值的百分之四十為限；資金貸與有短期融通資金必要之公司，該貸與總金額以不超過貸出資金公司淨值的百分之十為限；本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限。另，本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂後資金貸與有業務往來公司者，貸與總金額以不超過貸出資金公司淨值的百分之四十為限；資金貸與有短期融通資金必要之公司，該貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限。另，本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂後資金貸與有業務往來公司者，貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限；本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限。

註4：本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，資金貸與若非屬進銷貨之其他業務往來關係者，雙方須簽有合約且資金貸與額度最高不得逾該合約的總金額。

環球晶圓股份有限公司及其子公司
為他人背書保證

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表二

單位：千元

背書保證者 編號	背書保證者 公司名稱	被 背 書 保 證 對 象		對單一企業 背書保證 限額(註2、3)	本期最高 背書保證 餘 額	期末背書 保證餘額	實際動支 金 額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書 保證金額 佔最近期 財務報表 淨值之比率	背書保證 最高限額 (註1)	屬母公 司對子 公司背 書保證	屬子公 司對母 公司背 書保證	屬對 大陸地 區背書 保證
		公司名稱	關 係										
0	本公司	GWJ	本公司間接持 有之子公司	6,309,882	314,300 (JPY 1,000,000)	275,600 (JPY 1,000,000)	-	-	1.75%	7,887,352	Y	N	N
0	本公司	SSBV	本公司間接持 有之子公司	(註3)	6,450,000 (USD 200,000)	6,450,000 (USD 200,000)	6,450,000 (USD 200,000)	-	40.89%	7,887,352	Y	N	N

註1：提供背書保證者公司之累積對外背書保證之總額，以不超過最近期財務報表淨值的百分之五十為限。另，本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「背書保證辦法」，修訂後本公司之累積對外背書保證之總額，以不超過提供本公司之最近期財務報表淨值的三倍為限。

註2：提供背書保證者公司之對單一企業背書保證之額度，以不超過最近期財務報表提供背書保證者公司之淨值的百分之十為限。惟對子公司則以本公司淨值的百分之四十為限。另，本公司於民國一〇六年二月二十日股東臨時會決議修訂本公司「背書保證辦法」，修訂後本公司對單一企業背書保證之額度，以不超過最近期財務報表本公司淨值的百分之十為限。惟對子公司則以本公司淨值的一倍為限。

註3：惟對下列企業背書保證不受上述二款規定限制：

- (1) 提供背書保證者公司所直接或間接持有表決權股份百分之百之公司；及
- (2) 直接或間接持有提供背書保證者公司之表決權股份百分之五十之母公司及該母公司所直接或間接持有表決權股份百分之五十之公司。

環球晶圓股份有限公司及其子公司

累積買進或賣出同一有價證券金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表三

單位：千元／千股；千單位

買、賣 之公司	有價證券 種類及名稱	帳列科目	交易 對象	關係	期 初		買 入		賣 出			期 末	
					股 數	金 額	股 數	金 額	股 數	售 價	帳面成本	處分損益	股 數
本公司	Topsil股票	採權益法之 長期股權投 資	Topsil Semiconductor Material A/S	無	-	-	1,000	1,964,069	-	-	-	1,000	1,964,069
GWafers Singapore	SSL股票	採權益法之 長期股權投 資	原股東	無	-	-	40,318	16,660,490	-	-	-	40,318	16,660,490
GWafers Singapore	SSL股票	採權益法之 長期股權投 資	GTI	關聯企業	-	-	2,074	790,743	-	-	-	2,074	790,743
GTI	海外公司股票	備供出售金 融資產－非 流動	GWafers Singapore	關聯企業	2,074	533,741	-	-	2,074	790,743	533,741	257,002	-

環球晶圓股份有限公司及其子公司

取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上者

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表四

單位：千元

取得不動產之公司	財產名稱	事實發生日	交易金額	價款支付情形	交易對象	關係	交易對象為關係人者，其前次移轉資料				價格決定之參考依據	取得目的及運用情形	其他約定事項
							所有人	與發行人之關係	移轉日期	金額			
本公司	不動產及廠房	105 年 7 月	469,860	-	Topsil	無	-	-	-	-	依公允價值入帳	供營運使用	無
GWafers Singapore	不動產及廠房	105 年 12 月	6,832,393	-	SSL	無	-	-	-	-	依公允價值入帳	供營運使用	無

註：上述係因企業合併取得Topsil及SSL及其子公司之不動產及廠房。

環球晶圓股份有限公司及其子公司

與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表五

單位：千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交 易 情 形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	中美矽晶	本公司之母公司	進貨	385,830	4%	月結60天	-	-	(220,905)	(12)%	
本公司	GTI	本公司間接持有之子公司	進貨	1,003,410	10%	月結60天	-	-	(118,321)	(6)%	
本公司	昆山中辰	本公司間接持有之子公司	進貨	1,770,573	18%	月結60天	-	-	(318,956)	(17)%	
本公司	GWJ	本公司間接持有之子公司	進貨	5,110,592	53%	月結60天	-	-	(1,092,536)	(57)%	
GTI	本公司	本公司間接持有之子公司	進貨	2,384,335	35%	月結60天	-	-	(588,067)	(29)%	
昆山中辰	本公司	本公司間接持有之子公司	進貨	947,160	14%	月結60天	-	-	(51,297)	(2)%	
GWJ	本公司	本公司間接持有之子公司	進貨	1,186,025	18%	月結60天	-	-	(211,762)	(10)%	
朋程科技	本公司	母公司中美矽晶與該公司董事長為同一人	進貨	245,560	4%	月結60天	-	-	(74,253)	(4)%	

環球晶圓股份有限公司及其子公司
應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上
民國一〇五年十二月三十一日

附表六

單位：千元

帳列應收款 項之公司	交易對象 名稱	關 係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額 (註1)	提列備抵 呆帳金額
					金額	處理方式		
本公司	GTI	本公司間接持有之子公司	588,067	3.4	-	-	402,017	-
本公司	GWJ	本公司間接持有之子公司	211,762	5.6	-	-	182,332	-
本公司	SSBV	本公司間接持有之子公司	566,091	註3	-	-	-	-
GTI	本公司	本公司間接持有之子公司	118,321	14.8	-	-	97,800	-
昆山中辰	本公司	本公司間接持有之子公司	318,956	6.0	-	-	249,308	-
GWJ	本公司	本公司間接持有之子公司	1,092,536	4.8	-	-	788,887	-
GWJ	本公司	本公司間接持有之子公司	1,378,000	註3	-	-	-	-
SSL	本公司	本公司間接持有之子公司	1,631,850	註2	-	-	1,631,850	-
SSL	MEMC Japan	均為本公司間接持有之子公司	493,529	4.1	-	-	119,257	-
SSL	MEMC Korea	均為本公司間接持有之子公司	421,907	3.0	-	-	-	-
SSL	Taisil	均為本公司間接持有之子公司	765,651	3.0	-	-	-	-
SSL	SunEdison LLC	均為本公司間接持有之子公司	4,890,844	1.7	-	-	33,638	-
SSL	MEMC SpA	均為本公司間接持有之子公司	464,139	9.3	-	-	-	-
MEMC SpA	SSL	均為本公司間接持有之子公司	286,322	10.0	-	-	-	-
MEMC SpA	SSL	均為本公司間接持有之子公司	2,410,191	註3	-	-	-	-
SSBV	MEMC Korea	均為本公司間接持有之子公司	1,212,846	註3	-	-	-	-

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額 (註1)	提列備抵 呆帳金額
					金額	處理方式		
SSBV	MEMC SpA	均為本公司間接持有之子公司	248,516	註3	-	-	-	-
SSBV	SSL	均為本公司間接持有之子公司	1,967,090	註3	-	-	-	-
SunEdison LLC	MEMC Japan	均為本公司間接持有之子公司	348,750	1.0	-	-	-	-
SunEdison LLC	MEMC Korea	均為本公司間接持有之子公司	261,694	1.6	-	-	-	-
SunEdison LLC	MEMC SpA	均為本公司間接持有之子公司	171,410	1.8	-	-	-	-
SunEdison LLC	SSL	均為本公司間接持有之子公司	589,145	0.6	-	-	-	-
MEMC Korea	SunEdison LLC	均為本公司間接持有之子公司	338,830	0.2	-	-	-	-
MEMC Korea	SSL	均為本公司間接持有之子公司	1,214,926	2.0	-	-	-	-
MEMC Japan	SSL	均為本公司間接持有之子公司	464,102	3.5	-	-	464,102	-
MEMC Sdn Bhd	SSL	均為本公司間接持有之子公司	240,593	7.6	-	-	240,593	-
MEMC Ipoh	SSL	均為本公司間接持有之子公司	727,192	2.8	-	-	94,532	-
Taisil	SunEdison LLC	均為本公司間接持有之子公司	123,906	0.3	-	-	75,228	-
Taisil	MEMC Ipoh	均為本公司間接持有之子公司	403,125	註3	-	-	-	-
Taisil	SSL	均為本公司間接持有之子公司	12,508,978	註3	-	-	-	-
Taisil	SSL	均為本公司間接持有之子公司	1,536,057	1.1	-	-	354,155	-

註：截至民國一〇六年三月六日止收回金額。

註2：係出售無形資產產生之應收關係人款。

註3：係資金融通產生之應收關係人款。

環球晶圓股份有限公司及其子公司
轉投資事業相關資訊(不包含大陸被投資公司)

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表七

單位：千元／千股

投資公司 名稱	被投資 公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	GWI	Cayman	投資各項事業	2,241,668 (USD73,423)	2,241,668 (USD73,423)	90,000	100.00%	3,539,870	57,788	57,788	子公司
本公司	GSI	Cayman	投資各項事業及與大陸子公司之三角貿易中心	756,809 (USD26,555)	756,809 (USD26,555)	25,000	100.00%	941,279	67,882	67,882	子公司
本公司	GWafers	日本	投資各項事業	5,448,015 (JPY13,827,513)	5,448,015 (JPY13,827,513)	(註1)	100.00%	9,460,291	918,344	918,344	子公司
本公司	GWafers Singapore	新加坡	投資各項事業	17,504,000 (USD550,000)	-	550,000	100.00%	16,779,342	(744,986)	(744,986)	子公司
本公司	Topsil A/S	丹麥	半導體矽晶圓製造及貿易	註3	-	1,000	100.00%	1,735,192	(146,057)	(144,673)	子公司
GWJ	GTI	Texas	磊晶矽晶圓生產及磊晶代工等貿易	2,241,668 (USD73,423)	2,241,668 (USD73,423)	1	100.00%	3,539,870	73,937	57,788	註2 孫公司
GWafers	GWJ	日本	半導體矽晶圓製造及貿易	5,484,300 (JPY13,142,798)	5,484,300 (JPY13,142,798)	128	100.00%	9,452,298	475,716	918,779	註2 孫公司
Topsil A/S	Topsil PL	波蘭	半導體矽晶圓製造及貿易	註3	-	1	100.00%	(46,388)	(56,594)	(56,594)	註2 孫公司
GWafers Singapore	SSL	新加坡	投資、行銷及貿易業務	17,451,233	-	42,392	100.00%	16,681,956	(739,168)	(744,832)	孫公司
SSL	SSBV	荷蘭	投資各項事業	註4	-	0.1	100.00%	30,288,122	(217,823)	(217,823)	註2 孫公司
SSL	SST	新加坡	投資各項事業	註4	-	0.001	100.00%	-	-	-	孫公司
SSBV	MEMC Japan	日本	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	-	100.00%	220,989	649	649	孫公司

投資公司 名稱	被投資 公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股 數	比率	帳面金額			
SSBV	MEMC SpA	義大利	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	65,000	100.00%	7,307,106	(176,688)	(176,688)	孫公司
MEMC SpA	MEMC SarL	法國	貿易業務	註4	-	0.5	100.00%	1,691	(2,497)	(2,497)	孫公司
MEMC SpA	MEMC GmbH	德國	貿易業務	註4	-	0.002	100.00%	4,510	(73)	(73)	孫公司
MEMC SpA	MEMC BV	荷蘭	投資各項事業	註4	-	0.2	100.00%	1,288,506	(90,269)	(90,269)	孫公司
MEMC BV	MEMC Korea	韓國	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	6,880	40.00%	1,290,678	(215,265)	(86,106)	孫公司
SSBV	MEMC Korea	韓國	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	10,320	60.00%	2,076,582	(215,265)	(129,159)	孫公司
SSBV	SunEdison LLC	美國	半導體矽晶圓研發、製造及銷售	註4	-	1	100.00%	3,371,238	(785,309)	(785,309)	孫公司
SSBV	MEMC Sdn Bhd	馬來西亞	半導體矽晶圓研發、製造及銷售	註4	-	1,036	100.00%	1,131,880	(23,868)	(23,868)	孫公司
SSBV	SSH BV	荷蘭	投資各項事業	註4	-	0.1	100.00%	8,081,774	-	-	孫公司
SSBV	Taisil	台灣	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	252,770	54.95%	11,142,092	38,019	20,892	孫公司
SSH BV	Taisil	台灣	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	207,046	45.01%	9,116,257	38,019	17,113	孫公司
SSH BV	MEMC Ipoh	馬來西亞	半導體矽晶圓製造及銷售	註4	-	699,374	100.00%	(1,034,480)	8,750	8,750	孫公司

註1：為有限公司。

註2：投資損益認列包含投資成本與取得股權淨值攤銷數。

註3：本公司本期收購Topsil A/S及Topsil PL，投資金額總計1,964,069千元(DKK407,600千元)。

註4：本公司本期透過GWafers Singapore收購SSL及其子公司，投資金額總計17,451,233千元(USD546,975千元)。

環球晶圓股份有限公司及其子公司

對大陸之投資概況及轉投資大陸地區限額

民國一〇五年一月一日至十二月三十一日

附表八

(一)轉投資大陸地區之事業相關資訊

單位：千元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期末自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額			本期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	環球晶圓公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益(註4)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
昆山中辰	矽晶棒矽晶圓等加工貿易	769,177 (註6)	(註1)	713,300 (USD21,729) (註2)	-	-	-	713,300 (USD21,729) (註2)	58,924	100%	58,924	906,997	-
SunEdison Shanghai	貿易業務	7,527 (RMB1,500)	(註2)	- (註2)	-	-	-	- (註2)	220	100%	220	13,199	-
上海葛羅禾	銷售及行銷業務	9,756 (RMB2,000)	(註3)	-	-	-	-	-	(821)	60%	(492)	5,072	-

(二)轉投資大陸地區限額

公司別	本期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
本公司	713,300 (USD21,729)	818,233 (USD25,000)(註5)	9,491,101(註6)

註1：透過GSI再投資大陸公司。

註2：透過SSBV再投資大陸公司，係本期收購SSL所取得。

註3：上海葛羅禾係透過昆山中辰之自有資金投資設立，無自台灣匯出款，故不列入投資限額計算。

註4：係依經會計師查核之財務報表認列投資損益。

註5：按歷史匯率換算。

註6：依據投審會民國九十七年八月二十九日「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定之限額60%乘民國一〇五年十二月三十一日本公司淨值計算。

註7：係包含盈餘轉增資。

環球晶圓股份有限公司



負責人：徐 秀 蘭



